



# **MAXIMUS VII HERO**

用户手册

Motherboard

C9192

1.00 版

2014 年 4 月发行

#### 版权说明

© ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved. 华硕电脑股份有限公司保留所有权利。

本用户手册包括但不限于其所包含的所有信息都受到着作权法的保护，未经华硕电脑股份有限公司（以下简称“华硕”）许可，不得有任何仿造、复制、摘抄、转译、发行等行为或为其它利用。

#### 免责声明

本用户手册是以“现状”及“以目前明示的条件下”的状态提供给您。在法律允许的范围内，华硕就本用户手册，不提供任何明示或默示的担保及保证，包括但不限于商业畅销性、特定目的适用性、未侵害任何他人权利及任何使用本用户手册或无法使用本用户手册的保证，且华硕对因使用本用户手册而获取的结果或通过本用户手册所获得任何信息的准确性或可靠性不提供担保及保证。

用户应自行承担使用本用户手册的所有风险。用户明确了解并同意华硕、华硕的被授权人及董事、管理层、员工、代理商、关联企业皆无须为您因本用户手册、或因使用本用户手册、或因不可归责于华硕的原因而无法使用本用户手册或其任何部分而可能产生的衍生、附带、直接、间接、特别、惩罚或任何其它损失（包括但不限于利益损失、业务中断、数据遗失或其它金钱损失）负责，不论华硕是否被告知发生上述损失之可能性。

由于部分国家或地区可能不允许责任的全部免除或对上述损失的责任限制，所以上述限制或排除条款可能对您不适用。

用户知悉华硕有权随时修改本用户手册。本产品规格或驱动程序一经改变，本用户手册将会随之更新。本用户手册更新的详细说明请您访问华硕的客户服务网 <http://www.asus.com.cn/support>，或是直接与华硕电脑客户关怀中心 400-620-6655 联系。

对于本用户手册中提及的第三方产品名称或内容，其所有权及知识产权都为各产品或内容所有人所有且受现行知识产权相关法律及国际条约的保护。

当下列两种情况发生时，本产品将不再受到华硕的保修及服务：

- (1) 本产品曾经过非华硕授权的维修、规格更改、零件替换或其它未经过华硕授权的行为。
- (2) 本产品序号模糊不清或丢失。

本产品的名称与版本都会印在主板/显卡上，版本数字的编码方式是用三个数字组成，并有一个小数点做间隔，如 1.02G、2.03G 等...数字越大表示版本越新，而越左边位数的数字更动表示更动幅度也越大。升级的详细说明请您到华硕的互联网浏览或是直接与华硕联络。

三年质保



全国联保

## 华硕产品质量保证卡

尊敬的华硕产品用户：

首先非常感谢您选用华硕公司产品，让我们有机会向您提供优质的服务。为了使我们的服务让您更满意，在购买后请您认真阅读此说明并妥善保存此质量保证卡。

### 保修说明注意事项：

- 一、请将此质量保证卡下方的用户数据填写完整，并由最终直接经销商加盖印章，如果没有加盖印章，请找原购买处补盖以保障您的权益。请务必保留购买发票或复印件，否则华硕公司将不以产品的出厂日期为参照进行保修。
- 二、华硕公司对在中国大陆地区（不包括港澳台地区）发售的、经合法渠道销售给消费者的华硕主板及显卡产品实行三年的免费保修服务。
- 三、华硕公司对在中国大陆地区（不包括港澳台地区）发售的、经合法渠道销售给消费者的华硕主板及显卡产品实行全国联保服务。注：
  - A. 消费者必须出具正规购买发票或国家认可的有效凭证方可享受全国联保。
  - B. 如消费者无法出具正规购买发票或国家认可的有效凭证，则需送修至原购买经销商处享受保修服务。
- 四、若经本公司判断属下列因素，则不属于免费保修服务的范围，本公司将有权利收取维修费用：
  - A. 超过华硕提供的质保有效期的主板、显卡产品。
  - B. 因遇不可抗拒外力（如：水灾、火灾、地震、雷击、台风等）或人为之操作使用不慎造成之损害。
  - C. 未按产品说明书条例的要求使用、维护、保管而造成的损坏。
  - D. 用户擅自或请第三方人员自行检修、改装、更改组件、修改线路等。
  - E. 因用户自行安装软件即设置不当所造成之使用问题及故障。
  - F. 本公司产品序列号标签撕毁或无法辨认，涂改保修服务卡或与实际产品不符。
  - G. 其他不正常使用所造成之问题及故障。
- 五、技术支持及维修服务：
  1. 我们建议您先登录华硕官方会员网站（<http://vip.asus.com>），对您购买的华硕产品进行在线注册，注册后您将会定期得到我们发送的产品信息以及技术数据；
  2. 如果您在使用华硕产品的过程中遇到问题，您可以首先查阅用户手册，寻找答案；
  3. 您亦可访问华硕中文网站技术支持页面（<http://www.asus.com.cn/support>）查询到相应技术支持信息与常见问题排除；
  4. 登录我们的在线技术支持服务区进行咨询（<http://vip.asus.com/VIP2/Services/QuestionForm/TechQuery>）；
  5. 也欢迎您拨打华硕海星服务 7x24 小时免费技术支持专线 400-620-6655，由我们的在线工程师为您提供服务；
  6. 如果您使用的华硕产品由于硬件故障，需要维修服务，您可以直接联系您的经销商，通过经销商及遍布全国的华硕展示服务中心进行后续相应的检修服务。
  7. 无论通过何种方式来寻求技术服务，请您务必明确告知您使用的产品型号、BIOS 版本、搭配之硬件、详细的故障现象等，以利于华硕工程师能帮助您更加准确快速地判断出故障的原因。

用  
户  
填  
写  
数  
据

|       |  |       |  |
|-------|--|-------|--|
| 用户名称  |  | 购买日期  |  |
| 联系人   |  | 联系电话  |  |
| 联系地址  |  |       |  |
| 经销商名称 |  | 产品种类  |  |
| 产品型号  |  | 产品序列号 |  |
| 经销商印章 |  |       |  |





### **Offer to Provide Source Code of Certain Software**

This product contains copyrighted software that is licensed under the General Public License ("GPL"), under the Lesser General Public License Version ("LGPL") and/or other Free Open Source Software Licenses. Such software in this product is distributed without any warranty to the extent permitted by the applicable law. Copies of these licenses are included in this product.

Where the applicable license entitles you to the source code of such software and/or other additional data, you may obtain it for a period of three years after our last shipment of the product, either

(1) for free by downloading it from <http://support.asus.com/download>

or

(2) for the cost of reproduction and shipment, which is dependent on the preferred carrier and the location where you want to have it shipped to, by sending a request to:

ASUSTeK Computer Inc.

Legal Compliance Dept.

15 Li Te Rd.,

Beitou, Taipei 112

Taiwan

In your request please provide the name, model number and version, as stated in the About Box of the product for which you wish to obtain the corresponding source code and your contact details so that we can coordinate the terms and cost of shipment with you.

The source code will be distributed WITHOUT ANY WARRANTY and licensed under the same license as the corresponding binary/object code.

This offer is valid to anyone in receipt of this information.

ASUSTeK is eager to duly provide complete source code as required under various Free Open Source Software licenses. If however you encounter any problems in obtaining the full corresponding source code we would be much obliged if you give us a notification to the email address [gpl@asus.com](mailto:gpl@asus.com), stating the product and describing the problem (please DO NOT send large attachments such as source code archives, etc. to this email address).

### **Google™ License Terms**

#### **Copyright© 2014 Google Inc. All Rights Reserved.**

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at: <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

# 目录内容

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 安全性须知 .....                 | ix    |
| 关于这本用户手册 .....              | xi    |
| MAXIMUS VII HERO 规格列表 ..... | xiv   |
| 产品包装 .....                  | xviii |
| 创建 PC 系统所需的其他工具与元件 .....    | xix   |

## 第一章：产品介绍

|                            |      |
|----------------------------|------|
| 1.1 特殊功能 .....             | 1-1  |
| 1.1.1 产品特写 .....           | 1-1  |
| 1.1.2 玩家共和国（ROG）游戏功能 ..... | 1-3  |
| 1.1.3 玩家共和国（ROG）独家功能 ..... | 1-4  |
| 1.1.4 华硕独家功能 .....         | 1-4  |
| 1.1.5 ROG 搭配软件 .....       | 1-5  |
| 1.2 主板概述 .....             | 1-6  |
| 1.2.1 主板安装前 .....          | 1-6  |
| 1.2.2 主板结构图 .....          | 1-7  |
| 1.2.3 中央处理器（CPU） .....     | 1-9  |
| 1.2.4 系统内存 .....           | 1-10 |
| 1.2.5 扩展插槽 .....           | 1-24 |
| 1.2.6 主板上的内置开关 .....       | 1-27 |
| 1.2.7 内置 LED 指示灯 .....     | 1-31 |
| 1.2.8 内部接口 .....           | 1-39 |

## 第二章：硬件设备信息

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| 2.1 创建您的电脑系统 .....             | 2-1  |
| 2.1.1 安装主板 .....               | 2-1  |
| 2.1.2 安装中央处理器 .....            | 2-3  |
| 2.1.3 处理器散热片与风扇安装 .....        | 2-4  |
| 2.1.4 安装内存条 .....              | 2-6  |
| 2.1.5 安装 ATX 电源 .....          | 2-7  |
| 2.1.6 安装 SATA 设备 .....         | 2-8  |
| 2.1.7 安装前面板输出/输入接口 .....       | 2-9  |
| 2.1.8 安装扩展卡 .....              | 2-10 |
| 2.2 BIOS 更新应用程序 .....          | 2-11 |
| 2.2.1 USB BIOS Flashback ..... | 2-11 |
| 2.3 主板后侧与音频接口 .....            | 2-12 |
| 2.3.1 后面板接口 .....              | 2-12 |
| 2.3.2 音频输出/输入连接图标说明 .....      | 2-13 |
| 2.4 第一次启动电脑 .....              | 2-17 |
| 2.5 关闭电源 .....                 | 2-17 |

# 目录内容

## 第三章：BIOS 程序设置

|  |      |
|--|------|
| 3.1 认识 BIOS 程序.....                                | 3-1  |
| 3.2 BIOS 程序设置.....                                 | 3-2  |
| 3.2.1 EZ Mode.....                                 | 3-3  |
| 3.2.2 Advanced Mode.....                           | 3-4  |
| 3.3 我的最爱 (My Favorites) 菜单 .....                   | 3-7  |
| 3.4 Extreme Tweaker 菜单 .....                       | 3-8  |
| 3.5 主菜单 (Main Menu) .....                          | 3-23 |
| 3.6 高级菜单 (Advanced menu) .....                     | 3-26 |
| 3.6.1 处理器设置 (CPU Configuration) .....              | 3-27 |
| 3.6.2 PCH 设置 (PCH Configuration) .....             | 3-30 |
| 3.6.3 PCH 存储设备设置 (PCH Storage Configuration) ..... | 3-31 |
| 3.6.4 系统代理设置 (System Agent Configuration) .....    | 3-33 |
| 3.6.5 USB 设备设置 (USB Configuration) .....           | 3-35 |
| 3.6.6 平台各项设置 (Platform Misc Configuration) .....   | 3-36 |
| 3.6.7 内置设备设置 (OnBoard Devices Configuration) ..... | 3-37 |
| 3.6.8 高级电源管理设置 (APM Configuration) .....           | 3-39 |
| 3.6.9 网络协议堆栈 (Network Stack) .....                 | 3-40 |
| 3.6.10 ROG Effects.....                            | 3-40 |
| 3.7 监控菜单 (Monitor menu) .....                      | 3-41 |
| 3.8 启动菜单 (Boot menu) .....                         | 3-44 |
| 3.9 工具菜单 (Tool menu) .....                         | 3-50 |
| 3.9.1 ASUS EZ Flash 2 .....                        | 3-50 |
| 3.9.2 ROG Secure Erase.....                        | 3-50 |
| 3.9.3 显卡信息 (Graphics Card Information) .....       | 3-52 |
| 3.9.4 ASUS Overclocking Profile .....              | 3-52 |
| 3.9.5 ASUS SPD Information.....                    | 3-53 |
| 3.9.6 ROG OC Panel H-Key Configure.....            | 3-54 |
| 3.10 退出 BIOS 程序 (Exit menu) .....                  | 3-55 |
| 3.11 更新 BIOS 程序.....                               | 3-56 |
| 3.11.1 EZ Update .....                             | 3-56 |
| 3.11.2 华硕 EZ Flash 2 .....                         | 3-57 |
| 3.11.3 华硕 CrashFree BIOS 3.....                    | 3-58 |
| 3.11.4 华硕 BIOS Updater .....                       | 3-59 |

## 第四章：软件支持

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 4.1 安装操作系统.....              | 4-1 |
| 4.2 驱动及应用程序 DVD 光盘信息.....    | 4-1 |
| 4.2.1 运行驱动及应用程序 DVD 光盘 ..... | 4-1 |
| 4.2.2 取得软件用户手册 .....         | 4-2 |

# 目录内容

|  |      |
|--|------|
| 4.3 软件信息.....                                      | 4-3  |
| 4.4 华硕智能管家 3 代 (AI Suite 3) 程序.....                | 4-3  |
| 4.5 双智能处理器 5 (Dual Intelligent Processors 5) ..... | 4-6  |
| 5-Way Optimization (5-Way 最佳化) .....               | 4-6  |
| TPU (TurboV Processing Unit) .....                 | 4-7  |
| EPU (Energy Processing Unit) .....                 | 4-9  |
| DIGI+ 程序 .....                                     | 4-10 |
| Fan Xpert 3 .....                                  | 4-11 |
| Turbo App (Turbo 应用程序) .....                       | 4-12 |
| 华硕 USB 3.0 Boost 程序.....                           | 4-13 |
| EZ Update .....                                    | 4-14 |
| 系统信息.....  | 4-15 |
| USB BIOS Flashback 向导.....                         | 4-17 |
| 华硕充电专家 (USB Charger+) .....                        | 4-18 |
| 推播信息 (Push Notice) .....                           | 4-19 |
| 4.6 ROG 音频功能.....                                  | 4-22 |
| Sonic Studio .....                                 | 4-22 |
| Sonic SenseAmp.....                                | 4-24 |
| Sonic SoundStage .....                             | 4-26 |
| DTS Connect .....                                  | 4-27 |
| 4.7 Sonic Radar II 软件 .....                        | 4-28 |
| 4.8 GameFirst III .....                            | 4-30 |
| 4.9 KeyBot .....                                   | 4-33 |
| 4.10 ASUS Media Streamer .....                     | 4-35 |
| 4.11 ASUS Disk Unlocker.....                       | 4-37 |
| 4.12 RAMDisk .....                                 | 4-38 |
| 4.13 MemTweakIt.....                               | 4-41 |
| 4.14 ROG CPU-Z .....                               | 4-43 |

## 第五章：RAID 支持

|   |     |
|---|-----|
| 5.1 RAID 功能设置.....  | 5-1 |
| 5.1.1 RAID 定义.....  | 5-1 |
| 5.1.2 安装 Serial ATA (SATA) 硬盘 .....                         | 5-2 |
| 5.1.3 在 BIOS 程序中设置 RAID.....                                | 5-2 |
| 5.1.4 进入 Intel® Rapid Storage Technology Option ROM 应用程序 .. | 5-3 |
| 5.2 创建一张搭载有 RAID 驱动程序的软盘.....                               | 5-7 |
| 5.2.1 在不进入操作系统状态下创建 RAID 驱动程序软盘 .....                       | 5-7 |
| 5.2.2 在 Windows® 操作系统中创建 RAID 驱动程序软盘 .....                  | 5-8 |
| 5.2.3 在安装 Windows® 操作系统时安装 RAID 驱动程序 .....                  | 5-8 |

## 附录

|               |     |
|---------------|-----|
| 华硕的联络信息 ..... | A-1 |
|---------------|-----|

# 安全性须知

## 电气方面的安全性

- 为避免可能的电击造成严重损害，在搬动电脑主机之前，请先将电脑电源线暂时从电源插槽中拔掉。
- 当您要加入硬件设备到系统中或者要移除系统中的硬件设备时，请务必先连接该设备的信号线，然后再连接电源线。可能的话，在安装硬件设备之前先拔掉电脑的电源（PSU）电源线。
- 当您要从主板连接或拔除任何的信号线之前，请确定所有的电源线已事先拔掉。
- 在使用扩展卡之前，我们推荐您可以先寻求专业人士的协助。这些设备有可能会干扰接地的回路。
- 请确定电源（PSU）的电压设置已调整到本国/本区域所使用的电压标准值。若您不确定您所属区域的供应电压值为何，那么请就近询问当地的电力公司人员。
- 如果电源（PSU）已损坏，请不要尝试自行修复。请将之交给专业技术人员或经销商来处理。

## 操作方面的安全性

- 在您安装主板以及加入硬件设备之前，请务必详加阅读本手册所提供的相关信息。
- 在使用产品之前，请确定所有的排线、电源线都已正确地连接好。若您发现有任何重大的瑕疵，请尽快联络您的经销商。
- 为避免发生电气短路情形，请务必将其所有没用到的螺丝、回形针及其他零件收好，不要遗留在主板上或电脑主机中。
- 灰尘、湿气以及剧烈的温度变化都会影响主板的使用寿命，因此请尽量避免放置在这些地方。
- 请勿将电脑主机放置在容易摇晃的地方。
- 若在本产品的使用上有任何的技术性问题，请和经过检定或有经验的技术人员联络。

## REACH 信息

注意：谨遵守 REACH(Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) 管理规范，我们会将产品中的化学物质公告在华硕 REACH 网站，详细请参考 <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>。



请勿将本主板当作一般垃圾丢弃。本产品零组件设计为可回收利用。这个打叉的垃圾桶标志表示本产品（电器与电子设备）不应视为一般垃圾丢弃，请依照您所在地区有关废弃电子产品的处理方式处理。



请勿将内含汞的电池当作一般垃圾丢弃。这个打叉的垃圾桶标志表示电池不应视为一般垃圾丢弃。

## 产品回收与处理

华硕与资源回收业者以最高标准相互配合，以保护我们的环境，确保工作者的安全，以及遵从全球有关环境保护的法律规定。我们保证以资源回收的方式回收以往生产的旧设备，通过多样的方式保护环境。

如欲了解更多关于华硕产品资源回收信息与联络方式，请连在线网至 CSR (Corporate Social Responsibility) 网页：<http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>。

## 警语

经型式认证合格之低功率射频电机，非经许可，公司、商号或用户均不得擅自变更频率、加大功率或变更原设计之特性及功能。

低功率射频电机之使用不得影响飞航安全及干扰合法通信；经发现有干扰现象时，应立即停用，并改善至无干扰时方得继续使用。

前项合法通信，指依电信法规定操作之无线通信。

低功率射频电机须忍受合法通信或工业、科学及医疗用电波辐射性电机设备之干扰。

## 射频 (RF) 设备须知

### NCC: Taiwan Wireless Statement

#### 無線設備的警告聲明

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更射頻、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信指依電信法規定作業之無線通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

於 5.25GHz 至 5.35GHz 區域內操作之  
無線設備的警告聲明

工作頻率 5.250 ~ 5.350GHz 該頻段限於室內使用。

# 关于这本用户手册

产品用户手册包含了所有当您在安装本主板时所需用到的信息。

## 用户手册的编排方式

用户手册是由下面几个章节所组成：

- 第一章：产品介绍

您可以在本章节中发现诸多华硕所赋予本主板的优异特色。利用简洁易懂的说明让您能很快地掌握本主板的各项特性，当然，在本章节中我们也会提及所有能够应用在本主板的新产品技术。

- 第二章：硬件设备信息

本章节描述所有您在安装系统元件时必须完成的硬件安装程序。详细内容有：处理器与内存安装、跳线选择区设置以及主板的各种设备接口。

- 第三章：BIOS 程序设置

本章节描述如何使用 BIOS 设置程序中的每一个菜单项目来更改系统的配置设置。此外也会详加介绍 BIOS 各项设置值的使用时机与参数设置。

- 第四章：软件支持

您可以在本章节中找到所有包含在华硕驱动程序及应用程序光盘中的软件相关信息。

- 第五章：RAID 支持

本章节介绍 RAID 的各项设置。

- 附录

在本附录里将列出相关的联络信息与认证信息。

## 提示符号

为了能够确保您正确地完成主板设置，请务必注意下面这些会在本手册中出现的标示符号所代表的特殊含意。



警告：提醒您在进行某一项工作时要注意您本身的安全。



小心：提醒您在进行某一项工作时要注意勿伤害到电脑主板元件。



重要：此符号表示您必须要遵照手册所描述之方式完成一项或多项软硬件的安装或设置。



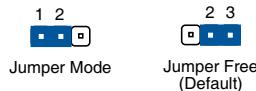
注意：提供有助于完成某项工作的诀窍和其他额外的信息。

## 跳线帽及图标说明

主板上有一些小小的塑料套，里面有金属导线，可以套住选择区的任二只针脚（Pin）使其相连而成一通路（短路），本手册称之为跳线帽。

有关主板的跳线帽使用设置，兹利用以下图标说明。以下图为例，欲设置为「Jumper™ Mode」，需在选择区的第一及第二只针脚部份盖上跳线帽，本手册图标即以涂上底色代表盖上跳线帽的位置，而空白的部份则代表空接针。以文字表示为：[1-2]。

因此，欲设置为「JumperFree™ Mode」，以右图表示即为在「第二及第三只针脚部份盖上跳线帽」，以文字表示即为：[2-3]。



## 哪里可以找到更多的产品信息

您可以经由下面所提供的两个渠道来获得您所使用的华硕产品信息以及软硬件的升级信息等。

### 1. 华硕网站

您可以到 <http://www.asus.com.cn> 华硕电脑互联网取得所有关于华硕软硬件产品的各项信息。台湾地区以外的华硕网址请参考手册最后附录里的联络信息。

### 2. 其他文件

在您的产品包装盒中除了本手册所列举的标准配件之外，也有可能会夹带其他的文件，譬如经销商所附的产品保修单据等。



电子信息产品污染控制标示：图中之数字为产品之环保使用期限。  
仅指电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄或突变  
从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。

有毒有害物质或元素的名称及含量说明标示：

| 部件名称        | 有害物质或元素 |       |       |                 |               |                 |
|-------------|---------|-------|-------|-----------------|---------------|-----------------|
|             | 铅(Pb)   | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬<br>(Cr(VI)) | 多溴联苯<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>(PBDE) |
| 印刷电路板及其电子组件 | ×       | ○     | ○     | ○               | ○             | ○               |
| 外部信号连接口及线材  | ×       | ○     | ○     | ○               | ○             | ○               |

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟命令 2002/95/EC 的规范。

备注：此产品所标示的环保使用期限，是指在一般正常使用状况下。

# MAXIMUS VII HERO 规格列表

|           |  |
|-----------|--|
| 中央处理器     | 支持采用 LGA1150 规格插槽的第四代/全新第四代/第五代 Intel® Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium/Celeron 处理器<br>支持 22nm 处理器<br>支持 Intel® Turbo Boost 2.0 技术*<br><br>*对 Intel® Turbo Boost 2.0 技术的支持依照处理器的类型而不同<br>**请访问 <a href="http://www.asus.com.cn">www.asus.com.cn</a> 取得最新的 Intel 处理器支持列表  |
| 芯片组       | Intel® Z97 Express 芯片组   |
| 内存        | 支持双通道内存结构<br>4 x 使用符合 non-ECC unbuffered DDR3 3200 (超频) */3100 (超频) */3000 (超频) */2933 (超频) */2800 (超频) */2666 (超频) */2600 (超频) */2500 (超频) */2400 (超频) */2200 (超频) */2133 (超频) */2000 (超频) */1866 (超频) */1800 (超频) */1600/1333 MHz 内存，最高可以扩展至 32GB 内存<br>支持 Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 技术<br><br>*对高速内存的支持会受到特定处理器之物理特性的影响<br>**请访问 <a href="http://www.asus.com.cn">www.asus.com.cn</a> 或参考本用户手册取得内存合格供应商支持列表 (OVL) |
| 扩展槽       | 2 x PCIe 3.0/2.0 x16 插槽 (红色，单通道支持 x16 模式或双通道支持 x8/x8 模式)<br>1 x PCIe 2.0 x16 插槽 (黑色，最高支持 x4 模式) *<br>3 x PCIe 2.0 x1 插槽**<br><br>*PCIe 2.0 x1 与 M.2 插槽共享 PCIe 2.0 x16 插槽相同带宽。默认值为 Auto 模式。<br><br>**当 PCIe 2.0 x16 插槽 (PCIE4_3) 于 M.2 模式下运作时，PCIe 2.0 x1 插槽 (PCIE1_1-3) 则会关闭<br><br>**当 PCIe 2.0 x16 插槽 (PCIE4_3) 在 PCIe x4 模式下运作时，PCIe 2.0 x1 插槽 (PCIE1_1-3) 与 M.2 插槽则会关闭   |
| 图形显示控制器   | 集成式 Intel® HD 绘图处理器<br>支持 HDMI，最高分辨率可达 4096 × 2160 @ 24Hz / 2560 × 1600 @ 60Hz<br>DVI-D 最高分辨率可达 1920 × 2000 @ 60Hz<br>RGB 最高分辨率可达 1920 × 2000 @ 60Hz<br>支持 Intel® InTru™ 3D、Intel® Quick Sync Video、Intel® Clear Video HD 技术 与 Intel® Indiserm™  |
| 多重图形显示控制器 | 支持 Quad-GPU NVIDIA® SLI™ / AMD CrossFireX™ 技术  |

(下页继续)

# MAXIMUS VII HERO 规格列表

|         |   |
|---------|---|
| 存储设备连接槽 | <p>Intel® Z97 Express 芯片组:<br/>6 x SATA 6Gb/s 接口<br/>- Intel® Rapid Storage 技术 13 支持 RAID 0、1、5 与 10<br/>- 支持 Intel® Smart Response (智能回应) 技术、Intel® Rapid Start 技术，以及 Intel® Smart Connect (智能连接) 技术*</p> <p>1 x 具备 M Key 的 M.2 Socket 3，支持类型 2260/2280 的存储设备 (PCIE x2 通道) **</p> <p>ASMedia® SATA 6Gb/s 控制器：<br/>- 2 x SATA 6Gb/s 接口***</p> <p>*这些功能的运作取决于安装的处理器类型</p> <p>**只支持 PCIe 接口</p> <p>***这些 SATA 接口只能数据碟使用，不支持 ATAPI (光驱) 设备</p> |
| 网络功能    | <p>1 x Intel® I218V Gigabit LAN 网络控制器<br/>Anti-surge LANGuard 以太网接口<br/>ROG GameFirst III</p>   |
| 音频功能    | <p>ROG SupremeFX 8 声道高保真音频编码器*<br/>- SupremeFX Shielding 技术<br/>- ELNA® 高级音响电容<br/>- 完整无失真 DVD 光盘音频、蓝光光盘音频与 HD-DVD 音频内容保护<br/>- 支持音频接口检测、多音源独立输出 (Multi-Streaming) 技术与前面板音频插孔功能<br/>- 后面板具备光纤 S/PDIF 数码输出接口</p> <p>音频功能：<br/>- Sonic Rader II<br/>- Sonic Studio<br/>- Sonic SoundStage<br/>- Sonic SenseAmp<br/>- DTS Connect</p>  |
| USB     | <p>Intel® Z97 Express 芯片组：<br/>6 x USB 3.0 接口 (4 接口在主板后面板 [蓝色]；2 接口在主板中央 [红色]) *<br/>7 x USB 2.0 接口 (2 接口在主板后面板，5 接口在主板中央) **</p> <p>*支持华硕 USB 3.0 Boost, UASP 标准在 Intel® 原生 USB 3.0 上只支持 Windows® 8 / 8.1 操作系统</p> <p>**1 个位于主板中央 USB 2.0 (USB13) 接口与 ROG extension (ROG_EXT) 接口共享</p>   |
| 后面板设备接口 | <p>1 x PS/2 键盘/鼠标复合接口<br/>2 x USB 2.0 接口<br/>1 x USB BIOS Flashback 按钮<br/>1 x 光纤 S/PDIF 输出接口<br/>1 x HDMI 接口</p>   |

(下页继续)

# MAXIMUS VII HERO 规格列表

|   |   |
|---|---|
| 后面板设备接口   | <ul style="list-style-type: none"><li>1 × RGB (VGA) 接口</li><li>1 × DVI-D (DVI) 接口</li><li>4 × USB 3.0 接口 [蓝色]</li><li>1 × Anti-surge (RJ-45) 网络接口</li><li>6 × 八声道镀金音频接口</li></ul>   |
| ROG 独家超频功能                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Extreme Engine Digi+ III<ul style="list-style-type: none"><li>- 全数码 CPU/内存电源</li><li>- NexFET™ Power Block MOSFET</li><li>- 60A Ferrite Choke</li><li>- 10K 黑色金属固态电容</li></ul></li><li>KeyBot<ul style="list-style-type: none"><li>- CPU Level Up</li><li>- XMP</li><li>- DirectKey</li></ul></li><li>ROG RAMDisk</li><li>UEFI BIOS 功能<ul style="list-style-type: none"><li>- Extreme Tweaker</li><li>- Tweaker's Paradise</li><li>- ROG SSD Secure Erase</li><li>- GPU.DIMM Post</li><li>- O.C. Profile</li><li>- Graphics Card information Preview (显卡信息预览)</li></ul></li></ul> |
| 华硕第五代智能双处理器 (ASUS Dual Intelligent Processor 5) | <ul style="list-style-type: none"><li>- 五向全方位优化调校，集成 DIGI+ 电源控制、TPU 、EPU、Turbo App 与 Fan Xpert 3</li></ul>  |
| 华硕独家功能  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Push Notice (推播信息)</li><li>- 智能管家 3 代</li><li>- USB 3.0 Boost</li><li>- 华硕充电专家</li><li>- Ai Charger</li><li>- Disk Unlocker</li></ul> <p>华硕 EZ DIY</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- USB BIOS Flashback</li><li>- 华硕 CrashFree BIOS 3 应用程序</li><li>- 华硕 EZ Flash 2 应用程序</li><li>- 华硕 C.P.R. (CPU 参数自动恢复)</li></ul> <p>华硕 Q-Design</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 华硕 Q-Code</li><li>- 华硕 Q-Shield</li><li>- 华硕 Q-Connector</li><li>- 华硕 Q-LED (CPU、内存、显卡、启动设备指示灯)</li><li>- 华硕 Q-Slot</li><li>- 华硕 Q-DIMM</li></ul>                                       |

(下页继续)

# MAXIMUS VII HERO 规格列表

|         |  |
|---------|--|
| 内部接口    | 1 × USB 3.0 接口（可扩展 2 个 USB 3.0 接口）<br>3 × USB 2.0 接口（可扩展 5 个 USB 2.0 接口，1 个接口并<br>与 ROG_EXT 接口共用）<br>1 × ROG extension (ROG_EXT) 接口<br>8 × SATA 6Gb/s 插座<br>1 × 4-pin 处理器风扇插座<br>1 × 4-pin 处理器选用风扇插座<br>4 × 4-pin 机箱风扇插座<br>1 × 24-pin EATX 电源插座<br>1 × 8-pin EATX 12V 电源插座<br>1 × 清除 CMOS 按钮<br>1 × 电源按钮<br>1 × 重置按钮<br>1 × MemOK! 按钮<br>1 × 前置面板音频插座 (AAFP)<br>1 × 系统面板插座<br>1 × TPM 插座<br>1 × Sonic SoundStage 按钮<br>1 × KeyBot 按钮<br>1 × Thermal sensor connectors (T-Sensor) 插座 |
| BIOS 功能 | 64 Mb Flash ROM、UEFI AMI BIOS、PnP、DMI 2.7、WfM<br>2.0、SM BIOS 2.7、ACPI 5.0a、多国语言 BIOS   |
| 管理功能    | WfM 2.0、DMI 2.7、网络唤醒功能 (WOL by PME)<br>、PXE  |
| 软件程序    | 驱动程序<br>ROG GameFirst III<br>ROG RAMDisk<br>ROG CPU-Z 程序<br>ROG Mem TweakIt<br>Kaspersky® 防毒软件<br>DAEMON Tools Pro Standard 版<br>华硕 WebStorage 云端存储空间<br>HOME Cloud<br>华硕应用程序  |
| 机箱尺寸    | ATX 型式：12 × 9.6 英寸 (30.5 厘米 × 24.4 厘米)   |



规格若有任何变更，恕不另行通知。

## 产品包装

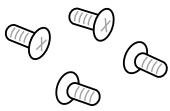
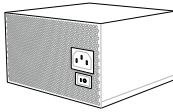
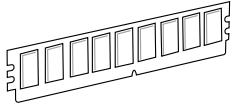
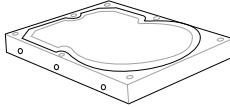
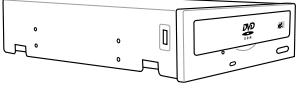
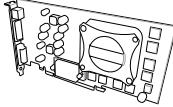
请检查下面所列出的各项标准配件是否齐全。

|        |  |
|--------|--|
| 主板     | ROG MAXIMUS VII HERO 主板  |
| 排线     | 3 × 2 合 1 SATA 6Gb/s 排线<br>1 × SLI® 桥接器                                      |
| 配件     | 1 × I/O 挡板<br>1 × 12 合 1 ROG 排线贴纸<br>1 × 2 合 1 Q-Connector 套件<br>1 × ROG 门挂钩 |
| 应用程序光盘 | ROG 主板驱动及应用程序 DVD 光盘   |
| 相关文件   | 用户手册   |



若以上列出的任何一项配件有损坏或是短缺的情形，请尽快与您的经销商联络。

## 创建 PC 系统所需的其他工具与元件

|   |   |
|---|---|
|  |  |
| 一袋螺丝  | Philips (十字) 螺丝起子   |
|  |  |
| PC 机箱   | 电源供应设备  |
|  |  |
| Intel LGA 1150 处理器  | Intel LGA 1150 兼容处理器风扇  |
|  |  |
| DDR3 内存条  | SATA 硬盘   |
|  |  |
| SATA 光驱（选购）   | 显卡（选购）  |



上表所列的工具与元件并不包含在主板包装盒内。



# 第一章

## 1.1 特殊功能

### 1.1.1 产品特写

#### 玩家共和国 (Republic of Gamers)

玩家共和国只提供最优质的产品。我们提供最佳的硬件设计、最高速的性能与最创新的设计，欢迎对硬件规格有高度要求的玩家一同加入！

在玩家共和国的国度中，仁慈怜悯是弱者的行为，勇于挺身而出才是唯一王道。我们敢说我们擅长竞争，如果您的个性符合我们的特性，请加入我们的菁英俱乐部，在玩家共和国中让大家感受您的存在。

支持 LGA1150 规格的第四代/全新第四代/第五代 Intel® Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® 处理器

本主板支持最新 LGA1150 封装的第四代/全新第四代/第五代 Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® 处理器，并通过 GPU、双通道 DDR3 内存插槽与 PCI Express 2.0/3.0 扩展插槽，能提供最佳的绘图显示与系统运算性能。

#### 采用 Intel® Z97 Express 芯片组

Intel® Z97 Express 芯片组采用最新的单芯片设计，是专为支持最新的 LGA1150 插槽的第四代/全新第四代/第五代 Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® 处理器所设计，通过连续的点对点链接增加带宽与稳定性，并增强系统性能。原生支持高达六组 USB 3.0 接口、六组 SATA 6 Gb/s 接口与 M.2 规格，提供更快速的数据存取速度。此外，Intel® Z97 Express 芯片组并支持 iGPU 功能，让用户享受最新的 Intel 集成绘图性能。

#### PCIE® 3.0

最新的 PCIE® 3.0 (PCIe 3.0) 总线标准提供比当前 PCIe 2.0 快二倍的性能，x16 的总带宽可达 32GB/s，双倍于 PCIe 2.0 (x16 模式) 的 16GB/s。PCIe 3.0 提供用户前所未有的数据传输速度，提供与 PCIe 1.0 及 PCIe 2.0 设备完全向下兼容的便利与无缝传输。

#### SLI®/CrossFireX™ On-Demand 技术

本主板独特的 PCIe 3.0 桥接芯片，支持多重 GPU SLI®/CrossFireX™ 显卡，提供无与伦比的游戏性能。搭配 Intel® Z97 平台最佳化多重 GPU 的 PCIe 配置，可以支持最高 2-WAY SLI® 或 CrossFireX™ 设置。

## 支持 M.2 规格

本主板配备有 M.2 插槽，与 PCI Express x2 插槽共享带宽，数据传输率最高可达 10 Gb/s，可以用来增强指定给操作系统使用的 SSD 的性能。M.2 插槽也支持 Intel Rapid Storage 技术，可以更快速的读取数据与应用程序，以及更快速地唤醒系统。



- 只支持 PCIe 接口。
- 支持 2260 (22mm x 60mm) 与 2280 (22mm x 80mm) SSD 卡。

## 完全集成 USB 3.0

华硕提供完整的 USB 3.0 支持能力，在前面板与后面板搭载了 USB 3.0 接口，让 USB 3.0 的使用更加容易。体验最新的即插即用连接传输速度，较 USB 2.0 的传输率快达十倍。

## 1.1.2 玩家共和国（ROG）游戏功能

### SupremeFX

经过重新设计的 ROG 独家 SupremeFX 音频技术的特点为内置八声道高保真音频，具备等同于真正音响级性能的电源、高保真与频率范围的声卡。其专属的 Red Line Shielding 与特殊的金属保护盖，提供清晰无暇的声音和极具引人注目的主板外观设计，符合 ROG 玩家的风格。采用高级日本制 ELNA 电容，确保在游戏和多介质播放时有热情自然的音频表现。

SupremeFX 能彻底改变您所听到的游戏、电影、音乐，甚至与其他人聊天通信的方式 - 一切由您所决定，并且发掘优异的音频表现而达到一个全新体验的境界。

### Sonic Rader II

Sonic Rader II 采用独家的音频增强技术，可以增强在游戏中的音频有更好的听位辨识。可以在游戏画面上堆栈显示，帮助您实时得知对手和队友所在的具体位置，屏幕上的雷达可精确显示枪声、脚步声等来源，在玩第一人称射击（FSP）游戏时以提供更好的精确方位，不给对手任何攻击偷袭的机会。

### Sonic Studio

Sonic Studio 是一个音频调整软件，能模拟 7.1 声道，甚至通过立体声（2.0 双声道）耳机也能模拟出环绕音频的效果。此软件提供了包含六项音频设置：Reverb（回音）、Bass Boost（重低音）、Equalizer（等化器）、Voice Clarity（语音清晰）、Smart EQ（Smart Volume）与 Virtual Surround（虚拟环绕）功能。

### Sonic SoundStage

Sonic SoundStage 为内置的音频解决方案，以提高您在连接前面板耳机时的音频体验。可使用于任何的操作系统与任何游戏，您可以从四个默认值做选择，也可以手动方式微调想要的专属设置，并应用在您的游戏中。

### Sonic SenseAmp

Sonic SenseAmp 是 ROG 独家功能，可以自动检测您所连接的耳机阻抗，并且能配合调整内置扩大机以符合使用。只需将耳机连接后，便可以让您通过 Sonic SenseAmp 轻松调整您的高保真耳机。

### GameFirst III

华硕 GameFirst III 是一个网络管理软件，提供四种默认封包优先处理设置档（最佳化、游戏、串流介质与文件共享），以便于用户的需求。用户也可以手动分配带宽，并调整设置每个应用程序的优先顺序，让运行速度更快、更流畅。

### Intel® 以太网

由 Intel 所提供的网络解决方案，拥有久负盛名提供更好的处理能力、使用较低的 CPU 资源以及更好的稳定性。具备先进的中断处理，低功耗以及 Intel Stable Image Platform (SIPP) 的支持，有益于与 Intel CPU 和芯片组的兼容性。

### 1.1.3 玩家共和国（ROG）独家功能

#### Extreme Engine Digi+ III

Extreme Engine Digi+ III 提供硬派的功率传输，以符合具有挑战性与极致游戏的享受。采用极佳的原件，如 NexFET Power Block MOSFET，60A Ferrite Choke 与 10K 黑金电容，可以提供强大的耐用性与在正常使用下提供高达 90% 效率。10K 黑金电容较一般电容长达五倍使用寿命，比一般电容更常更宽 20%，且具有更好的低温耐用性，达到完美的主板超频性能。

#### RAMDisk

RAMDisk 可以使用部分系统内存将它变成一个高速的实体存储，提供您在此存储缓存文件与游戏程序而能达到立即读取。此外，延长 SSD 的生命周期，并保持您的主要存储最佳化，则是相当重要的任务，并且可以获得自动备份与恢复文件。



RAMDisk 只支持 64 位操作系统。

#### CPU Level Up 功能

只要使用玩家共和国的 CPU Level Up 功能就能升级您的 CPU 喔！只要选择您欲超频的处理器，剩下的就交给主板代劳。您只要看看新 CPU 的速度并立即享受它所带来的优异性能就对了！超频真是再简单不过了。

### 1.1.4 华硕独家功能

#### AI Suite 3

通过友善的用户界面，华硕 AI Suite 3 将所有的华硕独家功能集成在一个软件套件中，可以用来监督超频、电源管理、风扇速度控制、电压与感应器读数，甚至可以通过蓝牙与移动设备互动。这个集所有功能于一身的软件提供多样化与容易使用的功能，并且不需要在不同的应用程序间来回切换。

#### USB 3.0 Boost

全新华硕 USB 3.0 加速技术支持 UASP (USB Attached SCSI Protocol) 传输协议，是最新的 USB 3.0 标准。拥有 USB 3.0 加速技术，USB 设备传输速度可显着的提升约 170%，给人印象深刻的 USB 3.0 传输速度。USB 3.0 加速技术提供友善的图形界面，通过华硕独家设备自动检测设置，可以立即加速 USB 3.0 接口的传输速度。

#### USB BIOS Flashback

USB BIOS Flashback 提供有史以来最简单更新 BIOS 的方法。用户可以轻松尝试使用新的 BIOS 版本来进行超频，不需要进入 BIOS 或操作系统，只要插入 USB 存储设备然后按下 BIOS Flashback 按钮三秒钟，BIOS 程序就会自动在待机状态下更新，从此以后超频无须再烦恼，并拥有无与伦比的便利性。

## 1.1.5 ROG 搭配软件

### KeyBot

KeyBot是一个内置的微型处理器，可以瞬间将键盘升级。这项功能可以提供您设置和指派聚集至键盘上指定的按键，便能同时运行特定或多项任务。并且还可以设置电脑的在 CPU Level Up、XMP 的唤醒功能，或直接唤醒 BIOS 模式。



---

这项功能只支持 USB 键盘。

---

### Kaspersky® 防毒软件

Kaspersky® 个人防毒软件提供个人玩家与家庭办公用户优秀的病毒防护。此软件是基于高级的防毒技术，程序包含 Kaspersky® 防毒程序引擎，随时随地针对常见的恶意程序进行检测与提供高性能的防护。

### DAEMON Tools Pro 标准版程序

DAEMON Tools Pro 为提供 CD、DVD 与蓝光光盘备份使用的程序，可以将光学介质转成虚拟光盘与模拟设备来以虚拟复制方式运作。DAEMON Tools Pro 工具程序可以组合数据、音乐、图像与相片在电脑、笔记本电脑或 netbook 上面。

### ROG CPU-Z

ROG CPU-Z 为 CPUID 针对 ROG 所量身订做的版本。具备与原来版本相同的功能与可信度，并拥有独特的设计。使用全新外观的 ROG CPU-Z 来确实地回报 CPU 相关信息与展现您的独特性。

### Mem TweakIt

Mem TweakIt 是一个内存参数实时监控软件，您可以查询内存参数并且在 ROG 官方网站与其他 ROG 主板玩家比赛内存性能分数排名。

### DTS Connect

DTS Connect 包含 DTS Interactive 与 DTS Neo:PC™ 技术，DTS Neo:PC™ 可以将各种立体声信号，如：CD、MP3、WMA、网络收音机等转换成 7.1 声道，彻底发挥多声道音箱的威力，随时享受环绕音频。用户可以将电脑与家庭剧场连接，DTS Interactive 会将原本的音频重新编码成为 DTS 音频信号，通过数码音频接口如 S/PDIF 或 HDMI，从电脑传送至任何能兼容 DTS 的系统，提供您最佳的环绕音频。

## 1.2 主板概述

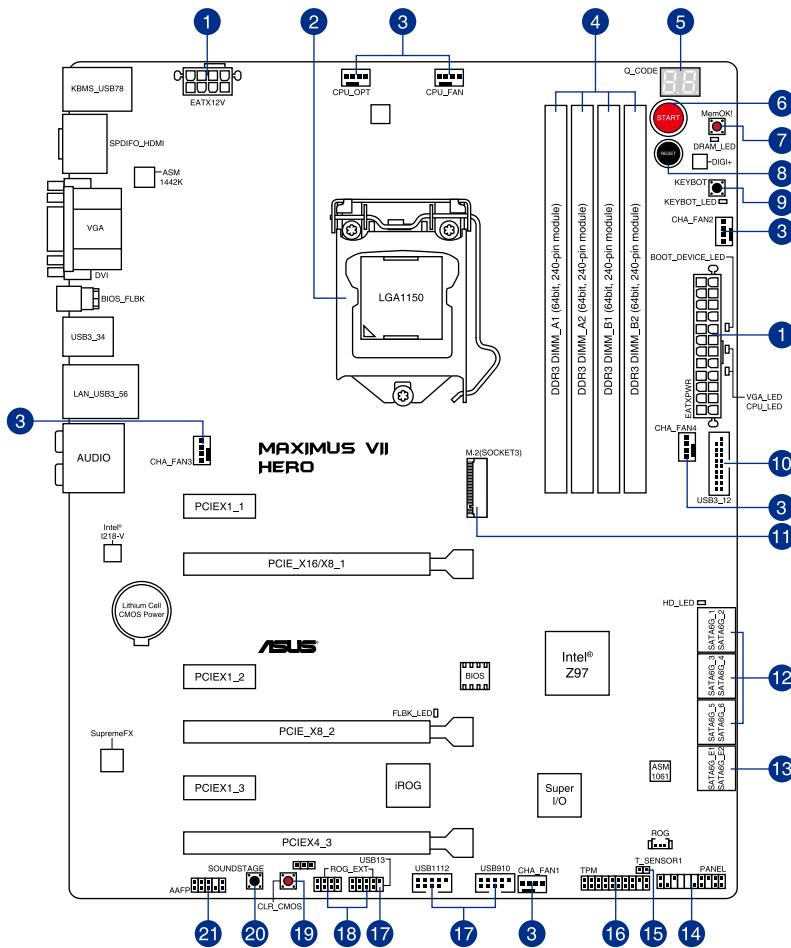
### 1.2.1 主板安装前

主板以及扩展卡都是由许多精密复杂的集成电路元件、集成性芯片等所构成。而这些电子性零件很容易因静电的影响而导致损坏，因此，在您动手更改主板上的任何设置之前，请务必先作好以下所列出的各项预防措施。



- 在处理主板上的内部功能设置时，您可以先拔掉电脑的电源线。
- 为避免生成静电，在拿取任何电脑元件时除了可以使用防静电手环之外，您也可以触摸一个有接地线的物品或者金属物品像电源外壳等。
- 拿取集成电路元件时请尽量不要触碰到元件上的芯片。
- 在您删除任何一个集成电路元件后，请将该元件放置在绝缘垫上以隔离静电，或者直接放回该元件的绝缘包装袋中保存。
- 在您安装或删除任何元件之前，请确认 ATX 电源的电源开关是切换到关闭（OFF）的位置，而最安全的做法是先暂时拔出电源的电源线，等到安装/删除工作完成后再将之接回。如此可避免因仍有电力残留在系统中而严重损及主板、外围设备、元件等。

### 1.2.2 主板结构图



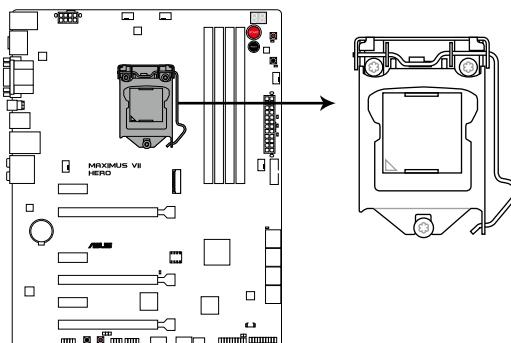
关于面板连接插座与内部连接插座的相关信息，请参考 [内部接口](#) 与 [后面板接口](#) 一节中的说明。

## 主板元件说明

| 连接插槽/跳线选择区/开关与按钮/插槽  | 页数   |
|--|------|
| 1. ATX power connectors (24-pin EATXPWR; 8-pin EATX12V)  | 1-44 |
| 2. LGA1150 CPU Socket  | 1-9  |
| 3. CPU, chassis, and optional fan connectors (4-pin CPU_FAN;<br>4-pin CPU_OPT; 4-pin CHA_FAN1-4) | 1-43 |
| 4. DDR3 DIMM slots   | 1-10 |
| 5. Q_Code LEDs   | 1-33 |
| 6. START (Power-on) button   | 1-27 |
| 7. MemOK! button   | 1-28 |
| 8. RESET button  | 1-27 |
| 9. KeyBot button (KeyBot)  | 1-41 |
| 10. USB 3.0 connector (20-1 pin USB3_12)   | 1-40 |
| 11. M.2 (Socket 3)   | 1-47 |
| 12. Intel® Z97 Serial ATA 6 Gb/s connectors (7-pin SATA6G_1-6 [red])                             | 1-39 |
| 13. ASMedia® Serial ATA 6 Gb/s connectors (7-pin SATA6G_E1/2 [red])                              | 1-40 |
| 14. System panel connector (20-8 pin PANEL)  | 1-45 |
| 15. T_Sensor connector (2-pin T_SENSOR1)   | 1-47 |
| 16. TPM connector (20-1 pin TPM)   | 1-46 |
| 17. USB 2.0 connectors (10-1 pin USB13, USB1112; USB910)   | 1-41 |
| 18. ROG Extension connector (18-1 pin ROG_EXT)   | 1-46 |
| 19. Clear CMOS button (CLR_CMOS)   | 1-29 |
| 20. Sonic SoundStage button (SOUNDSTAGE)   | 1-30 |
| 21. Front panel audio connector (10-1 pin AAFP)  | 1-42 |

### 1.2.3 中央处理器 (CPU)

本主板具备一个 LGA1150 处理器插槽，本插槽是专为第四代/全新第四代与第五代 Intel® Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® 处理器所设计。



**MAXIMUS VII HERO CPU LGA1150**



本插槽只支持 LGA1150 处理器，请确认并安装正确的处理器，请勿将 LGA1155 与 LGA1156 处理器安装于 LGA1150 插槽。



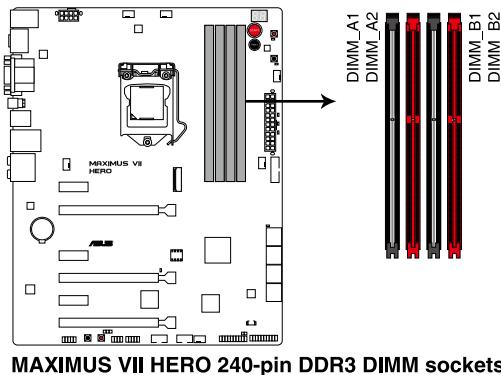
- 当您安装 CPU 时，请确认所有的电源接口都已拔除。
- 在您购买本主板之后，请确认在 LGA1150 插座上附有一个即插即用的保护盖，并且插座接点没有弯曲变形。若是保护盖已经毁损或是没有保护盖，或者是插座接点已经弯曲，请立即与您的经销商联络。
- 在安装完主板后，请将即插即用的保护盖保留下。只有 LGA1150 插槽上附有即插即用保护盖的主板符合 Return Merchandise Authorization (RMA) 的要求，华硕电脑才能为您处理产品的维修与保修。
- 本保修不包括处理器插座因遗失、错误的安装或不正确的移除即插即用保护盖所造成的毁损。

## 1.2.4 系统内存

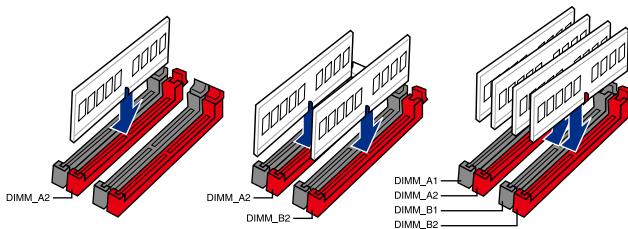
本主板配置有 4 组 DDR3 (Double Data Rate 3) 内存条插槽。



DDR3 内存条拥有与 DDR2 或 DDR 内存条相同的外观，但是 DDR3 内存插槽的缺口与 DDR2 或 DDR 内存插槽不同，以防止插入错误的内存条。



### 内存推荐设置



## 内存设置

您可以任意选择使用 1GB、2GB、4GB 与 8GB 的 unbuffered non-ECC DDR3 内存条至本主板的内存插槽上。



- 当内存条频率高于 2133MHz，并且相应时序或载入的 XMP 文件不是 JEDEC 标准时，内存条的稳定性与兼容性会依照处理器性能与其他已安装设备而有不同。
- 您可以在 Channel A 与 Channel B 安装不同容量的内存条，在双通道设置中，系统会检测较低容量通道的内存容量。任何在较高容量通道的其他内存容量，会被检测为单通道模式运行。
- 根据 Intel 处理器规格，推荐内存电压低于 1.65V 以保护处理器。
- 在本主板请使用相同 CL (CAS-Latency 行地址控制器延迟时间) 内存条。为求最佳兼容性，推荐您使用同一厂商的相同容量型号之内存。
- 由于 32-bit Windows 操作系统内存地址空间的限制，当您安装 4GB 或更多的内存条时，系统实际可用的总内存只有 3GB 或更少。为充分利用内存，您可以运行以下任一动作：
  - 若您使用 32-bit Windows 操作系统，推荐系统内存最高安装 3GB 即可。
  - 当主板安装 4GB 或更多的内存时，推荐您安装 64-bit Windows 操作系统。
  - 若需要更详细的数据，请访问 Microsoft 网站 <http://support.microsoft.com/kb/929605/zh-cn>。
- 本主板不支持 512 Mb (64MB) 芯片的内存条（内存容量以 Megabit 计算，8 Megabit/Mb=1 Megabyte/MB）。



- 默认的内存运作频率是根据其 SPD (Serial Presence Detect)。在默认状态下，某些内存条在超频时的运作频率可能会较供应商所标示的数值为低。若要让内存条以供应商的数值或更高的频率运作，请参考 3.4 Extreme Tweaker 菜单一节中，手动调整内存频率的说明。
- 在全负载 (4 DIMM) 或超频设置下，内存条可能需要更佳的冷却系统以维持运作的稳定。

## MAXIMUS VII HERO 主板合格供应商列表 (QVL) DDR3 3200MHz (超频)

| 供应商     | 型号                       | 容量            | SS/<br>DS | 芯片<br>厂商 | 芯片<br>型号 | 时序          | 电压    | 支持内存插<br>槽 (选购) |   |
|---------|--------------------------|---------------|-----------|----------|----------|-------------|-------|-----------------|---|
|         |                          |               |           |          |          |             |       | 2               | 4 |
| AVEXIR  | AVD3UH32001304G-4Cl(XMP) | 16GB (4x 4GB) | SS        | -        | -        | 13-15-15-35 | 1.65V | •               | • |
| G.SKILL | F3-3200C12Q-16GTXDG(XMP) | 16GB (4x 4GB) | SS        | -        | -        | 12-15-15-35 | 1.65V | •               | • |

## DDR3 3100MHz (超频)

| 供应商    | 型号                       | 容量            | SS/<br>DS | 芯片<br>厂商 | 芯片<br>型号 | 时序          | 电压    | 支持内存插<br>槽 (选购) |   |
|--------|--------------------------|---------------|-----------|----------|----------|-------------|-------|-----------------|---|
|        |                          |               |           |          |          |             |       | 2               | 4 |
| AVEXIR | AVD3UH31001204G-4Cl(XMP) | 16GB (4x 4GB) | SS        | -        | -        | 12-14-14-35 | 1.65V | •               | • |
| A-DATA | AX3U3100W4G12-DMV(XMP)   | 8GB (2x 4GB)  | SS        | -        | -        | 12-14-14-36 | 1.65V | •               | • |

## DDR3 3000MHz (超频)

| 供应商     | 型号                        | 容量            | SS/<br>DS | 芯片<br>厂商 | 芯片<br>型号 | 时序          | 电压    | 支持内存插<br>槽 (选购) |   |
|---------|---------------------------|---------------|-----------|----------|----------|-------------|-------|-----------------|---|
|         |                           |               |           |          |          |             |       | 2               | 4 |
| AVEXIR  | AVD3UH30001204G-4BZ1(XMP) | 16GB (4x 4GB) | SS        | -        | -        | 12-14-14-35 | 1.65V | •               | • |
| APACER  | 78.BAGHN.AFL0C            | 16GB (4x 4GB) | SS        |          |          | 12-14-14-35 | 1.65V | •               | • |
| G.SKILL | F3-3000C12Q-16GTXDG(XMP)  | 16GB (4x 4GB) | SS        | -        | -        | 12-14-14-35 | 1.65V | •               | • |
| G.SKILL | F3-3000C12D-8GTXDG(XMP)   | 8GB (2 x 4B)  | SS        |          |          | 12-14-14-35 | 1.65V | •               | • |
| CORSAIR | CMY8GX3M2A-3000C12R(XMP)  | 8GB (2 x 4B)  | SS        |          |          | 12-14-14-36 | 1.65V | •               |   |

## DDR3 2666MHz (超频)

| 供应商      | 型号                                   | 容量            | SS/<br>DS | 芯片<br>厂商 | 芯片<br>型号 | 时序                   | 电压   | 支持内存插槽 (选购) |   |
|----------|--------------------------------------|---------------|-----------|----------|----------|----------------------|------|-------------|---|
|          |                                      |               |           |          |          |                      |      | 2           | 4 |
| Apacer   | 78.BAGFF.AFC0C(XMP)                  | 8GB (2x 4GB)  | DS        | -        | -        | 12-13-13-35          | -    | •           | • |
| Apacer   | 78.BAGFR.AFD0C(XMP)                  | 8GB (2x 4GB)  | DS        | -        | -        | 12-13-13-35          | -    | •           | • |
| Apacer   | 78.CAGFF.AFD0C(XMP)                  | 16GB (2x 8GB) | DS        | -        | -        | 12-13-13-35          | -    | •           | • |
| CORSAIR  | CMD16GX3M4A2666C11<br>(Ver5.12)(XMP) | 16GB (4x 4GB) | DS        | -        | -        | 11-13-13-35          | 1.65 | •           | • |
| G.SKILL  | F3-2666CL10Q-16GBZHD(XMP)            | 16GB (4x 4GB) | DS        | -        | -        | 10-12-12-31          | 1.65 | •           | • |
| GEIL     | GOC332GB2666C11QC(XMP)               | 32GB (4x 8GB) | DS        | -        | -        | 11-13-13-32          | 1.65 | •           | • |
| KINGSTON | KHX26C11T2K2/8X(XMP)                 | 8GB (2x 4GB)  | SS        | -        | -        | 2666-11-13-<br>13-32 | 1.65 | •           |   |

## DDR3 2500MHz (超频)

| 供应商     | 型号                         | 容量            | SS/<br>DS | 芯片<br>厂商 | 芯片<br>型号 | 时序          | 电压   | 支持内存插槽 (选购) |   |
|---------|----------------------------|---------------|-----------|----------|----------|-------------|------|-------------|---|
|         |                            |               |           |          |          |             |      | 2           | 4 |
| G.SKILL | F3-20000CL10Q-16GBZHD(XMP) | 16GB (4x 4GB) | DS        | -        | -        | 10-11-11-31 | 1.65 | •           | • |



## DDR3 2400MHz (超频)

| 供应商           | 型号                                    | 容量             | SS/DS | 芯片厂商 | 芯片型号 | 时序                   | 电压   | 支持内存插槽(选购) |   |
|---------------|---------------------------------------|----------------|-------|------|------|----------------------|------|------------|---|
|               |                                       |                |       |      |      |                      |      | 2          | 4 |
| A-DATA        | AX3U2400W4G11-DMV(XMP)                | 8GB (2x 4GB)   | SS    | -    | -    | 11-13-13-35          | 1.65 | •          | • |
| A-DATA        | AX3U2400W8G11-DMV(XMP)                | 16GB (2x 8GB)  | DS    | -    | -    | 11-13-13-35          | 1.65 | •          | • |
| Apacer        | 78.BAGFL.AFD0C(XMP)                   | 8GB (2x 4GB)   | DS    | -    | -    | 11-12-12-30          | -    | •          | • |
| Apacer        | 783BAGF3.AFD0C(XMP)                   | 8GB (2x 4GB)   | DS    | -    | -    | 11-11-11-30          | -    | •          | • |
| CORSAIR       | CMD16GX3M2A2400C10<br>(Ver4.21)(XMP)  | 16GB (2x 8GB)  | DS    | -    | -    | 10-12-12-31          | 1.65 | •          | • |
| CORSAIR       | CMD32GX3M2A2400C10<br>(Ver5.29)(XMP)  | 32GB (4x 8GB)  | DS    | -    | -    | 10-12-12-31          | 1.65 | •          | • |
| CORSAIR       | CMY16GX3M2A2400C10A<br>(Ver4.21)(XMP) | 16GB (8x 2GB ) | DS    | -    | -    | 10-12-12-31          | 1.65 | •          | • |
| CORSAIR       | CMY16GX3M2A2400C10R<br>(Ver4.21)(XMP) | 16GB (2x 8GB)  | DS    | -    | -    | 10-12-12-31          | 1.65 | •          | • |
| CORSAIR       | CMZ16GX3M2A2400C10<br>(Ver4.21)       | 16GB (2x 8GB)  | DS    | -    | -    | 10-12-12-31          | 1.65 | •          | • |
| G.SKILL       | F3-19200CL10Q2-<br>64GBZHD(XMP)       | 64GB (8x 8GB)  | DS    | -    | -    | 10-12-12-31          | 1.65 | •          | • |
| G.SKILL       | F3-19200CL10Q-<br>32GBZHD(XMP)        | 32GB (4x 8GB)  | DS    | -    | -    | 10-12-12-31          | 1.65 | •          | • |
| G.SKILL       | F3-19200CL11Q-<br>16GBZHD(XMP)        | 16GB (4x 4GB)  | DS    | -    | -    | 11-11-11-31          | 1.65 | •          | • |
| G.SKILL       | F3-19200CL9D-4GBPIS(XMP)              | 4G (2x 2G )    | DS    | -    | -    | 9-11-9-28            | 1.65 | •          | • |
| G.SKILL       | F3-19200CL9Q-<br>16GBZMD(XMP)         | 16GB (4x 4GB)  | DS    | -    | -    | 9-11-11-31           | 1.65 | •          | • |
| G.SKILL       | F3-2400C11Q-32GX(XMP)                 | 32GB (4x 8GB)  | DS    | -    | -    | 11-13-13-31          | 1.65 | •          | • |
| GEIL          | GOC316GB2400C10QC(XMP)                | 16GB (4x 4GB)  | DS    | -    | -    | 10-11-11-30          | 1.65 | •          | • |
| GEIL          | GOC316GB2400C11QC(XMP)                | 16GB (4x 4GB)  | DS    | -    | -    | 11-11-11-30          | 1.65 | •          | • |
| Kingston      | KHX2400C11D3K4/8GX(XMP)               | 8GB (4x 2GB )  | SS    | -    | -    | 11-13-11-30          | 1.65 | •          | • |
| KINGSTON      | KHX24C11K4/16X(XMP)                   | 16GB (4x 4GB)  | DS    | -    | -    | 11-13-13-30          | 1.65 | •          | • |
| KINGSTON      | KHX24C11T2K2/8X(XMP)                  | 8GB (2x 4GB)   | DS    | -    | -    | -                    | 1.65 | •          | • |
| KINGSTON      | KHX24C11T3K2/16X(XMP)                 | 16GB (2x 8GB)  | DS    | -    | -    | 2400-11-13-<br>13-32 | 1.65 | •          | • |
| KINGSTON      | KHX24C11T3K4(XMP)                     | 16GB (4x 4GB)  | DS    | -    | -    | 2400-11-13-<br>13-30 | 1.65 | •          | • |
| KINGSTON      | KHX24C11T3K4/32X(XMP)                 | 32GB (4x 8GB)  | DS    | -    | -    | 9-9-9-24             | 1.65 | •          | • |
| Mushkin       | 997122R(XMP)                          | 16GB (2x 8GB)  | DS    | -    | -    | 2400-10-12-<br>12-28 | 1.65 | •          | • |
| Silicon Power | SP004GXLYU240NSA(XMP)                 | 4GB            | SS    | -    | -    | 2400-11-13-<br>13-32 | -    | •          | • |
| Transcend     | TX2400KLN-8GK(XMP)                    | 8GB (2x 4GB)   | DS    | -    | -    | 2400-11-12-<br>11-29 | 1.6  | •          | • |

## DDR3 2200MHz (超频)

| 供应商  | 型号                    | 容量            | SS/<br>DS | 芯片厂商 | 芯片型号 | 时序        | 电压   | 支持内存插槽(选购) |   |
|------|-----------------------|---------------|-----------|------|------|-----------|------|------------|---|
|      |                       |               |           |      |      |           |      | 2          | 4 |
| GEIL | GET34GB2200C9DC(XMP)  | 4GB (2x 2GB ) | DS        | -    | -    | 9-10-9-28 | 1.65 | •          | • |
| GEIL | GET38GB2200C9ADC(XMP) | 8GB (2x 4GB)  | DS        | -    | -    | 9-11-9-28 | 1.65 | •          | • |

## DDR3 2133MHz (超频)

| 供应商           | 型号                                   | 容量            | SS/DS | 芯片厂商 | 芯片型号 | 时序                   | 电压   | 支持内存插槽 (选购) |   |
|---------------|--------------------------------------|---------------|-------|------|------|----------------------|------|-------------|---|
|               |                                      |               |       |      |      |                      |      | 2           | 4 |
| A-DATA        | AX3U2133W4G10-DR(XMP)                | 8GB (2x 4GB)  | SS    | -    | -    | 10-11-11-30          | 1.65 | •           | • |
| A-DATA        | AX3U2133W8G10-DR(XMP)                | 16GB (2x 8GB) | DS    | -    | -    | 10-11-11-30          | 1.65 | •           | • |
| Apacer        | 78.BAGE4.AFD0C(XMP)                  | 8GB (2x 4GB)  | DS    | -    | -    | 9-9-9-24             | -    | •           | • |
| Apacer        | AHU04GFB33CAQ3R(XMP)                 | 4GB           | DS    | -    | -    | 11-13-13-31          | -    | •           | • |
| CORSAIR       | CMD16GX3M2A2133C9<br>(Ver4.21)(XMP)  | 16GB (2x 8GB) | DS    | -    | -    | 9-11-11-31           | 1.65 | •           | • |
| CORSAIR       | CMD32GX3M4A2133C9<br>(Ver4.21)(XMP)  | 32GB (4x 8GB) | DS    | -    | -    | 9-11-11-31           | 1.65 | •           | • |
| CORSAIR       | CMD8GX3M2A2133C9<br>(Ver1.5)(XMP)    | 8GB (2x 4GB)  | DS    | -    | -    | 9-11-10-27           | 1.5  | •           | • |
| CORSAIR       | CMD8GX3M2B2133C9<br>(Ver5.12)(XMP)   | 8GB (2x 4GB)  | DS    | -    | -    | 9-11-11-31           | 1.65 | •           | • |
| CORSAIR       | CMY8GX3M2A2133C11R<br>(Ver4.21)(XMP) | 8GB (2x 4GB)  | DS    | -    | -    | 11-11-11-27          | 1.5  | •           | • |
| CORSAIR       | CMZ8GX3M2A2133C11R<br>(Ver4.21)(XMP) | 8GB (2x 4GB)  | DS    | -    | -    | 11-11-11-27          | 1.5  | •           | • |
| G.SKILL       | F3-17000CL102-<br>64GBZLD(XMP)       | 64GB (8x 8GB) | DS    | -    | -    | 11-11-11-30          | 1.5  | •           | • |
| G.SKILL       | F3-17000CL9Q-<br>16GBXLD(XMP)        | 16GB (4x 4GB) | DS    | -    | -    | 9-11-9-28            | 1.65 | •           | • |
| G.SKILL       | F3-17000CL9Q-<br>16GBZH(XMP)         | 16GB (4x 4GB) | DS    | -    | -    | 9-11-10-28           | 1.65 | •           | • |
| G.SKILL       | F3-2133C10Q-32GSR(XMP)               | 32GB (4x 8GB) | DS    | -    | -    | 10-12-12-31          | 1.5  | •           | • |
| G.SKILL       | F3-2133C11Q-32GZL(XMP)               | 32GB (4x 8GB) | DS    | -    | -    | 11-11-11-31          | 1.5  | •           | • |
| KINGSTON      | KHX2133C11D3K4/16GX(XMP)             | 16GB (4x 4GB) | DS    | -    | -    | 11-12-11-30          | 1.65 | •           | • |
| KINGSTON      | KHX21C11T3FK8/64X(XMP)               | 64GB (8x 8GB) | DS    | -    | -    | 9-9-9-24             | 1.5  | •           | • |
| Silicon Power | SP004GXLYU213NSA(XMP)                | 4GB           | SS    | -    | -    | 2133-11-12-<br>11-30 | -    | •           | • |
| Silicon Power | SP008GXLYU213NSA(XMP)                | 8GB           | DS    | -    | -    | 2133-11-12-<br>11-30 | -    | •           | • |
| Transcend     | TX2133KLH-16GK(XMP)                  | 16GB (2x 8GB) | DS    | -    | -    | 2133-10-11-<br>10-27 | 1.6  | •           | • |
| Transcend     | TX2133KLN-8GK(XMP)                   | 8GB (2x 4GB)  | DS    | -    | -    | 2133-10-11-<br>10-27 | 1.6  | •           | • |

## DDR3 2000MHz (超频)

| 供应商   | 型号                      | 容量           | SS/DS | 芯片厂商  | 芯片型号           | 时序       | 电压   | 支持内存插槽 (选购) |   |
|-------|-------------------------|--------------|-------|-------|----------------|----------|------|-------------|---|
|       |                         |              |       |       |                |          |      | 2           | 4 |
| AEXEA | AXA3ES4GK2000LG28V(XMP) | 4GB (2x 2GB) | DS    | -     | -              | -        | 1.65 | •           | • |
| Asint | SLA302G08-ML2HB(XMP)    | 4GB          | DS    | Hynix | H5TQ2G83BFRH9C | 9-9-9-27 | -    | •           | • |
| GEIL  | GUP34GB2000C9DC(XMP)    | 4GB (2x 2GB) | DS    | -     | -              | 9-9-9-28 | 1.65 | •           | • |

## DDR3 1866MHz (超频)

| 供应商           | 型号                                    | 容量            | SS/<br>DS | 芯片<br>厂商 | 芯片<br>型号 | 时序             | 电压   | 支持内存<br>插槽(选<br>购) |   |
|---------------|---------------------------------------|---------------|-----------|----------|----------|----------------|------|--------------------|---|
|               |                                       |               |           |          |          |                |      | 2                  | 4 |
| CORSAIR       | CMD16GX3M2A1866C9 (Ver5.29)<br>(XMP)  | 16GB (2x 8GB) | DS        | -        | -        | 1866 9-9-9-27  | 1.5  | •                  |   |
| CORSAIR       | CMD16GX3M4A1866C9 (Ver4.13)<br>(XMP)  | 16GB (4x 4GB) | DS        | -        | -        | 9-10-9-27      | 1.5  | •                  | • |
| CORSAIR       | CMD16GX3M4A1866C9 (Ver8.16)<br>(XMP)  | 16GB (4x 4GB) | DS        | -        | -        | 9-10-9-27      | 1.5  | •                  | • |
| CORSAIR       | CMD32GX3M4A1866C9 (Ver3.24)<br>(XMP)  | 32GB (4x 8GB) | DS        | -        | -        | 9-10-9-27      | 1.5  | •                  | • |
| CORSAIR       | CMD8GX3M2A1866C9 (Ver4.13)<br>(XMP)   | 8GB (2x 4GB)  | DS        | -        | -        | -              | 1.5  | •                  | • |
| CORSAIR       | CMD8GX3M2A1866C9 (Ver5.12)<br>(XMP)   | 8GB (2x 4GB)  | DS        | -        | -        | 9-10-9-27      | 1.5  | •                  |   |
| CORSAIR       | CMD8GX3M2A1866C9 (Ver8.16)<br>(XMP)   | 8GB (2x 4GB)  | DS        | -        | -        | 9-10-9-27      | 1.5  | •                  |   |
| CORSAIR       | CMT32GX3M4X1866C9(Ver3.23)<br>(XMP)   | 32GB (4x 8GB) | DS        | -        | -        | 9-10-9-27      | 1.5  | •                  | • |
| CORSAIR       | CMY16GX3M2A1866C9 (Ver 4.21)<br>(XMP) | 16GB (2x 8GB) | DS        | -        | -        | 9-10-9-27      | 1.5  | •                  | • |
| CORSAIR       | CMY8GX3M2A1866C9 (Ver3.24)<br>(XMP)   | 8GB (2x 4GB)  | DS        | -        | -        | 9-10-9-27      | 1.5  | •                  | • |
| CORSAIR       | CMZ16GX3M2A1866C10 (Ver5.29)<br>(XMP) | 16GB (2x 8GB) | DS        | -        | -        | 10-11-10-30    | 1.5  | •                  | • |
| CORSAIR       | CMZ16GX3M2A1866C9(XMP)                | 16GB (2x 8GB) | DS        | -        | -        | 1866-9-10-9-27 | 1.5  | •                  | • |
| CORSAIR       | CMZ32GX3M4X1866C10 (Ver3.23)<br>(XMP) | 32GB (4x 8GB) | DS        | -        | -        | 10-11-10-27    | 1.5  | •                  | • |
| CORSAIR       | CMZ32GX3M4X1866C10(Ver3.23)<br>(XMP)  | 32GB (4x 8GB) | DS        | -        | -        | 10-11-10-27    | 1.5  | •                  | • |
| CORSAIR       | CMZ8GX3M2A1866C9 (Ver8.16)<br>(XMP)   | 8GB (2x 4GB)  | DS        | -        | -        | 9-10-9-27      | 1.5  | •                  | • |
| CORSAIR       | CMZ8GX3M2A1866C9(XMP)                 | 8GB (2x 4GB)  | DS        | -        | -        | 9-10-9-27      | 1.5  | •                  |   |
| CORSAIR       | CMZ8GX3M2A1866C9G (Ver5.12)<br>(XMP)  | 8GB (2x 4GB)  | DS        | -        | -        | 1866-9-10-9-27 | 1.5  | •                  | • |
| Crucial       | BLE8G3D1869DE1TX0.16FED(XMP)          | 16GB (2x 8GB) | DS        | -        | -        | 1866-9-9-9-27  | 1.5  | •                  | • |
| Crucial       | BLE4G3D1869DE1XT0.16FMD(XMP)          | 4GB           | DS        | -        | -        | 9-9-9-27       | 1.5  | •                  | • |
| G.SKILL       | F3-14900CL10Q-32GBZL(XMP)             | 32GB (4x 8GB) | DS        | -        | -        | 10-11-10-30    | 1.5  | •                  | • |
| G.SKILL       | F3-14900CL9D-8GBSR(XMP)               | 8GB (2x 4GB)  | DS        | -        | -        | 9-10-9-28      | 1.5  | •                  | • |
| G.SKILL       | F3-14900CL9Q-16GBXL(XMP)              | 16GB (4x 4GB) | DS        | -        | -        | 9-10-9-28      | 1.5  | •                  | • |
| G.SKILL       | F3-14900CL9Q-16GBZL(XMP)              | 16GB (4x 4GB) | DS        | -        | -        | 9-10-9-28      | 1.5  | •                  | • |
| G.SKILL       | F3-14900CL9Q-16GBZL(XMP)              | 16GB (4x 4GB) | DS        | -        | -        | 9-10-9-28      | 1.5  | •                  | • |
| G.SKILL       | F3-1866C10Q2-64GZM(XMP)               | 64GB (2x 8GB) | DS        | -        | -        | 10-11-10-30    | 1.5  | •                  | • |
| G.SKILL       | F3-1866C10Q2-64GZM(XMP)               | 64GB (2x 8GB) | DS        | -        | -        | 10-11-10-30    | 1.5  | •                  | • |
| G.SKILL       | F3-1866C9Q-32GXMX(XMP)                | 32GB (4x 8GB) | DS        | -        | -        | 9-10-9-28      | 1.5  | •                  | • |
| GEIL          | GEEL316GB1866C9DC(XMP)                | 16GB (2x 8GB) | DS        | -        | -        | 1866-9-10-9-28 | 1.65 | •                  | • |
| KINGSTON      | KHX1866C9D3K2/8GX(XMP)                | 8GB (2x 4GB)  | DS        | -        | -        | -              | 1.65 | •                  | • |
| Silicon Power | SP004GXLYU186NSA(XMP)                 | 4GB           | SS        | -        | -        | 1866-9-11-9-27 | -    | •                  | • |
| Silicon Power | SP008GXLYU186NSA(XMP)                 | 8GB           | DS        | -        | -        | 1866-9-11-9-27 | -    | •                  | • |

## DDR3 1800MHz (超频)

| 供应商     | 型号                      | 容量           | SS/DS | 芯片厂商 | 芯片型号 | 时序       | 电压   | 支持内存插槽(选购) |
|---------|-------------------------|--------------|-------|------|------|----------|------|------------|
|         |                         |              |       |      |      |          |      | 2 4        |
| G.SKILL | F3-14400CL9D-4GBRL(XMP) | 4GB (2x 2GB) | DS    | -    | -    | 9-9-9-24 | 1.65 | • •        |

## DDR3 1600MHz

| 供应商             | 型号                    | 容量            | SS/DS | 芯片厂商        | 芯片型号           | 时序          | 电压   | 支持内存插槽(选购) |
|-----------------|-----------------------|---------------|-------|-------------|----------------|-------------|------|------------|
|                 |                       |               |       |             |                |             |      | 2 4        |
| A-DATA          | AD3U1600W4G11         | 4GB           | SS    | A-DATA      | 3WCD-1211A     | 11-11-11-28 | -    | • •        |
| A-DATA          | AD3U1600W8G11         | 8GB           | DS    | A-DATA      | 3WCD-1211A     | 11-11-11-28 | -    | • •        |
| A-DATA          | ADDU1600W4G11-B       | 4GB           | SS    | A-DATA      | DWND-1211A     | 9-9-9-24    | -    | • •        |
| A-DATA          | ADDU1600W8G11-B       | 8GB           | DS    | ELPIDA      | J4208EBBG-GN-F | 9-9-9-24    | -    | • •        |
| A-DATA          | AX3U1600W4G9-DB(XMP)  | 8GB (2x 4GB)  | SS    | -           | -              | 9-9-9-24    | 1.5  | • •        |
| A-DATA          | AX3U1600W8G9-DB(XMP)  | 16GB (2x 8GB) | DS    | -           | -              | 9-9-9-24    | 1.5  | • •        |
| AMD             | AE32G1609U1-U         | 2GB           | SS    | AMD         | 23EY4587MB6H   | -           | 1.5  | • •        |
| AMD             | AE34G1609U2-U         | 4GB           | DS    | AMD         | 23EY4587MB6H   | -           | 1.5  | • •        |
| AMD             | AP38G1608U2K(XMP)     | 8GB (2x 4GB)  | DS    | -           | -              | 9-9-9-28    | 1.65 | • •        |
| Apacer          | 78.B1GE3.9L10C        | 4GB           | DS    | Apacer      | AM5D5908DEQSCK | -           | 1.65 | • •        |
| Apacer          | 78.B1GET.9K00C        | 4GB           | SS    | Apacer      | AM5D6008BQQSCK | 11-11-11-28 | -    | • •        |
| Apacer          | 78.C1GET.9K10C        | 8GB           | DS    | Apacer      | AM5D6008BQQSCK | 11-11-11-31 | -    | • •        |
| Apacer          | AHU04GFA60C9Q1D (XMP) | 4GB           | DS    | -           | -              | 9-9-9-27    | 1.65 | •          |
| Apacer          | AHU04GFA60C9Q3R (XMP) | 4GB           | DS    | -           | -              | 11-11-11-28 | -    | • •        |
| Apacer          | AHU08GFA60CBT3R (XMP) | 8GB           | DS    | -           | -              | 9-9-9-24    | -    | • •        |
| Asint           | SLA302G08-EGG1C(XMP)  | 4GB           | DS    | Asint       | 302G08-GG1C    | 9-9-9-27    | -    | • •        |
| Asint           | SLA302G08-EGJ1C(XMP)  | 4GB           | DS    | Asint       | 302G08-GJ1C    | 9-9-9-27    | -    | • •        |
| Asint           | SLA302G08-EGN1C       | 4GB           | DS    | ASint       | 302G08-GN1C    | -           | -    | • •        |
| Asint           | SLA304G08-ENG1B       | 4GB           | SS    | Asint       | 304G08-GN1B    | 9-11-11-28  | -    | • •        |
| Asint           | SLB304G08-EGJ1B(XMP)  | 8GB           | DS    | -           | -              | 9-9-9-27    | -    | • •        |
| Asint           | SLB304G08-EGN1B       | 8GB           | DS    | ASint       | 304G08-GN1B    | -           | -    | • •        |
| SLZ302G08-EGN1C | 2GB                   | SS            | ASint | 302G08-GN1C | -              | -           | -    | • •        |

## DDR3 1600MHz (续上页表格)

| 供应商                                 | 型号            | 容量 | SS/DS   | 芯片厂商          | 芯片型号              | 时序   | 电压 | 支持内存插槽(选购) |   |
|-------------------------------------|---------------|----|---------|---------------|-------------------|------|----|------------|---|
|                                     |               |    |         |               |                   |      |    | 2          | 4 |
| AVD3U16000904G-2CW(XMP)             | 8GB (2x 4GB)  | DS | -       | -             | 11-11-11-28       | 1.5  | •  | •          | • |
| CMD16GX3M2A1600C9 (Ver8.21) (XMP)   | 16GB (2x 8GB) | DS | -       | -             | 9-9-9-24          | 1.5  | •  | •          | • |
| CMD8GX3M2A1600C8 (Ver5.12) (XMP)    | 8GB (2x 4GB)  | DS | -       | -             | 1600 8-8-8-24     | 1.5  | •  | •          | • |
| CMD8GX3M2A1600C9 (Ver2.12) (XMP)    | 8GB (2x 4GB)  | DS | -       | -             | 9-9-9-24          | 1.5  | •  | •          | • |
| CML16GX3M2A1600C10 (Ver2.21) (XMP)  | 16GB (2x 8GB) | DS | -       | -             | 10-10-10-27       | 1.5  | •  | •          | • |
| CML16GX3M4X1600C8(Ver 2.12) (XMP)   | 16GB (4x 4GB) | DS | -       | -             | Heat-Sink Package | 1.5  | •  | •          | • |
| CML8GX3M2A1600C9 (Ver7.12) (XMP)    | 8GB (2x 4GB)  | DS | -       | -             | 9-9-9-24          | 1.5  | •  | •          | • |
| CMV8GX3M1A1600C11                   | 8GB           | DS | -       | -             | 11-11-11-30       | -    | •  | •          | • |
| CMX8GX3M2A1600C9 (Ver3.19) (XMP)    | 8GB (2x 4GB)  | SS | -       | -             | 9-9-9-24          | 1.65 | •  | •          | • |
| CMZ16GX3M2A1600C10 (Ver.3.24) (XMP) | 16GB (2x 8GB) | DS | -       | -             | 10-10-10-27       | 1.5  | •  | •          | • |
| CMZ16GX3M4A1600C9(XMP)              | 16GB (4x 4GB) | DS | -       | -             | 9-9-9-24          | 1.5  | •  | •          | • |
| CMZ16GX3M4X1600C9 (Ver8.16) (XMP)   | 16GB (4x 4GB) | DS | -       | -             | 1600-9-9-9-24     | 1.5  | •  | •          | • |
| CMZ32GX3M4X1600C10 (Ver2.2) (XMP)   | 32GB (4x 8GB) | DS | -       | -             | 10-10-10-27       | 1.5  | •  | •          | • |
| CMZ4GX3M1A1600C9 (Ver8.16) (XMP)    | 4GB ( 1x 4GB) | DS | -       | -             | 9-9-9-24          | 1.5  | •  | •          | • |
| CMZ8GX3M1A1600C10 (Ver3.23) (XMP)   | 8GB ( 1x 8GB) | DS | -       | -             | 10-10-10-27       | 1.5  | •  | •          | • |
| CMZ8GX3M1A1600C10 (Ver8.21) (XMP)   | 8GB ( 1x 8GB) | DS | -       | -             | 10-10-10-27       | 1.5  | •  | •          | • |
| CMZ8GX3M2A1600C8(XMP)               | 8GB (2x 4GB)  | DS | -       | -             | 8-8-8-24          | 1.5  | •  | •          | • |
| CMZ8GX3M2A1600C9(XMP)               | 8GB (2x 4GB)  | DS | -       | -             | 9-9-9-24          | 1.5  | •  | •          | • |
| BLS4G3D1609DS1S00.16 FMR(XMP)       | 4GB           | DS | -       | -             | 1600-9-9-9-24     | 1.5  | •  | •          | • |
| BLT4G3D1608DT1TX0.16 FM(XMP)        | 4GB           | DS | -       | -             | 8-8-8-24          | 1.5  | •  | •          | • |
| M2X2G64CB8G7N-DG(XMP)               | 2GB           | SS | Elixir  | N2CB2G80GN-DG | 9-9-9-28          | -    | •  | •          | • |
| M2X4G64CB8HG5N-DG(XMP)              | 4GB           | DS | Elixir  | N2CB2G80GN-DG | 9-9-9-28          | -    | •  | •          | • |
| HMT351U6CFR8C-PB                    | 4GB           | DS | Hynix   | H5TQ2G83CFR   | -                 | -    | •  | •          | • |
| HMT41GU6MFR8C-PB                    | 8GB           | DS | Hynix   | H5TQ4G83MFR   | -                 | -    | •  | •          | • |
| FLGE85F-C8KL9A(XMP)                 | 2GB           | SS | KINGMAX | N/A           | 9-9-9-28          | -    | •  | •          | • |
| FLGF65F-C8KL9A(XMP)                 | 4GB           | DS | KINGMAX | N/A           | 9-9-9-28          | -    | •  | •          | • |

## DDR3 1600MHz (续上页表格)

| 供应商                      | 型号            | 容量 | SS/DS    | 芯片厂商           | 芯片型号          | 时序   | 电压 | 支持内存插槽(选购) |   |
|--------------------------|---------------|----|----------|----------------|---------------|------|----|------------|---|
|                          |               |    |          |                |               |      |    | 2          | 4 |
| F3-12800CL9D-8GBSR2(XMP) | 8GB (2x 4GB)  | DS | -        | -              | 9-9-9-24      | 1.25 | •  | •          |   |
| F3-12800CL9Q-16GBXL(XMP) | 16GB (4x 4GB) | DS | -        | -              | 9-9-9-24      | 1.5  | •  | •          |   |
| F3-12800CL9Q-16GBZL(XMP) | 16GB (4x 4GB) | DS | -        | -              | 9-9-9-24      | 1.5  | •  | •          |   |
| F3-1600C9Q-32GXM(XMP)    | 32GB (4x 8GB) | DS | -        | -              | -             | 1.5  | •  | •          |   |
| GUP34GB1600C7DC(XMP)     | 4GB (2x 2GB)  | DS | -        | -              | 7-7-7-24      | 1.6  | •  | •          |   |
| GVP38GB1600C8QC(XMP)     | 8GB (4x 2GB)  | DS | -        | -              | 8-8-8-28      | 1.6  | •  |            |   |
| KHX1600C9D3K2/8GX(XMP)   | 8GB (2x 4GB)  | DS | -        | -              | 9-9-9-27      | 1.65 | •  | •          |   |
| KHX1600C9D3B1/4G(XMP)    | 4GB           | SS | -        | -              | 9-9-9-27      | 1.65 | •  | •          |   |
| KHX1600C9D3K3/12GX(XMP)  | 12GB (3x 4GB) | DS | -        | -              | 9             | 1.65 | •  |            |   |
| KHX1600C9D3K3/6GX(XMP)   | 6GB (3x 2GB)  | DS | -        | -              | 9             | 1.65 | •  | •          |   |
| KHX1600C9D3K3/6GX(XMP)   | 6GB (3x 2GB)  | DS | -        | -              | 9             | 1.65 | •  | •          |   |
| KHX1600C9D3K4/16GX(XMP)  | 16GB (4x 4GB) | DS | -        | -              | 9-9-9-24      | 1.65 | •  | •          |   |
| KHX1600C9D3K6/24GX(XMP)  | 24GB (6x 4GB) | DS | -        | -              | 9             | 1.65 | •  | •          |   |
| KHX1600C9D3K8/32GX(XMP)  | 32GB (8x 4GB) | DS | -        | -              | 9-9-9-27      | 1.65 | •  |            |   |
| KHX1600C9D3LK2/8GX(XMP)  | 8GB (2x 4GB)  | DS | -        | -              | 9-9-9-24      | 1.35 | •  | •          |   |
| KHX1600C9D3P1K2/8G       | 8GB (2x 4GB)  | DS | -        | -              | 9             | 1.5  | •  | •          |   |
| KHX16C10B1K2/16X(XMP)    | 16GB (2x 8GB) | DS | -        | -              | -             | 1.5  | •  | •          |   |
| KHX16C9K2/16             | 16GB (2x 8GB) | DS | -        | -              | 1333-9-9-9-24 | 1.5  | •  | •          |   |
| KHX16C9P1K2/16           | 16GB (2x 8GB) | DS | -        | -              | -             | 1.5  | •  | •          |   |
| KVR16N11/4               | 4GB           | DS | KINGSTON | D2568JPUCPGGBU | 11-11-11-28-1 | -    | •  | •          |   |
| KVR16N11/4               | 4G            | DS | Hynix    | H5TQ2G83CFRPBC | -             | 1.5  | •  | •          |   |

## DDR3 1600MHz (续上页表格)

| 供应商                     | 型号                  | 容量 | SS/DS   | 芯片厂商            | 芯片型号             | 时序  | 电压 | 支持内存插槽(选购) |
|-------------------------|---------------------|----|---------|-----------------|------------------|-----|----|------------|
|                         |                     |    |         |                 |                  |     |    | 2 4        |
| MT16JTF1G64AZ-1G6D1     | 8GB                 | DS | MICRON  | D9PBC           | -                | 1.5 | •  |            |
| MT16JTF1G64AZ-1G6E1     | 8GB                 | DS | Micron  | D9QBJ           | -                | -   | •  | •          |
| MT16KTF51264AZ-1G6M1    | 4GB                 | DS | MICRON  | D9PFJ           | 11-11-11-28      | -   | •  |            |
| MT16KTF51264AZ-1G6M1    | 4GB                 | DS | MICRON  | D9PFJ           | -                | -   | •  |            |
| MT8JTF51264AZ-1G6E1     | 4GB                 | SS | Micron  | D9QBJ           | -                | -   | •  | •          |
| MT8KTF25664AZ-1G6M1     | 2GB                 | SS | MICRON  | D9PFJ           | -                | -   | •  | •          |
| PV316G160C9K(XMP)       | 16GB<br>(2x<br>4GB) | SS | -       | -               | 1600-9-9-9-24    | 1.5 | •  | •          |
| PV316G160C9K(XMP)       | 16GB<br>(2x<br>8GB) | SS | -       | -               | 1600-9-9-9-24    | 1.5 | •  | •          |
| AL9F8L93B-GN2E          | 4GB                 | SS | PSC     | A3P4GF3BLF      | -                | -   | •  |            |
| ALAF8L93B-GN2E          | 8GB                 | DS | PSC     | A3P4GF3BLF      | -                | -   | •  |            |
| SMD-4G28N1P-16KM        | 4GB                 | SS | ELPIDA  | J4208BBBBG-GN-F | 1600             | -   | •  | •          |
| SMD-4G68HP-16KZ         | 4GB                 | DS | Hynix   | H5TQ2G83BFPRBC  | -                | 1.5 | •  | •          |
| SMD-4G68NG-16KK         | 4GB                 | DS | ELPIDA  | J2108BBBG-GN-F  | -                | -   | •  | •          |
| SMD-8G28NP-16KM         | 8GB                 | DS | ELPIDA  | J4208BBBBG-GN-F | 1600             | -   | •  | •          |
| SP002GBLTU160V02(XMP)   | 2GB                 | SS | S-POWER | 20YT5NG         | 9-11-11-28       | 1.5 | •  | •          |
| SP004GBLTU160V02(XMP)   | 4GB                 | DS | S-POWER | 20YT5NG         | 9-9-9-24         | 1.5 | •  |            |
| SP004GXLYU160NSA(XMP)   | 4GB                 | SS | -       | -               | 1600-9-9-9-27    | -   | •  | •          |
| SP008GXLYU160NSA(XMP)   | 8GB                 | DS | -       | -               | 1600-9-9-9-27    | -   | •  | •          |
| TED34GM1600C11BK        | 4GB                 | DS | Hynix   | H5TC2G83EFR     | 11-11-11-28      | 1.5 | •  | •          |
| TED38GM1600C11BK        | 8GB                 | DS | Hynix   | H5TQ4G83AFR     | 11-11-11-28      | 1.5 | •  | •          |
| TLD34G1600HC9BK(XMP)    | 8GB<br>(2x<br>4GB)  | DS | -       | -               | 9-9-9-24         | 1.5 | •  | •          |
| TLD38G1600HC9BK(XMP)    | 16GB<br>(2x<br>8GB) | DS | -       | -               | 9-9-9-24         | 1.5 | •  | •          |
| TXD34096M1600HC9-D(XMP) | 4GB                 | DS | Hynix   | H5TC2G83BFRH9A  | 9-9-9-24         | 1.5 | •  | •          |
| TS1GLK64V6H(620945)     | 8GB                 | DS | SAMSUNG | K4B4G0846B      | -                | -   | •  | •          |
| TS1GLK64W6H             | 8GB                 | DS | SAMSUNG | K4B4G0846B      | 11-11-11-28-1    | -   | •  | •          |
| TS512MLK64W6H           | 4GB                 | SS | SAMSUNG | K4B4G0846B      | 11-11-11-28-2    | -   | •  | •          |
| 84E44G93UM-16BPSYW      | 4GB                 | SS | UMAX    | U2S96D30TP-16   | 1600-11-11-11-28 | -   | •  | •          |
| 84E48G93UM-16BPSYW      | 8GB                 | DS | UMAX    | U2S96D30TP-16   | 1600-11-11-11-28 | -   | •  | •          |

## DDR3 1333MHz

| 供应商       | 型号                            | 容量              | SS/<br>DS | 芯片厂商    | 芯片型号             | 时序         | 电压  | 支持内存插槽(选购) |   |
|-----------|-------------------------------|-----------------|-----------|---------|------------------|------------|-----|------------|---|
|           |                               |                 |           |         |                  |            |     | 2          | 4 |
| ACTICA    | ACT1GHU64B8F1333S             | 1GB             | SS        | SAMSUNG | K4B1G0846F       | -          | -   | •          | • |
| ACTICA    | ACT1GHU72C8G1333S             | 1GB             | SS        | SAMSUNG | K4B1G0846F(ECC)  | -          | -   | •          | • |
| ACTICA    | ACT2GHU64B8G1333M             | 2GB             | DS        | Micron  | D9KPT            | -          | -   | •          | • |
| ACTICA    | ACT2GHU72D8G1333M             | 2GB             | DS        | Micron  | D9KPT(ECC)       | -          | -   | •          | • |
| ACTICA    | ACT2GHU72D8G1333S             | 2GB             | DS        | SAMSUNG | K4B1G0846F(ECC)  | -          | -   | •          | • |
| ACTICA    | ACT4GHU64B8H1333H             | 4GB             | DS        | Hynix   | H5TQ2G83AFR      | -          | -   | •          | • |
| ACTICA    | ACT4GHU72D8H1333H             | 4GB             | DS        | Hynix   | H5TQ2G83AFR(ECC) | -          | -   | •          | • |
| AMD       | AE32G1339U1-U                 | 2GB             | SS        | AMD     | 2SEY4587MB3H     | -          | 1.5 | •          | • |
| AMD       | AE34G1339U2-U                 | 4GB             | DS        | AMD     | 2SEY4587MB3H     | -          | 1.5 | •          | • |
| Apacer    | 78.A1GC6.9L1                  | 2GB             | DS        | Apacer  | AM5D5808FEQSBG   | 9          | -   | •          | • |
| Apacer    | 78.B1GDE.9L10C                | 4GB             | DS        | Apacer  | AM5D5908CEHSBG   | 9          | -   | •          | • |
| Asint     | SLA302G08-EDJ1C               | 2GB             | SS        | ASint   | 302G08-DJ1C      | -          | -   | •          | • |
| Asint     | SLA304G08-EDJ1B               | 4GB             | SS        | Asint   | 304G08-DJ1B      | 9-10-10-26 | -   | •          | • |
| Asint     | SLB304G08-EDJ1B               | 8GB             | DS        | Asint   | 304G08-DJ1B      | 9-9-9-24   | -   | •          | • |
| Asint     | SLZ302G08-EDJ1C               | 4GB             | DS        | ASint   | 302G08-DJ1C      | -          | -   | •          | • |
| ATP       | AQ12M72E8BKHS                 | 4GB             | DS        | SAMSUNG | K4B2G0846C(ECC)  | -          | -   | •          | • |
| BUFFALO   | D3U1333-1G                    | 1GB             | SS        | Elpida  | J1108BFBG-DJ-F   | -          | -   | •          | • |
| BUFFALO   | D3U1333-2G                    | 2GB             | DS        | Elpida  | J1108BFBG-DJ-F   | -          | -   | •          | • |
| BUFFALO   | D3U1333-4G                    | 4GB             | DS        | NANYA   | NT5CB256M8BN-CG  | -          | -   | •          | • |
| CORSAIR   | CMV4GX3M2A1333C9              | 4GB<br>(2x2GB)  | SS        | -       | N/A              | 9-9-9-24   | -   | •          | • |
| CORSAIR   | CMV8GX3M2A1333C9              | 8GB<br>(2x4GB)  | DS        | -       | N/A              | 9-9-9-24   | -   | •          | • |
| CORSAIR   | CMX8GX3M1A1333C9<br>(Ver2.2)  | 8GB             | DS        | -       | -                | 9-9-9-24   | 1.5 | •          | • |
| CORSAIR   | CMX8GX3M1A1333C9<br>(Ver3.23) | 8GB             | DS        | -       | -                | 9-9-9-24   | 1.5 | •          | • |
| CORSAIR   | CMX8GX3M2A1333C9<br>(XMP)     | 8GB<br>(2x4GB)  | DS        | -       | -                | 9-9-9-24   | 1.5 | •          | • |
| EK Memory | EKM324L28BP8-I13              | 4GB<br>(2x2GB)  | DS        | -       | -                | 9          | -   | •          | • |
| G.SKILL   | F3-10600CL9D-4GBNT            | 4GB<br>(2x2GB)  | DS        | G.SKILL | D3 128M8CE9 2GB  | 9-9-9-24   | 1.5 | •          | • |
| G.SKILL   | F3-10666CL9D-8GBRL            | 8GB<br>(2x4GB)  | DS        | -       | -                | 9-9-9-24   | 1.5 | •          | • |
| G.SKILL   | F3-10666CL9D-8GBRL            | 8GB<br>(2x4GB)  | DS        | -       | -                | 9-9-9-24   | 1.5 | •          | • |
| G.SKILL   | F3-10666CL9D-8GBXL            | 8GB<br>(2x4GB)  | DS        | -       | -                | 9-9-9-24   | 1.5 | •          | • |
| GEIL      | GET316GB1333C9QC              | 16GB<br>(4x4GB) | DS        | -       | -                | 9-9-9-24   | 1.5 | •          | • |

## DDR3 1333MHz (续上页表格)

| 供应商         | 型号                  | 容量           | SS/DS | 芯片厂商        | 芯片型号                | 时序       | 电压   | 支持内存插槽(选<br>购) |   |
|-------------|---------------------|--------------|-------|-------------|---------------------|----------|------|----------------|---|
|             |                     |              |       |             |                     |          |      | 2              | 4 |
| GEIL        | GG34GB1333C9DC      | 4GB (2x2GB)  | DS    | GEIL        | GL1L128M88BA115FW   | 9-9-9-24 | 1.3  | •              | • |
| GEIL        | GG34GB1333C9DC      | 4GB (2x2GB)  | DS    | GEIL        | GL1L128M88BA15B     | 9-9-9-24 | 1.3  | •              | • |
| GEIL        | GVP34GB1333C9DC     | 4GB (2x2GB)  | DS    | -           | -                   | 9-9-9-24 | 1.5  | •              | • |
| GEIL        | GVP38GB1333C7QC     | 8GB (4x2GB)  | DS    | -           | -                   | 7-7-7-24 | 1.5  | •              | • |
| GEIL        | GVP38GB1333C9DC     | 8GB (2x4GB)  | DS    | -           | -                   | 9-9-9-24 | 1.5  | •              | • |
| GoodRam     | GR1333D364L9/2G     | 2GB          | DS    | Qimonda     | IDSH1G-03A1F1C-13H  | -        | -    | •              | • |
| Hynix       | HMT125U6TFR8A-H9    | 2GB          | DS    | Hynix       | H5TC1G83TFR         | -        | -    | •              | • |
| INNODISK    | M3UN-2GHJBC09       | 2GB          | SS    | Hynix       | H5TQ2G83CFRH9C      | 9-9-9-24 | -    | •              | • |
| INNODISK    | M3UN-4GHJAC09       | 4GB          | DS    | Hynix       | H5TQ2G83CFRH9C      | 9-9-9-24 | -    | •              | • |
| KINGMAX     | FLFE85F-B8KL9       | 2GB          | DS    | KINGMAX     | KFB8FNXL-BNF-15A    | -        | -    | •              | • |
| KINGMAX     | FLFE85F-C8KL9       | 2GB          | SS    | KINGMAX     | KFC8FNLF-GXX-12A    | -        | -    | •              | • |
| KINGMAX     | FLFE85F-C8KL9       | 2GB          | SS    | KINGMAX     | KFC8FNLF-DXX-15A    | -        | -    | •              | • |
| KINGMAX     | FLFE85F-C8KM9       | 2GB          | SS    | Kingmax     | KFC8FNMXF-BXX-15A   | -        | -    | •              | • |
| KINGMAX     | FLFF65F-C8KL9       | 4GB          | DS    | KINGMAX     | KFC8FNLF-DXX-15A    | -        | -    | •              | • |
| KINGMAX     | FLFF65F-C8KM9       | 4GB          | DS    | Kingmax     | KFC8FNMXF-BXX-15A   | -        | -    | •              | • |
| KINGSTON    | KVR1333D3E9S/4G     | 4GB          | DS    | Elpida      | J2108ECSE-DJ-F      | 9        | 1.5  | •              | • |
| KINGSTON    | KVR1333D3N9H/4G     | 4GB          | DS    | ELPIDA      | J2108BDBG-GN-F      | -        | 1.5  | •              | • |
| KINGSTON    | KVR1333D3N9H/8G     | 8GB          | DS    | ELPIDA      | J4208EASE-DJ-F      | 9-9-9-24 | 1.5  | •              | • |
| KINGSTON    | KVR13N9S8H/4        | 4GB          | SS    | ELPIDA      | J4208BBBG-GN-F      | -        | 1.5  | •              | • |
| KINGTIGER   | F10DA2T1680         | 2GB          | DS    | KINGTIGER   | KTG1333PS1208NST-C9 | -        | -    | •              | • |
| KINGTIGER   | KTG2G1333PG3        | 2GB          | DS    | -           | -                   | -        | -    | •              | • |
| Mach Xtreme | MXD3U133316GQ       | 16GB (4x4GB) | DS    | -           | -                   | -        | -    | •              | • |
| Mach Xtreme | MXD3V13332GS        | 2GB          | SS    | Mach Xtreme | C2S46D30-D313       | -        | -    | •              | • |
| MICRON      | MT8JTF25664AZ-1G4M1 | 2GB          | SS    | MICRON      | D9PFJ               | -        | -    | •              | • |
| OCZ         | OCZ3G1333LV4GK      | 4GB (2x2GB)  | DS    | -           | -                   | 9-9-9    | 1.65 | •              |   |
| OCZ         | OCZ3G1333LV8GK      | 8GB (2x4GB)  | DS    | -           | -                   | 9-9-9    | 1.65 | •              |   |
| OCZ         | OCZ3G1333LV8GK      | 8GB (2x4GB)  | DS    | -           | -                   | 9-9-9    | 1.65 | •              |   |
| OCZ         | OCZ3RPR1333C9LV8GK  | 8GB (2x4GB)  | DS    | -           | -                   | 9-9-9    | 1.65 | •              |   |
| Patriot     | PG38G1333EL(XMP)    | 8GB          | DS    | -           | -                   | -        | 1.5  | •              | • |

## DDR3 1333MHz (续上页表格)

| 供应商           | 型号                   | 容量           | SS/<br>DS | 芯片厂商      | 芯片型号             | 时序       | 电压  | 支持内存插槽 (选购) |   |
|---------------|----------------------|--------------|-----------|-----------|------------------|----------|-----|-------------|---|
|               |                      |              |           |           |                  |          |     | 2           | 4 |
| Patriot       | PGD316G1333ELK (XMP) | 16GB (2x8GB) | DS        | -         | -                | 9-9-9-24 | 1.5 | •           | • |
| Patriot       | PSD32G1333Z          | 2GB          | DS        | Patriot   | PM128M8D3BU-15   | 9        | -   | •           | • |
| RiDATA        | C304627CB1AG22Fe     | 2GB          | DS        | RiDATA    | C304627CB1AG22Fe | 9        | -   | •           | • |
| RiDATA        | E304459CB1AG32Cf     | 4GB          | DS        | RiDATA    | E304459CB1AG32Cf | 9        | -   | •           | • |
| SAMSUNG       | M378B5273CH0-CH9     | 4GB          | DS        | SAMSUNG   | K4B2G0846C       | -        | -   | •           | • |
| Silicon Power | SP001GBLTU133S01     | 1GB          | SS        | NANYA     | NT5CB128M8AN-CG  | -        | -   | •           | • |
| Silicon Power | SP001GBLTU133S02     | 1GB          | SS        | S-POWER   | 10YT3E5          | 9        | -   | •           | • |
| Silicon Power | SP002GBLTU133V02     | 2GB          | SS        | S-POWER   | 20YT3NG          | 9-9-9-24 | -   | •           | • |
| Silicon Power | SP004GBLTU133V02     | 4GB          | DS        | S-POWER   | 20YT3NG          | 9-9-9-24 | -   | •           | • |
| Team          | TED34096M1333HC9     | 4GB          | DS        | Team      | T3D2568LT-13     | -        | -   | •           | • |
| Transcend     | JM1333KLH-8G(623654) | 8GB          | DS        | Transcend | TK963EBF3        | -        | -   | •           | • |
| Transcend     | TS1GLK64V3H(620053)  | 8GB          | DS        | MICRON    | D9QBJ            | -        | -   | •           | • |



SS - 单面内存 DS - 双面内存

内存插槽支持：

- 1 - 在单通道内存设置中，支持安装一组内存条在任一插槽，推荐您安装在 A2 插槽。
- 2 - 支持安装二组内存条在红色或黑色插槽，作为一对双通道设置，推荐您安装在 A2 与 B2 插槽以获得更佳的兼容性。
- 4 - 支持安装四组内存条在红色和黑色插槽，作为二对双通道设置。

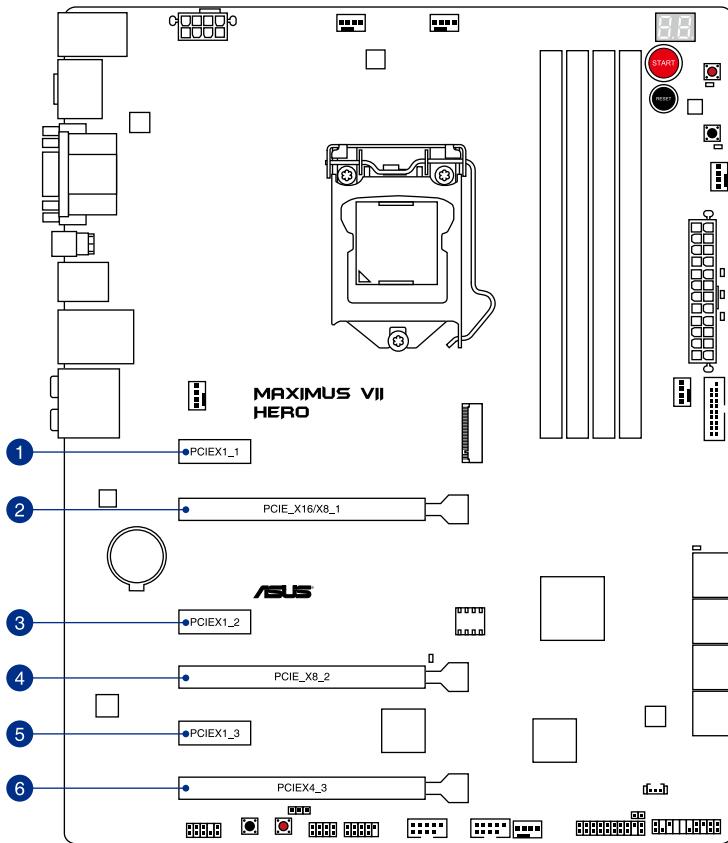


- 华硕独家提供支持高速内存功能。
- 对高速内存的支持会受到特定处理器之物理特性的影响。载入 BIOS 程序中的 X.M.P. 设置来支持高速内存。
- 请访问华硕网站查询最新内存供应商列表 (QVL)。

## 1.2.5 扩展插槽



安装或移除任何扩展卡之前，请暂时先将电脑的电源线拔出。如此可免除因电气残留于电脑中而发生的意外状况。



| 插槽编号 | 插槽说明                     |
|------|--------------------------|
| 1    | PCIe 2.0 x1_1 插槽         |
| 2    | PCIe 3.0/2.0 x16/x8_1 插槽 |
| 3    | PCIe 2.0 x1_2 插槽         |
| 4    | PCIe 3.0/2.0 x8_2 插槽     |
| 5    | PCIe 2.0 x1_3 插槽         |
| 6    | PCIe 2.0 x4_3 插槽         |

## 本主板使用的中断请求（IRQ）一览表

|                   | A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| PCIE_x16/x8_1     | 共享 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| PCIE_x8_2         | -  | 共享 | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| PCIE_x4_3         | 共享 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| PCIE_x1_1         | -  | 共享 | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| PCIE_x1_2         | -  | -  | 共享 | -  | -  | -  | -  | -  |
| PCIE_x1_3         | -  | -  | -  | 共享 | -  | -  | -  | -  |
| I.G.F.X           | 共享 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| Intel LAN 控制器     | -  | -  | -  | -  | 共享 | -  | -  | -  |
| SATA #0           | -  | 共享 | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| SATA #1           | -  | 共享 | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 高保真音频             | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 共享 | -  |
| EHCI #0 (USB 2.0) | -  |    | -  | -  | -  | -  | -  | 共享 |
| EHCI #1 (USB 2.0) | -  | -  | -  | -  | 共享 | -  | -  | -  |
| XHCI (USB 3.0)    | -  | -  | -  | -  | -  | 共享 | -  | -  |
| ASM1061 SATA6G    | -  | -  | -  | 共享 | -  | -  | -  | -  |

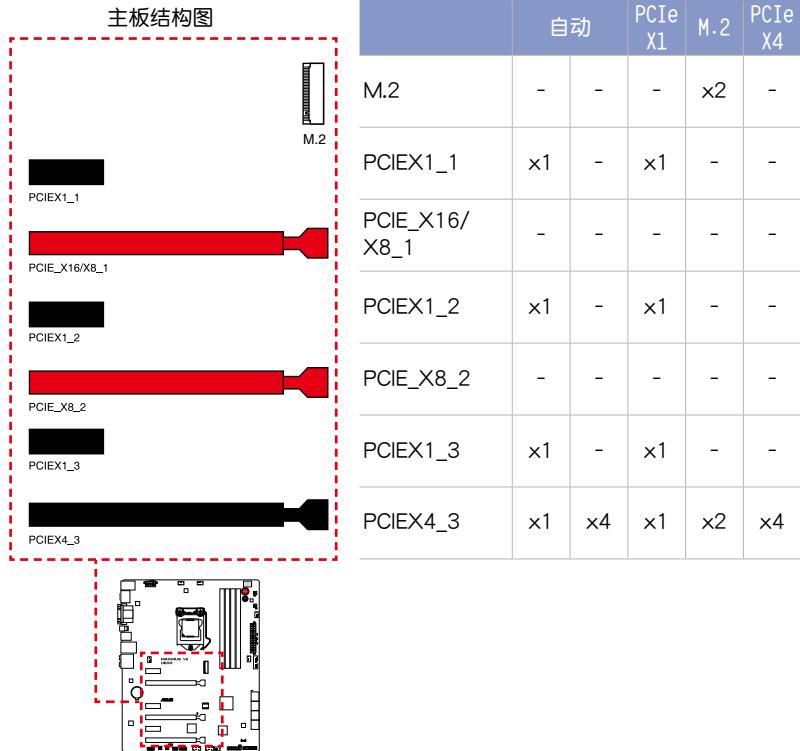
| PCIe Express 3.0 运作模式 |                   |           |
|-----------------------|-------------------|-----------|
| VGA 设置                | PCIe_x16/x8_1     | PCIe_x8_2 |
| 一张 VGA/PCIe 显卡        | x16<br>(推荐使用单张显卡) | N/A       |
| 二张 VGA/PCIe 显卡        | x8                | x8        |



- 当在运行 CrossFireX™ 或 SLI® 模式时，推荐提供系统充足的电力供应。
- 当您安装多张显卡时，推荐您将机箱风扇的排线连接至主板上标示 CHA\_FAN1-3 的插座，以获得更良好的散热环境。
- 新的第四代和第五代 Intel® Core™ 处理器支持 PCIe 3.0 传输速率。



当 PCIe\_x8\_2 插槽使用时，PCIe\_x16/x8\_1 插槽则会自动切换成 x8 模式。



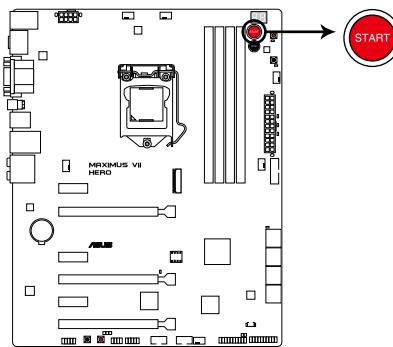
- 在自动模式下有两种情况：
1. 默认状态下，当所有插槽启用且 M.2 插槽关闭时，PCIeX4\_3 插槽采 X1 模式运作。此默认状况会发生在 PCIeX4\_3 插槽无安装任何扩展卡上。
  2. 当于 PCIeX4\_3 插槽上安装扩展卡时，这个插槽会采 X4 模式以支持较高性能。PCIeX1\_1/2/3 与 M.2 插槽则会关闭。
- 在 PCIe X1 模式，所有插槽启用，则 PCIeX4\_3 会采 X1 模式运作。M.2 插槽则关闭。
  - 在 M.2 模式，PCIeX4\_3 插槽采 X2 模式，以及 M.2 插槽启用时，PCIeX1\_1/2/3 插槽则会关闭。
  - 在 PCIe X4 模式，PCIeX4\_3 插槽采 X4 模式以支持较高的性能。PCIeX1\_1/2/3 与 M.2 插槽则会关闭。
  - 若要在 BIOS 中设置 PCIeX4\_3 的带宽项目，请参考在 BIOS 程序设置 章节中的 内置设备设置 一节的说明。

## 1.2.6 主板上的内置开关

当您想要针对未安装在机箱的裸板或是开放机箱的系统作性能调校时，主板上内置的开关按钮与重置按钮可以方便您迅速地开关机或是重置系统。这个专为超频者及专业玩家的设计，可以方便且不间断地进行调教，并让性能有效的提升。

### 1. 启动开关

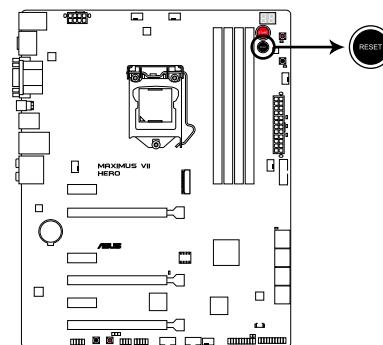
本主板拥有启动开关，让您可以唤醒系统或启动，并以亮灯显示系统已接上电源为启动状态，并提醒您在主板移除或插入任何元件之前要先关机。下图显示开关在主板上的位置。



MAXIMUS VII HERO Power on button

### 2. 重置开关 (RESET)

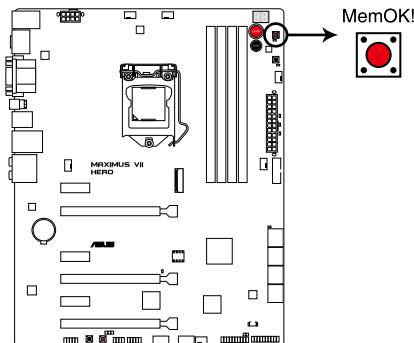
按下重置开关以重新启动系统。



MAXIMUS VII HERO Reset button

### 3. MemOK! 按钮

在主板上安装不兼容的内存条可能会导致启动失败，而且在系统内存开关旁的 DRAM\_LED 指示灯也会一直亮着。按一下 MemOK! 开关，MEMOK\_LED 指示灯会开始闪烁自动进行内存调整直到成功启动。



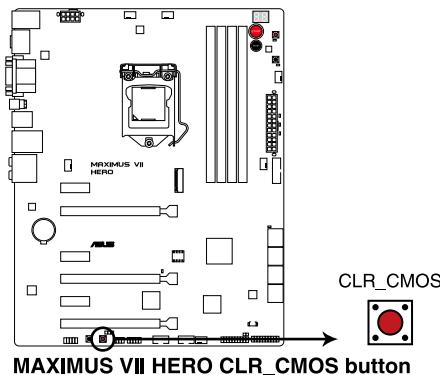
**MAXIMUS VII HERO MemOK! button**



- 请参考 内置指示灯 来找到 MEMOK\_LED 更精确的位置。
- 当 DRAM\_LED 指示灯在内存没有正确安装时也会亮起时，在使用 MemOK! 功能前，请先关闭系统并重新安装内存。
- MemOK! 开关在 Windows<sup>®</sup> 操作系统下无法使用。
- 在调整过程中，系统会载入与测试故障安全防护内存设置。系统进行一项故障安全防护设置测试约需要 30 秒的时间，若是测试失败，系统会重新启动并测试下一个项目。MEMOK\_LED 指示灯闪烁的速度增加表示正在运行不同的测试阶段。
- 由于内存调整需求，系统将于每一组设置值测试时重新启动。在经过整个调整过程后，若安装的内存仍然无法启动，DRAM\_LED 指示灯会持续亮着，请参考并替换用户手册或华硕网站 ([www.asus.com.cn](http://www.asus.com.cn)) 上由合格供应商所提供的内存。
- 在调整过程中，若是您将电脑关机并更换内存，在启动电脑后，系统会继续进行内存调整。若要停止内存调整，将电脑关机然后将电源线拔除大约 5~10 秒即可。
- 若系统因 BIOS 超频而无法启动，按一下 MemOK! 开关来启动电脑并载入默认的 BIOS 设置。在开机自检过程中会出现一个信息提醒您 BIOS 已经恢复至默认值。
- 在使用 MemOK! 功能后，推荐您到华硕网站 ([www.asus.com.cn](http://www.asus.com.cn)) 下载最新版本的 BIOS 程序。

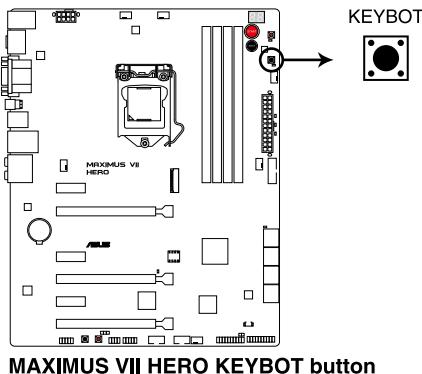
#### 4. CMOS 配置数据清除按钮 (CLR\_CMOS)

只有在系统因超频而死机时按下本按钮来清除 BIOS 设置信息。



#### 5. KeyBot 按钮 (KeyBot)

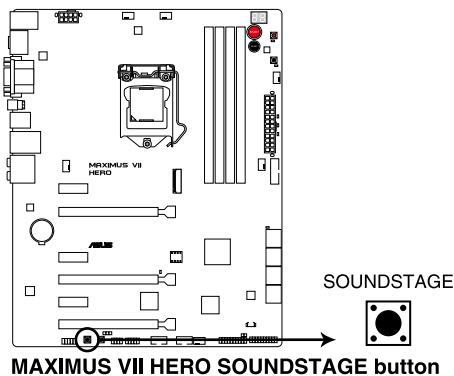
按下按钮可以启用 KeyBot 功能。



- KeyBot 功能只支持 USB 键盘。
- 如欲了解更多有关 KeyBot 功能介绍，请参考本手册 软件支持 章节的说明。

## 6. Sonic SoundStage 按钮 (SOUNDSTAGE)

按下按钮可以启用 Sonic SoundStage 功能。

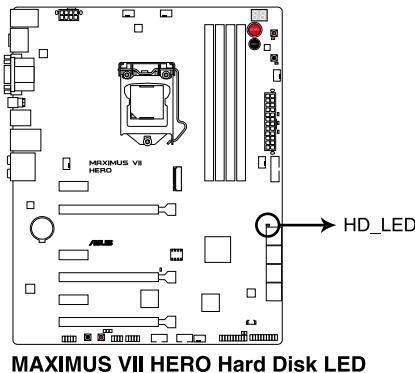


- 当按下 Sonic SoundStage 后，Q-Code 指示灯上会显示当前 Sonic SoundStage 的设置档。
- 如欲了解更多有关 Sonic SoundStage 功能介绍，请参考本手册 软件支持 章节的说明。

## 1.2.7 内置 LED 指示灯

### 1. 硬盘指示灯

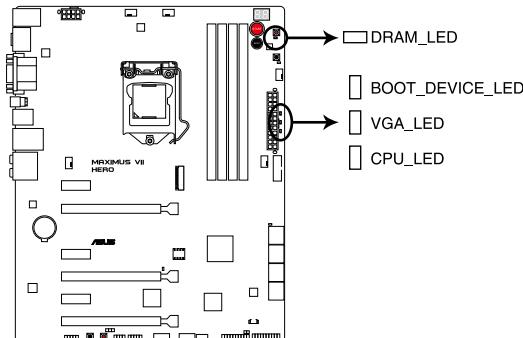
这个指示灯设计用来显示硬盘运作的状态。当指示灯闪烁时表示正在读取硬盘的数据或数据正在写入硬盘中，若是指示灯一直没有亮起，则表示本主板没有连接硬盘或是硬盘没有作用。



**MAXIMUS VII HERO Hard Disk LED**

### 2. Q 指示灯 (BOOT\_DEVICE\_LED、VGA\_LED、DRAM\_LED、CPU\_LED)

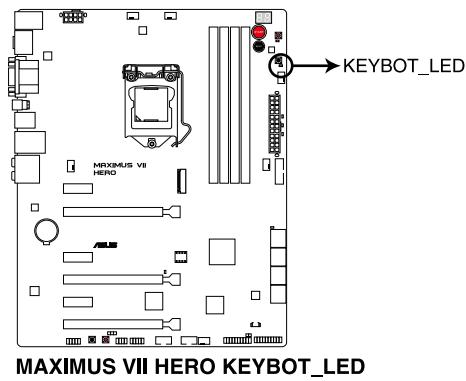
Q 指示灯从主板启动后依序查看 CPU、内存、显卡与启动设备状态。当发现错误时，在该项目旁的指示灯则会亮灯直到问题解决。通过直觉的方式提供这项友善的设计，能在短短几秒内找到问题点。



**MAXIMUS VII HERO CPU/ DRAM/  
VGA/ BOOT\_DEVICE LED**

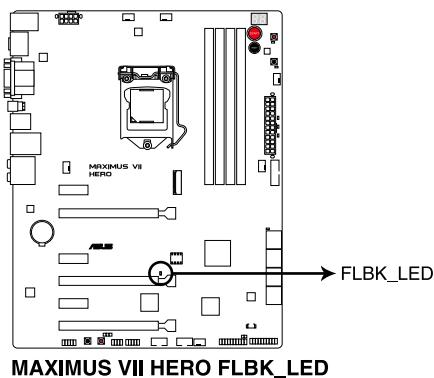
### 3. KeyBot 指示灯 (KEYBOT\_LED)

这个指示灯会在 KeyBot 按钮按下后亮灯显示。



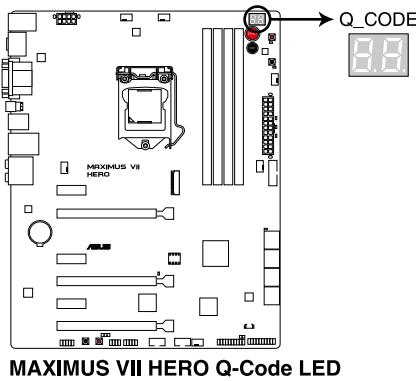
### 4. USB BIOS Flashback 指示灯 (FLBK\_LED)

这个指示灯会在 BIOS 更新时闪烁，且在更新完毕后熄灭。



## 5. Q-Code 指示灯

Q-Code 指示灯设计为 2 位显示，用来得知系统状态。请参考下方 Q-Code 列表来获得更详细的信息。



## Q-Code 列表

| Code    | 说明  |
|---------|---|
| 00      | Not used  |
| 01      | Power on. Reset type detection (soft/hard).                                   |
| 02      | AP initialization before microcode loading                                    |
| 03      | System Agent initialization before microcode loading                          |
| 04      | PCH initialization before microcode loading                                   |
| 06      | Microcode loading   |
| 07      | AP initialization after microcode loading                                     |
| 08      | System Agent initialization after microcode loading                           |
| 09      | PCH initialization after microcode loading                                    |
| 0B      | Cache initialization  |
| 0C — 0D | Reserved for future AMI SEC error codes                                       |
| 0E      | Microcode not found   |
| 0F      | Microcode not loaded  |
| 10      | PEI Core is started   |
| 11 — 14 | Pre-memory CPU initialization is started                                      |
| 15 — 18 | Pre-memory System Agent initialization is started                             |
| 19 — 1C | Pre-memory PCH initialization is started                                      |
| 2B — 2F | Memory initialization   |
| 30      | Reserved for ASL (see ASL Status Codes section below)                         |
| 31      | Memory Installed  |
| 32 — 36 | CPU post-memory initialization  |
| 37 — 3A | Post-Memory System Agent initialization is started                            |
| 3B — 3E | Post-Memory PCH initialization is started                                     |
| 4F      | DXE IPL is started  |
| 50 — 53 | Memory initialization error. Invalid memory type or incompatible memory speed |
| 54      | Unspecified memory initialization error                                       |
| 55      | Memory not installed  |
| 56      | Invalid CPU type or Speed   |
| 57      | CPU mismatch  |
| 58      | CPU self test failed or possible CPU cache error                              |
| 59      | CPU micro-code is not found or micro-code update is failed                    |

Q-Code 列表 (续上页表格)

| Code    | 说明  |
|---------|---|
| 10      | PEI Core is started   |
| 11 — 14 | Pre-memory CPU initialization is started                                      |
| 15 — 18 | Pre-memory System Agent initialization is started                             |
| 19 — 1C | Pre-memory PCH initialization is started                                      |
| 2B — 2F | Memory initialization   |
| 30      | Reserved for ASL (see ASL Status Codes section below)                         |
| 31      | Memory Installed  |
| 32 — 36 | CPU post-memory initialization  |
| 37 — 3A | Post-Memory System Agent initialization is started                            |
| 3B — 3E | Post-Memory PCH initialization is started                                     |
| 4F      | DXE IPL is started  |
| 50 — 53 | Memory initialization error. Invalid memory type or incompatible memory speed |
| 54      | Unspecified memory initialization error                                       |
| 55      | Memory not installed  |
| 56      | Invalid CPU type or Speed   |
| 57      | CPU mismatch  |
| 58      | CPU self test failed or possible CPU cache error                              |
| 59      | CPU micro-code is not found or micro-code update is failed                    |
| 5A      | Internal CPU error  |
| 5B      | Reset PPI is not available  |
| 5C — 5F | Reserved for future AMI error codes   |
| E0      | S3 Resume is stared (S3 Resume PPI is called by the DXE IPL)                  |
| E1      | S3 Boot Script execution  |
| E2      | Video repost  |
| E3      | OS S3 wake vector call  |
| E4 — E7 | Reserved for future AMI progress codes  |
| E8      | S3 Resume Failed  |
| E9      | S3 Resume PPI not Found   |
| EA      | S3 Resume Boot Script Error   |
| EB      | S3 OS Wake Error  |
| EC — EF | Reserved for future AMI error codes   |

## Q-Code 列表 (续上页表格)

| Code    | 说明   |
|---------|--|
| F0      | Recovery condition triggered by firmware (Auto recovery)       |
| F1      | Recovery condition triggered by user (Forced recovery)         |
| F2      | Recovery process started                                       |
| F3      | Recovery firmware image is found                               |
| F4      | Recovery firmware image is loaded                              |
| F5 — F7 | Reserved for future AMI progress codes                         |
| F8      | Recovery PPI is not available                                  |
| F9      | Recovery capsule is not found                                  |
| FA      | Invalid recovery capsule                                       |
| FB — FF | Reserved for future AMI error codes                            |
| 60      | DXE Core is started  |
| 61      | NVRAM initialization   |
| 62      | Installation of the PCH Runtime Services                       |
| 63 — 67 | CPU DXE initialization is started                              |
| 68      | PCI host bridge initialization                                 |
| 69      | System Agent DXE initialization is started                     |
| 6A      | System Agent DXE SMM initialization is started                 |
| 6B — 6F | System Agent DXE initialization (System Agent module specific) |
| 70      | PCH DXE initialization is started                              |
| 71      | PCH DXE SMM initialization is started                          |
| 72      | PCH devices initialization                                     |
| 73 — 77 | PCH DXE Initialization (PCH module specific)                   |
| 78      | ACPI module initialization                                     |
| 79      | CSM initialization   |
| 7A — 7F | Reserved for future AMI DXE codes                              |
| 90      | Boot Device Selection (BDS) phase is started                   |
| 91      | Driver connecting is started                                   |
| 92      | PCI Bus initialization is started                              |
| 93      | PCI Bus Hot Plug Controller Initialization                     |
| 94      | PCI Bus Enumeration  |
| 95      | PCI Bus Request Resources                                      |

Q-Code 列表 (续上页表格)

| Code    | 说明  |
|---------|---|
| 96      | PCI Bus Assign Resources                              |
| 97      | Console Output devices connect                        |
| 98      | Console input devices connect                         |
| 99      | Super IO Initialization                               |
| 9A      | USB initialization is started                         |
| 9B      | USB Reset   |
| 9C      | USB Detect  |
| 9D      | USB Enable  |
| 9E — 9F | Reserved for future AMI codes                         |
| A0      | IDE initialization is started                         |
| A1      | IDE Reset   |
| A2      | IDE Detect  |
| A3      | IDE Enable  |
| A4      | SCSI initialization is started                        |
| A5      | SCSI Reset  |
| A6      | SCSI Detect   |
| A7      | SCSI Enable   |
| A8      | Setup Verifying Password                              |
| A9      | Start of Setup  |
| AA      | Reserved for ASL (see ASL Status Codes section below) |
| AB      | Setup Input Wait                                      |
| AC      | Reserved for ASL (see ASL Status Codes section below) |
| AD      | Ready To Boot event                                   |
| AE      | Legacy Boot event                                     |
| AF      | Exit Boot Services event                              |
| B0      | Runtime Set Virtual Address MAP Begin                 |
| B1      | Runtime Set Virtual Address MAP End                   |
| B2      | Legacy Option ROM Initialization                      |
| B3      | System Reset  |
| B4      | USB hot plug  |
| B5      | PCI bus hot plug                                      |

Q-Code 列表 (续上页表格)

| Code  | 说明  |
|-------|---|
| B6    | Clean-up of NVRAM                                     |
| B7    | Configuration Reset (reset of NVRAM settings)         |
| B8—BF | Reserved for future AMI codes                         |
| D0    | CPU initialization error                              |
| D1    | System Agent initialization error                     |
| D2    | PCH initialization error                              |
| D3    | Some of the Architectural Protocols are not available |
| D4    | PCI resource allocation error. Out of Resources       |
| D5    | No Space for Legacy Option ROM                        |
| D6    | No Console Output Devices are found                   |
| D7    | No Console Input Devices are found                    |
| D8    | Invalid password                                      |
| D9    | Error loading Boot Option (LoadImage returned error)  |
| DA    | Boot Option is failed (StartImage returned error)     |
| DB    | Flash update is failed                                |
| DC    | Reset protocol is not available                       |

ACPI/ASL 检查表

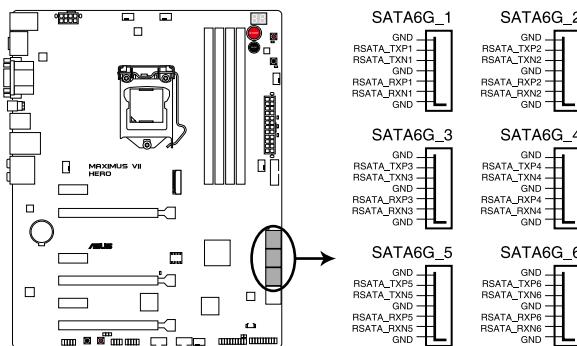
| Code | 说明  |
|------|---|
| 0x01 | System is entering S1 sleep state   |
| 0x02 | System is entering S2 sleep state   |
| 0x03 | System is entering S3 sleep state   |
| 0x04 | System is entering S4 sleep state   |
| 0x05 | System is entering S5 sleep state   |
| 0x10 | System is waking up from the S1 sleep state                                   |
| 0x20 | System is waking up from the S2 sleep state                                   |
| 0x30 | System is waking up from the S3 sleep state                                   |
| 0x40 | System is waking up from the S4 sleep state                                   |
| 0xAC | System has transitioned into ACPI mode. Interrupt controller is in PIC mode.  |
| 0xAA | System has transitioned into ACPI mode. Interrupt controller is in APIC mode. |

## 1.2.8 内部接口

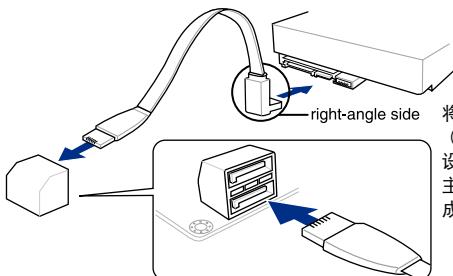
### 1. Intel® Z97 Serial ATA 6.0 Gb/s 设备连接插槽 (7-pin SATA6G\_1-6 [红色])

这些插槽可以支持使用 Serial ATA 6.0 Gb/s 排线来连接 Serial ATA 6.0 Gb/s 硬盘。

若您安装了 Serial ATA 硬盘，您可以通过 Intel® Rapid Storage 技术，与内置的 Intel® Z97 芯片组来创建 RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 10 磁盘数组。



MAXIMUS VII HERO Intel® SATA 6 Gb/s connectors



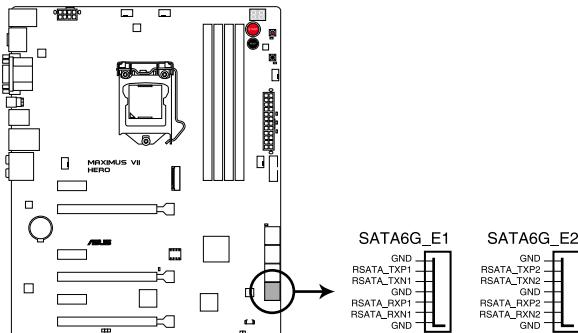
将 SATA 信号在线的直角接口端 (right angle side) 连接在 SATA 设备上，或是将直角接口端安装至主板内置的 SATA 接口，以避免造成与较大显卡的冲突。



- 这些插槽的默认值为 [AHCI Mode]，若您想要使用这些插槽来建构 Serial ATA RAID 功能，请将 BIOS 程序中的 SATA Mode 项目设置为 [RAID Mode]。请参考 SATA 设置 (SATA Configuration) 一节的详细说明。
- 在创建 RAID 设置时，请参考 RAID 支持章节或存储在驱动及应用程序 DVD 光盘里的用户手册说明。
- 当您使用支持 NCQ 技术的硬盘时，请先将 BIOS 程序中的 SATA Mode 设置为 [AHCI Mode]。请参考 SATA 设置 (SATA Configuration) 一节的说明。

## 2. ASMedia® Serial ATA 6 Gb/s connectors (7-pin SATA6G\_E1/2 [红色])

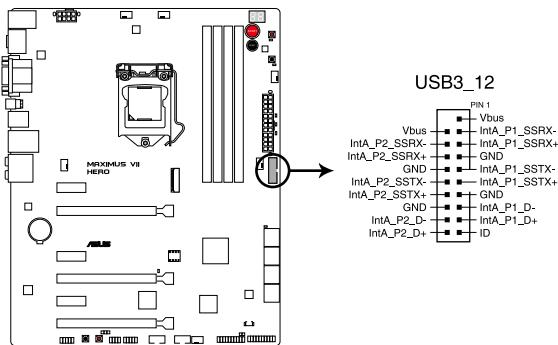
这些插槽可以支持使用 Serial ATA 6.0 Gb/s 排线来连接 Serial ATA 6.0 Gb/s 硬盘。



**MAXIMUS VII HERO ASMedia® SATA 6 Gb/s connectors**

## 3. USB 3.0 连接插槽 (20-1 pin USB3\_12)

这个插槽用来连接 USB 3.0 模块，可在前面板或后侧接口扩展 USB 3.0 模块。当您安装 USB 3.0 模块，您可以享受 USB 3.0 的益处，包括有更快的数据传输率最高达 5 Gbps、对可充电的 USB 设备更快的充电速度、最佳化能源效率，以及与 USB 2.0 向下兼容。



**MAXIMUS VII HERO USB3.0 connector**



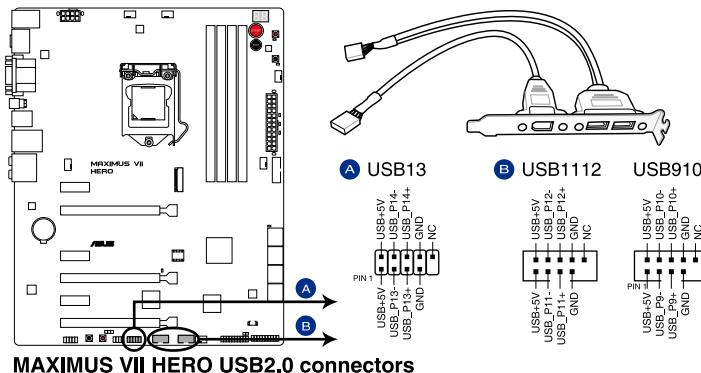
USB 3.0 模块为选购配备，请另行购买。



- 这些插槽是以 xHCI 规格为基础，推荐您在 Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 操作系统中安装相关的驱动程序来充分使用 USB 3.0 插槽。
- 安装的 USB 3.0 设备视操作系统设置而运行在 xHCI 或 EHCI 状态。

#### 4. USB 2.0 连接插槽 (10-1 pin USB13, USB1112, USB910)

这些 USB 扩展套件排线插槽支持 USB 2.0 规格，将 USB 模块排线连接至任何一个插槽，然后将模块安装到机箱后面板中开放的插槽。这些 USB 插槽与 USB 2.0 规格兼容，并支持传输速率最高达 480 Mbps。



请勿将 1394 排线连接到 USB 插槽上，这么做可能会导致主板的损毁。



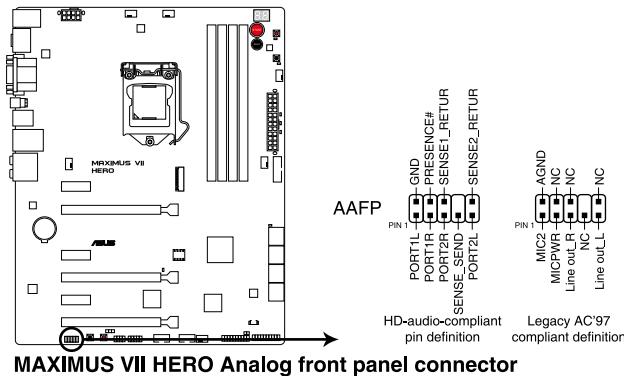
若是您的机箱拥有前面板 USB 接口，您可以将前面板 USB 排线连接至 ASUS Q-Connector (USB)，然后将 Q-Connector (USB) 安装至主板内置的 USB 插槽上。



位在主板中央的 1 组 USB 2.0 接口 (USB13) 与 ROG extension (ROG\_EXT) 接口共享。

## 5. 前面板音频连接排针 (10-1 pin AAFP)

这组音频外接排针供您连接到前面板的音频排线，除了让您轻松地通过主机前面板来控制音频输入/输出等功能，并且支持 AC' 97 或 HD Audio 音频标准。将前面板音频输出/输入模块的连接排线之一端连接到这个插槽上。



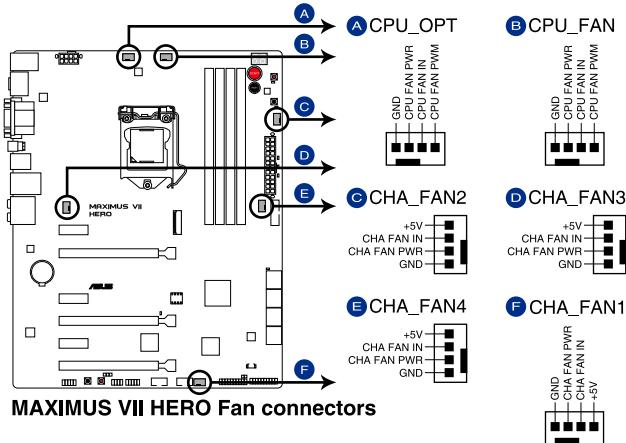
MAXIMUS VII HERO Analog front panel connector



- 推荐您将支持高保真 (high definition) 音频的前面板音频模块连接到这组排针，如此才能获得高保真音频的功能。
- 若要将高保真音频前面板模块安装至本接针，请将 BIOS 程序中 Front Panel Type 项目设置为 [HD]；若要将 AC 97 音频前面版模块安装至本接针，请将 BIOS 程序设置为 [AC97]。默认值为 [HD]。

6. 中央处理器、机箱与选用风扇电源插槽 (4-pin CPU\_FAN ; 4-pin CPU\_OPT ; 4-pin CHA\_FAN1-4)

将风扇排线连接至风扇插槽，并确认每条连接排线的黑线是接到风扇电源插槽上的接地端 (GND)。



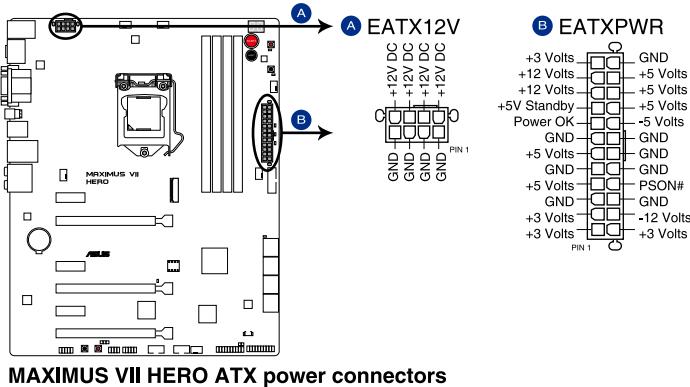
- 千万要记得连接风扇的电源，若系统中缺乏足够的风量来散热，那么很容易因为主机内部温度逐渐升高而导致死机，甚至更严重者会烧毁主板上的电子元件。注意：这些插槽并不是单纯的排针！不要将跳线帽套在它们的针脚上。
- 请确实将 4-pin CPU 风扇排线连接至 CPU 风扇插座上。



CPU\_FAN 插槽支持处理器风扇最大达 1 安培 (12 瓦) 的风扇电源。

## 7. 主板电源插槽（24-pin EATXPWR, 8-pin EATX12V）

这些电源插槽用来连接一个 ATX 电源。电源所提供的连接插头已经过特别设计，只能以一个特定方向插入主板上的电源插槽。找到正确的插入方向后，只需稳稳地将之套进插槽中即可。



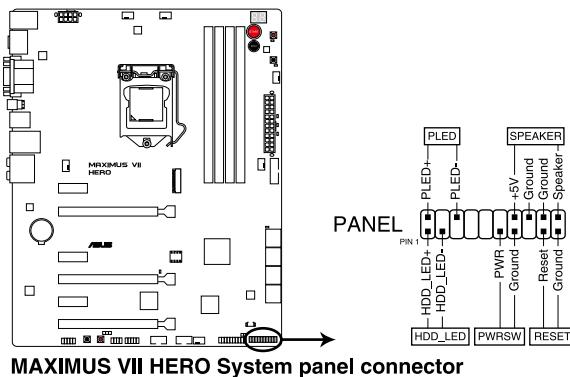
MAXIMUS VII HERO ATX power connectors



- 推荐您使用与 2.0 规格的 24-pin ATX 12V 兼容的电源 (PSU)，才能提供至少 350W 高功率的电源，以供应系统足够的电源需求。
- 请务必连接 8-pin EATX12V 电源插头，否则系统可能无法顺利启动。
- 如果您想要安装其他的硬件设备，请务必使用较高功率的电源以提供足够的设备用电需求。若电源无法提供设备足够的用电需求，则系统将会变得不稳定或无法开启。

## 8. 系统前置面板连接排针 (20-8 pin PANEL)

这一组连接排针包括了数个连接到电脑主机前面板的功能接针。下述将针对各项功能作逐一简短说明。



- 系统电源指示灯连接排针 (2-pin PLED)

这组排针可连接到电脑主机面板上的系统电源指示灯。在您启动电脑并且使用电脑的情况下，该指示灯会持续亮着；而当指示灯闪烁亮着时，即表示电脑正处于睡眠模式中。

- 硬盘动作指示灯号接针 (2-pin HDD\_LED)

您可以连接此组 HDD\_LED 接针到主板上的硬盘动作指示灯号，如此一旦硬盘有存取动作时，指示灯随即亮起或闪烁。

- 机箱音箱连接排针 (4-pin SPEAKER)

这组四脚位排针连接到电脑主机机箱中的音箱。当系统正常启动便可听到哔哔声，若启动时发生问题，则会以不同长短的音调来警示。

- ATX 电源/软关机开关连接排针 (2-pin PWRSW)

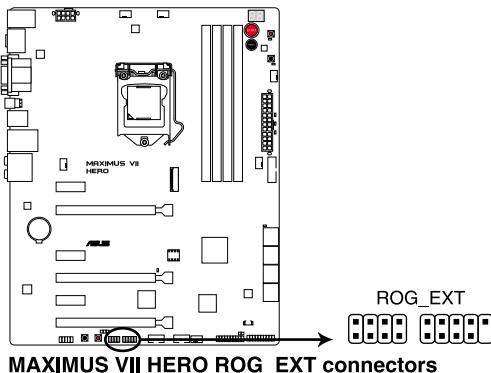
这组排针连接到电脑主机面板上控制电脑电源的开关。您可以根据 BIOS 程序或操作系统的设置，来决定当按下开关时电脑会在正常运行和睡眠模式间切换，或者是在正常运行和软关机模式间切换。若要关机，请持续按住电源开关超过四秒的时间。

- 重置开关连接排针 (2-pin RESET)

这组两脚位排针连接到电脑主机面板上的 Reset 开关。可以让您在不需要关掉电脑电源即可重新启动，尤其在系统死机的时候特别有用。

## 9. ROG Extension - ROG\_EXT 插槽 (18-1 pin ROG\_EXT)

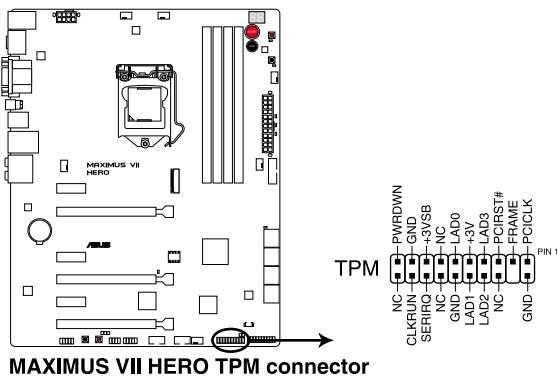
这组插槽可供 OC Panel、Front Base 与其它 ROG 设备连接使用。



- OC Panel 与 Front Base 为选购配备，请另行购买。
- 请上网 [www.asus.com.cn](http://www.asus.com.cn) 以查询有关 OC Panel 与 Front Base 的相关信息。

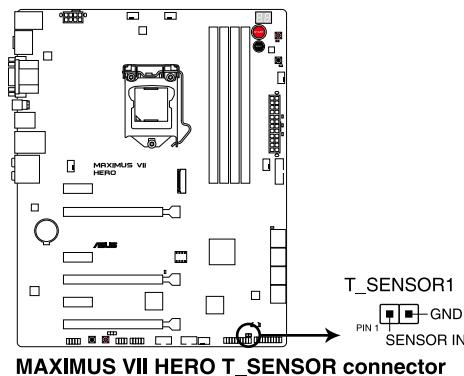
## 10. TPM 插座 (20-1 pin TPM)

这个插座支持可信任安全平台模块 (TPM) 系统，用来安全地存储金钥、数码认证、密码和数据。可信任安全平台模块 (TPM) 系统也用来协助加强网络安全，保护数码身分，以及确保平台的安全性。



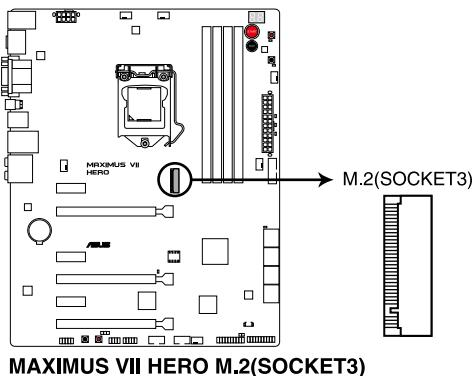
### 11. T\_Sensor 插座 (2-pin T\_SENSOR1)

此插座为连接温度感应线，可以让您监控主板关键元件和连接设备的温度。



### 12. M.2 插槽 3

这个 M.2 (Socket 3) 具备 M Key，支持 2260 (22mm x 60mm) 与 2280 (22mm x 80mm) SSD 模块。





# 第二章

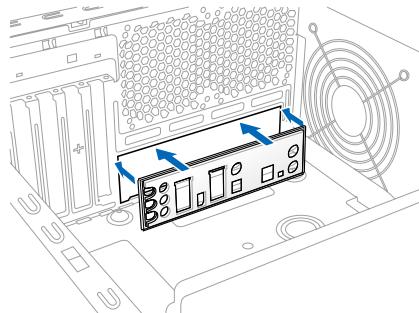
## 2.1 创建您的电脑系统

### 2.1.1 安装主板

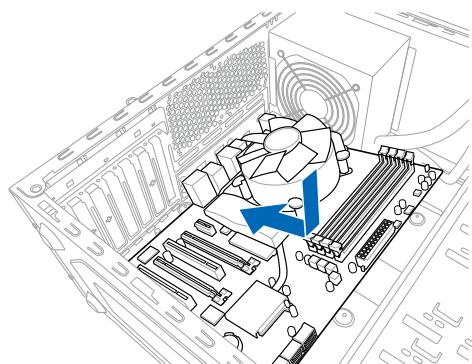


本章节的图标只能参考，主板的结构可能会随着型号而有所不同，但是安装的步骤仍然是相同的。

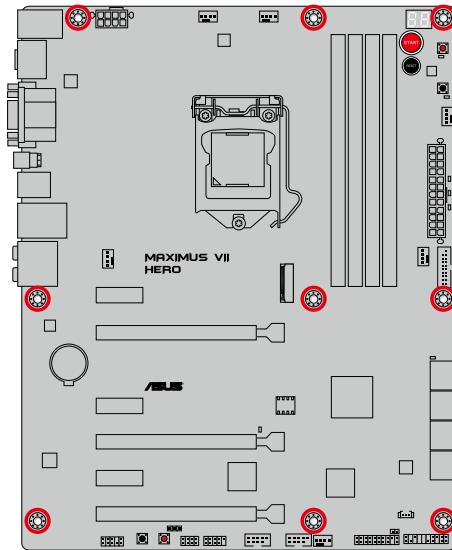
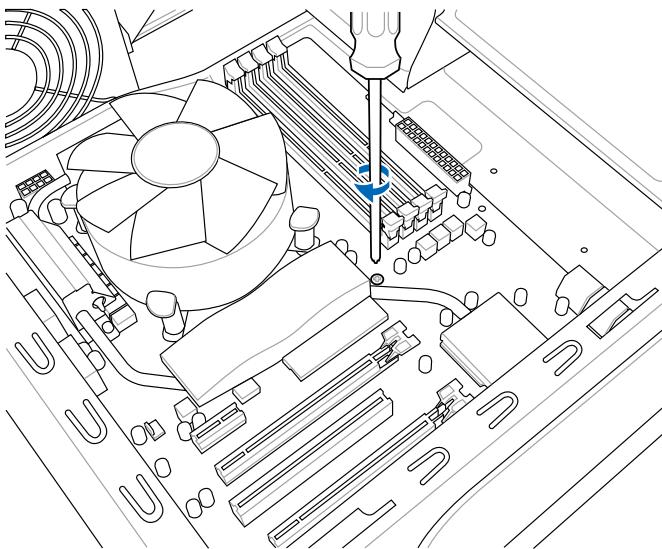
1. 安装华硕 Q-Shield 挡板至机箱的后侧 I/O 面板。



2. 将主板放入机箱，并确认后侧 I/O 接口对齐机箱的后侧 I/O 面板。



- 将四个螺丝放入主板上的螺丝孔并旋转锁紧，以确保将主板锁至机箱。

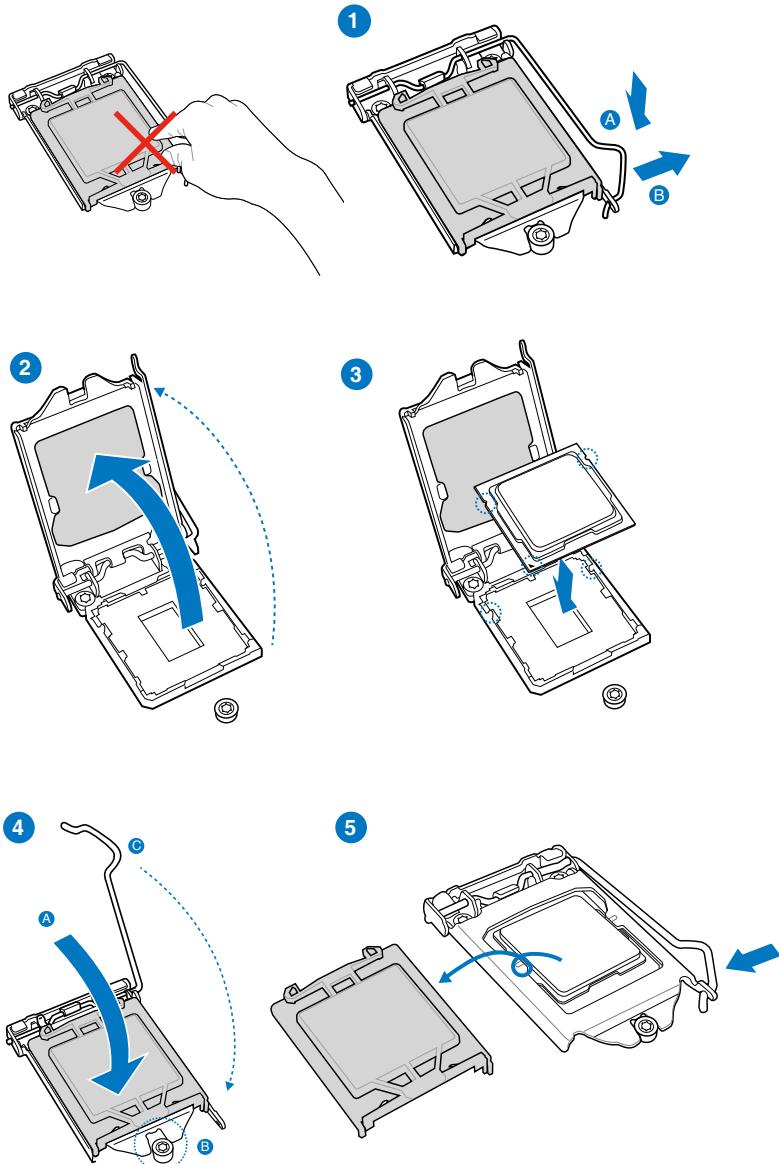


请勿将螺丝锁得太紧！否则容易导致主板的印刷电路板生成龟裂。

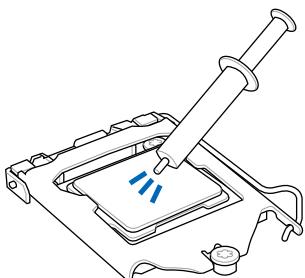
## 2.1.2 安装中央处理器



本插槽只支持 LGA1150 处理器, 请确认并安装正确的处理器, 请勿将 LGA1155 与 LGA1156 处理器安装于 LGA1150 插槽。

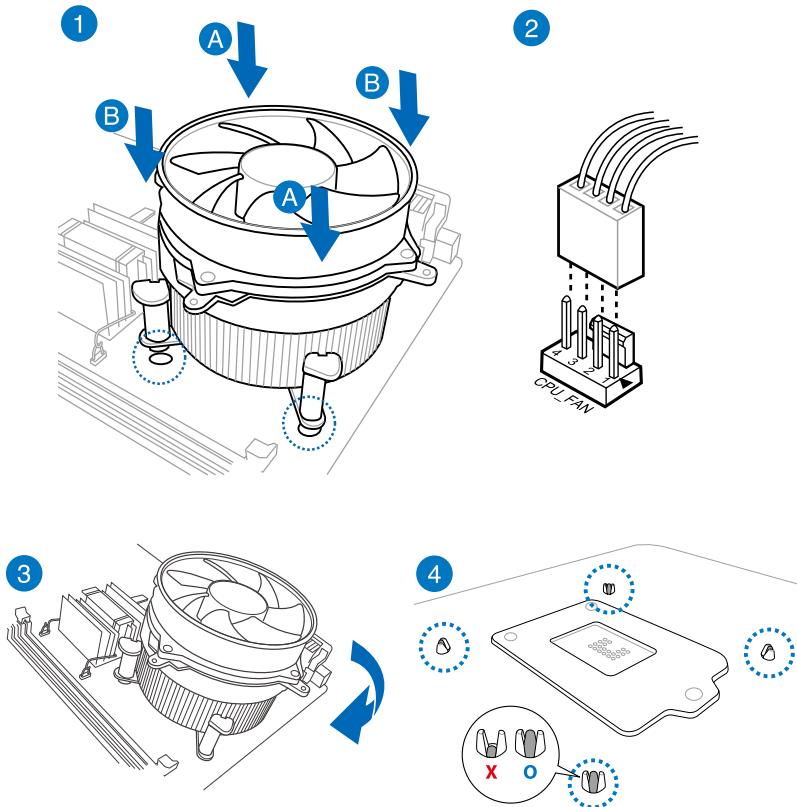


### 2.1.3 处理器散热片与风扇安装

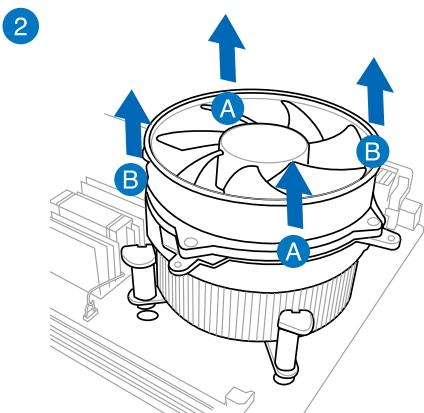
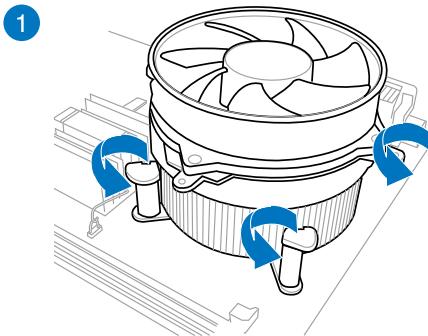


在安装散热片与风扇之前，  
请先将处理器与散热片涂上  
散热膏。

安装 CPU 散热片与风扇

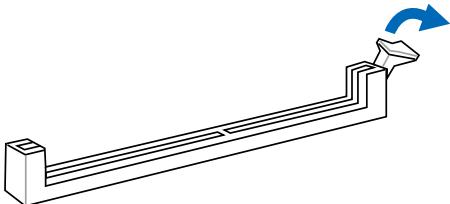


取出散热片与风扇

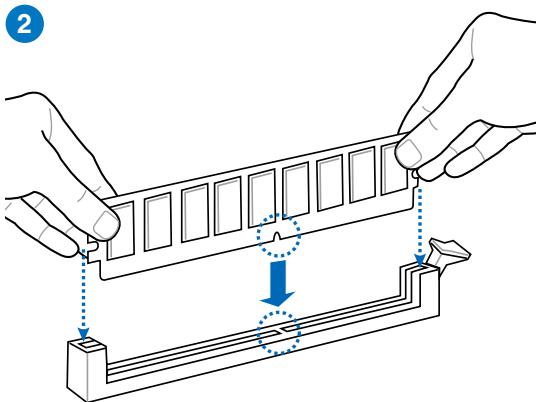


#### 2.1.4 安装内存条

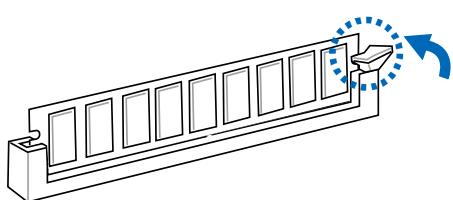
1



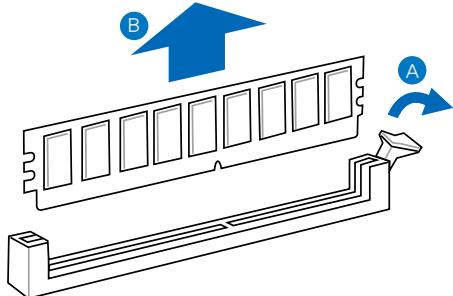
2



3

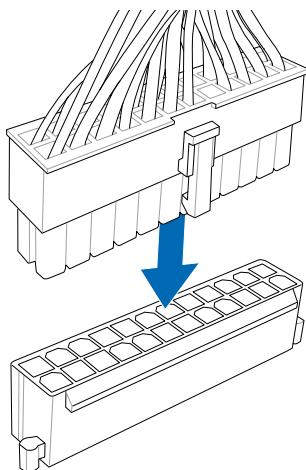


取出内存条

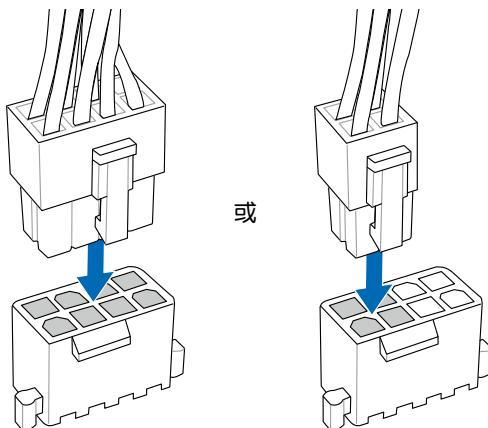


### 2.1.5 安装 ATX 电源

1

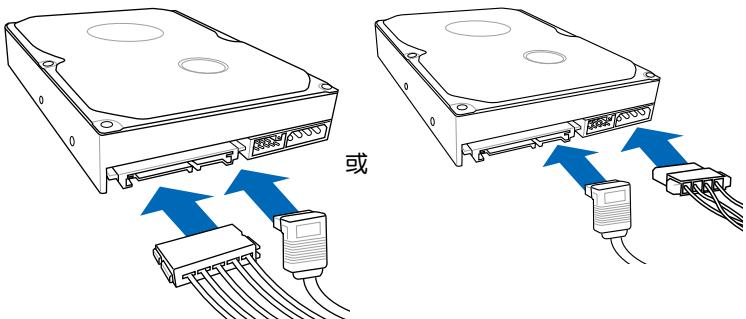


2

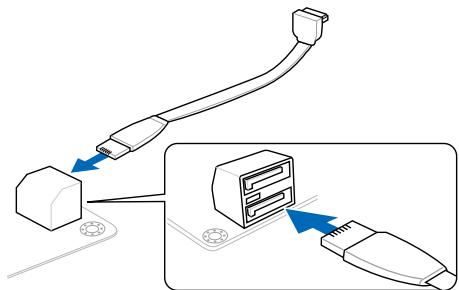


## 2.1.6 安装 SATA 设备

1

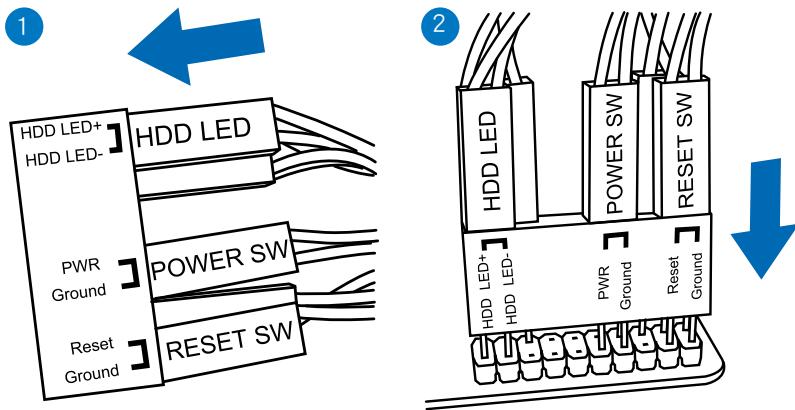


2

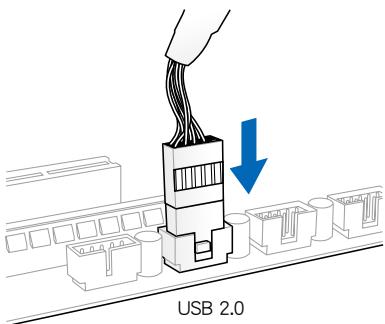


## 2.1.7 安装前面板输出/输入接口

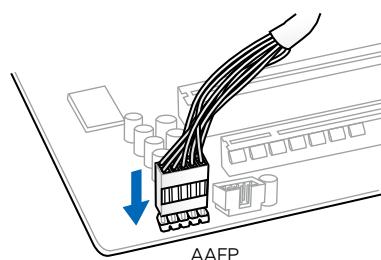
安装华硕 Q-Connector



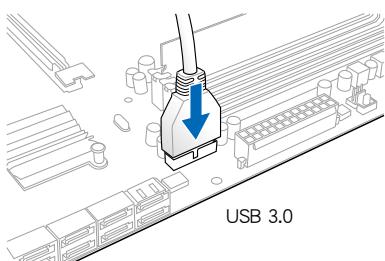
安装 USB 2.0 连接插槽



安装前面板音频连接插槽

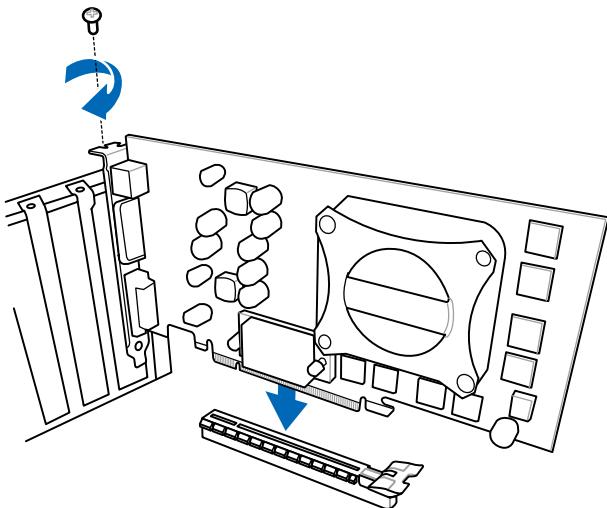


安装 USB 3.0 连接插槽



## 2.1.8 安装扩展卡

安装 PCIe x16 显卡



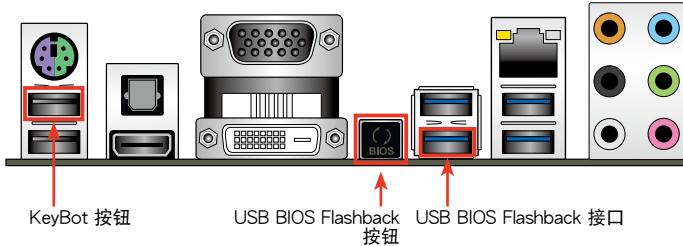
## 2.2 BIOS 更新应用程序

### 2.2.1 USB BIOS Flashback

USB BIOS Flashback 提供最简单更新 BIOS 的方法。用户可以轻松尝试使用新的 BIOS 版本来进行超频，不需要进入 BIOS 或操作系统，只要插入 USB 存储设备然后按下 BIOS Flashback 按钮三秒钟，BIOS 程序就会自动在待机状态下更新，从此以后超频无须再烦恼，并拥有无与伦比的便利性。

使用 USB BIOS Flashback：

1. 从华硕网站下载最新的 BIOS 文件。
2. 将取得的 BIOS 文件更名为 M7H.CAP。
3. 将 M7H.CAP 文件复制到 USB 便携存储设备的根目录底下。
4. 将系统关机并将 USB 存储设备插入 USB BIOS Flashback 接口。
5. 按下 ROG Connect 按钮并且当指示灯闪烁亮灯时放掉按钮，此时则表示 BIOS Flashback 功能已经启动。
6. 当指示灯停止闪烁时，即表示更新已经完成。



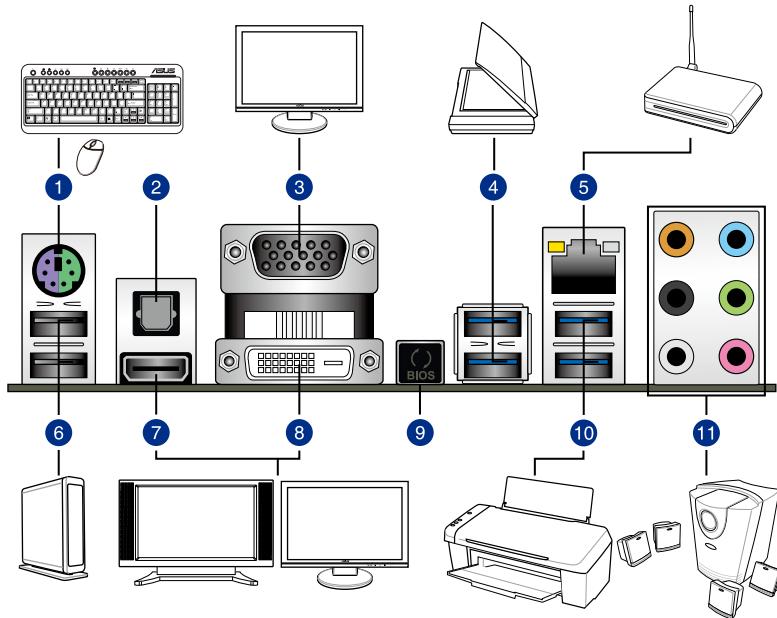
若要了解更多有关 BIOS 程序的设置方式，请参考第三章里 **更新 BIOS 程序** 的说明。



更新 BIOS 可能会有风险，若是在更新过程中发生 BIOS 程序毁损导致系统无法重新启动时，请与当地的客服中心联络寻求协助。

## 2.3 主板后侧与音频接口

### 2.3.1 后面板接口



#### 后面板接口

1. PS/2 键盘/鼠标复合接口
2. 光纤 S/PDIF 输出接口
3. VGA 显示器接口
4. Intel® USB 3.0 接口 3 和 4。下方的接口并支持 USB BIOS Flasback 功能
5. RJ-45 网络接口\*
6. Intel® USB 2.0 接口 7 和 8。上方的接口并支持 KeyBot 功能
7. HDMI 接口
8. DVI 接口
9. USB BIOS Flashback 按钮
10. Intel® USB 3.0 接口 5 和 6
11. 音频输出/输入接口\*\*

\* 与 \*\*：请参考下页表格中网络接口指示灯与音频接口的定义。



- 由于 USB 3.0 的限制，USB 3.0 设备只能在 Windows® 操作系统环境下，以及安装过 USB 3.0 驱动程序后才能使用。
- USB 3.0 设备只能用来作为数据磁盘。
- 强烈推荐您将 USB 3.0 设备连接至 USB 3.0 接口，才能让 USB 3.0 设备获得更快更好的性能表现。
- 由于 Intel 9 系列芯片组的设计，所有连接至 USB 2.0 与 USB 3.0 接口的 USB 设备都是由 xHCI 控制器所控制。有些常规的 USB 设备必须更新固件后才能拥有更好的兼容性。

#### \* 网络指示灯之灯号说明

| AAActivity 连接指示灯 |       | Speed 指示灯 |               | ACT/LINK SPEED 指示灯 | 指示灯 |
|------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|-----|
| 状态               | 说明    | 状态        | 说明            |                    |     |
| 关闭               | 没有连接  | 关闭        | 连接速度 10 Mbps  |                    |     |
| 橘色灯号             | 已连接   | 橘色灯号      | 连接速度 100 Mbps |                    |     |
| 闪烁               | 数据传输中 | 绿色灯号      | 连接速度 1 Gbps   |                    |     |

网络接口

#### \*\* 2.1、4.1、5.1 或 7.1 声道音频设置

| 接口  | 耳机 / 2.1 声道 | 4.1 声道 | 5.1 声道       | 7.1 声道       |
|-----|-------------|--------|--------------|--------------|
| 浅蓝色 | 声音输入端       | 声音输入端  | 声音输入端        | 声音输入端        |
| 草绿色 | 声音输出端       | 前置音箱输出 | 前置音箱输出       | 前置音箱输出       |
| 粉红扫 | 麦克风输入       | 麦克风输入  | 麦克风输入        | 麦克风输入        |
| 橘色  | -           | -      | 中央声道/重低音音箱输出 | 中央声道/重低音音箱输出 |
| 黑色  | -           | 后置音箱输出 | 后置音箱输出       | 后置音箱输出       |
| 灰色  | -           | -      | -            | 侧边音箱输出       |

### 2.3.2 音频输出/输入连接图标说明

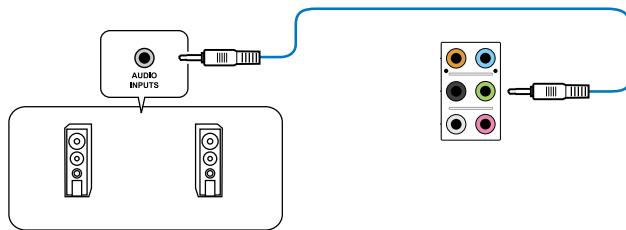
#### 音频输出/输入接口



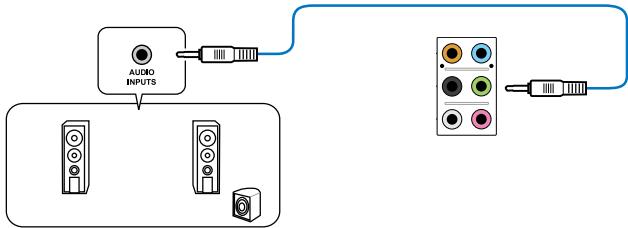
### 连接耳机与麦克风



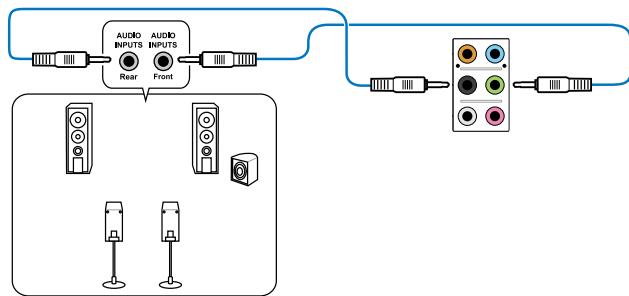
### 连接立体声音箱



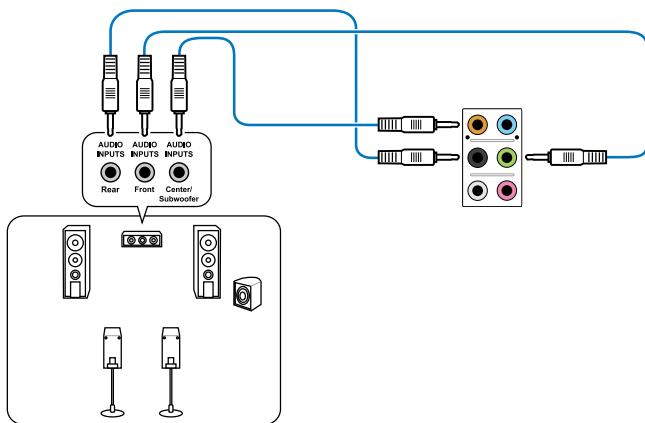
### 连接 2.1 声道音箱



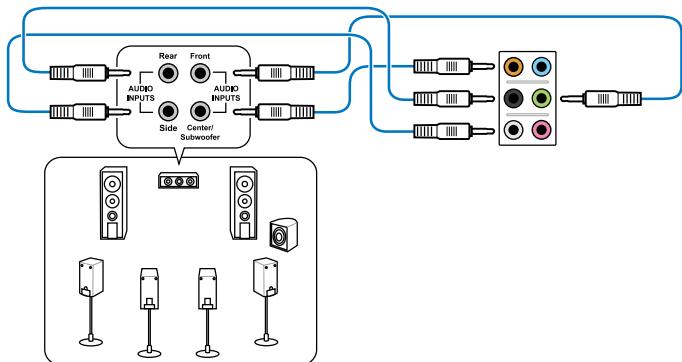
### 连接 4.1 声道音箱



### 连接 5.1 声道音箱



## 连接 7.1 声道音箱



## 2.4 第一次启动电脑

1. 确认所有排线与接脚都接妥，然后盖上机箱的外盖。
2. 确定所有的开关都已关闭
3. 将电源线接上机箱背面的电输入插座。
4. 情况许可的话，最好将电源线路上加接突波吸收/保护器。
5. 您可以先开启以下周边的电源：
  - a. 显示器
  - b. 外接式 SCSI 接口外围设备（从串连的最后端开始）
  - c. 系统电源
6. 送电之后，机箱面板上应该会有电源指示灯亮起才对。如果是使用 ATX 电源的话，必须等到面板按钮被触碰后才会启动电源，电源指示灯此时才会亮起。如果您的电脑符合绿色省电标准，已随时准备可以进入省电模式的话，显示器指示灯也会亮起。如果启动过程一切顺利的话，不久就可以在显示器上看到画面了，如果送电之后超过 30 秒而画面未有动静的话，表示电脑的设置尚有问题存在，请再进一步地的检查各项动作，如果还是不行，就需要向厂商求助了！

### BIOS 哗声所代表的意义

| 哔声                    | 代表意义                                |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 一短哔声                  | 检测到 VGA 显卡<br>快速启动设置为关闭<br>没有键盘被检测到 |
| 一连续哔声后跟随两短哔声，暂停一下然后重复 | 没有内存被检测到                            |
| 一连续哔声后跟随三短哔声          | 没有 VGA 显卡被检测到                       |
| 一连续哔声后跟随四短哔声          | 硬件组件失效                              |

7. 在电源开启之后可按下 <Del> 键以进入 BIOS 的设置模式，详细设置方法请看本用户手册的第三章内容。

## 2.5 关闭电源

当系统在启动状态，压着电源开关少于四秒钟，系统会根据 BIOS 的设置，进入睡眠或热启动模式；若是压着电源开关多于四秒，不论 BIOS 的设置为何，系统则会直接进入热启动模式。

## 第二章

# 第三章

## 3.1 认识 BIOS 程序



华硕全新的 UEFI BIOS 是可延伸固件界面，符合最新的 UEFI 结构，这个友善的使用界面，跳脱常规使用键盘输入 BIOS 方式，提供更有弹性与更便利的鼠标控制操作。您可以轻易地使用新的 UEFI BIOS，如同操作您的操作系统般顺畅。在本用户手册中的「BIOS」一词除非特别说明，所指皆为「UEFI BIOS」。

BIOS (Basic Input and Output System；基本输出入系统) 用来存储系统启动时所需要的硬件设置，例如存储设备设置、超频设置、高级电源管理与启动设置等，这些设置会存储在主板的 CMOS 中，在正常情况下，默认的 BIOS 程序设置提供大多数使用情况下可以获得最佳的运作性能，推荐您不要变更默认的 BIOS 设置，除了以下几种状况：

- 在系统启动期间，屏幕上出现错误信息，并要求您运行 BIOS 程序设置。
- 安装新的系统元件，需要进一步的 BIOS 设置或更新。



不适当的 BIOS 设置可能会导致系统不稳定或启动失败，强烈推荐您只有在受过训练专业人士的协助下，才可以运行 BIOS 程序设置的变更。



下载或更新 BIOS 文件时，请将文件名称变更为 M7H.CAP 给本主板使用。

## 3.2 BIOS 程序设置

使用 BIOS Setup (BIOS 设置) 功能可以更新 BIOS 或设置其参数。BIOS 设置画面包含导览键与简要的画面辅助说明，以指示您使用 BIOS 设置程序。

当启动时进入 BIOS 设置程序：

- 当进入开机自检 (POST) 过程时，按下 <Delete> 键可以进入 BIOS 设置画面。若您未按下 <Delete> 键，则开机自检 (POST) 功能会继续进行。

当 POST 结束后才进入 BIOS 设置程序：

- 按下 <Ctrl>+<Alt>+<Delete> 键。
- 或是按下机箱上的 RESET (重置) 键重新启动。
- 或是将按下机箱上的电源按钮，将电脑关闭后再重新启动。如果前两种方式无效，再选用最后一种方式。
- 然后再于开机自检 (POST) 过程时按下 <Delete> 键进入 BIOS 设置画面。



- 在本章节的 BIOS 程序画面只能参考，将可能与您所见到的画面有所差异。
- 若您想在 BIOS 设置程序中使用鼠标操控，请先确认已将 USB 接口鼠标连接至主板。
- BIOS 程序的出厂默认值可让系统运作处于最佳性能，但是若系统因您改变 BIOS 程序而导致不稳定，请读取出厂默认值来保持系统的稳定。请选择 Exit 菜单中的 Load Optimized Defaults 项目或按下 <F5> 键，请参阅 退出 BIOS 程序 一节中的详细说明。
- 若是变更 BIOS 设置后启动失败，请试着使用清除 CMOS，然后将主板的设置值恢复为默认值。请参考 主板上的内置开关 一节关于 CMOS 配置数据清除按钮 (CLR\_CMOS) 的说明。
- BIOS 设置程序不支持蓝牙设备。

### BIOS 菜单画面

本主板的 BIOS 设置程序提供您 EZ Mode 和 Advanced Mode 两种模式。您可以由 Exit 菜单中切换，或是选择 EZ Mode/Advanced Mode 菜单中的 Exit/Advanced Mode。

### 3.2.1 EZ Mode

您可在 EZ Mode 中查看系统基本数据，并可以选择显示语言、喜好设置及启动设备顺序。若要进入 Advanced Mode，请点击 Exit/Advanced Mode 然后选择 Advanced Mode，或是按下 <F7> 快捷键。



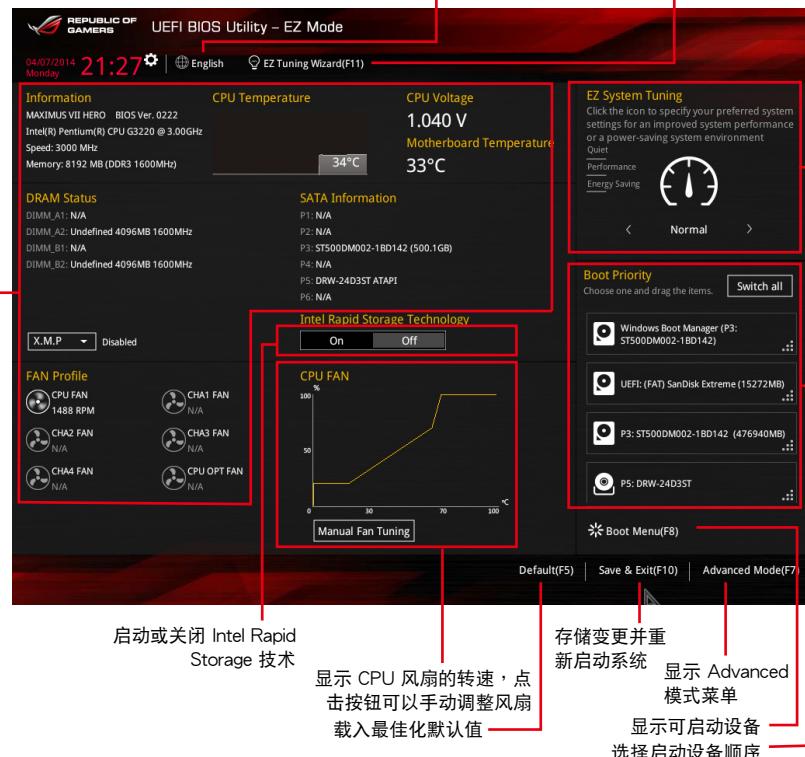
进入 BIOS 设置程序的画面可以做个人化设置，请参考 启动菜单 (Boot menu) 中关于 Setup Mode 项目的说明。

本项目显示 CPU/主板温度、CPU 电压输出及 CPU/机箱/电源风扇速度与 SATA 信息

显示已选择模式的系统属性，点击 < 或 > 来切换 EZ System 调整模式

选择欲使用的语言

创建存储设备 RAID 与设置系统超频



启动或关闭 Intel Rapid Storage 技术

显示 CPU 风扇的转速，点击按钮可以手动调整风扇载入最佳化默认值

存储变更并重新启动系统  
显示 Advanced 模式菜单  
显示可启动设备  
选择启动设备顺序



启动设备的选项将依您所安装的设备而异。

### 3.2.2 Advanced Mode

Advanced Mode 提供您更高级的 BIOS 设置选项。以下为 Advanced Mode 画面之范例，各个设置选项的详细说明请参考之后的章节。



若要从 EZ Mode 切换至 Advanced Mode，请点击 Advanced Mode (F7) ，或是按下 <F7> 快捷键。



## 功能表列

BIOS 设置程序最上方各菜单功能说明如下：

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| My Favorites    | 本项目将记录时常使用的系统设置及设置值。         |
| Extreme Tweaker | 本项目提供超频设置。                   |
| Main            | 本项目提供系统基本设置。                 |
| Advanced        | 本项目提供系统高级功能设置。               |
| Monitor         | 本项目提供温度、电源及风扇功能设置。           |
| Boot            | 本项目提供启动磁盘设置。                 |
| Tool            | 本项目提供特殊功能设置。                 |
| Exit            | 本项目提供退出 BIOS 设置程序与出厂默认值还原功能。 |

## 菜单项目

于功能表列选定选项时，被选择的功能将会反白，即选择 Main 菜单所出现的项目。

点击菜单中的其他项目（例如：My Favorites、Extreme Tweaker、Advanced、Monitor、Boot 与 Exit）也会出现该项目不同的选项。

## 子菜单

在菜单画面中，若功能选项前面有一个小三角形标记，代表此为子菜单，您可利用方向键来选择，并按下 <Enter> 键来进入子菜单。

## 语言

这个按钮位在功能表列的上方，用来选择 BIOS 程序界面显示的语言。点击这个按钮来选择您想要的 BIOS 画面显示语言。

## 我的最爱 (F3)

这个按钮位在功能表列的上方，用来以树状图显示所有的 BIOS 项目。选择常用的 BIOS 设置项目并存储至我的最爱菜单。



请参考 我的最爱 (My Favorites) 一节以获得更多信息。

## Qfan Control (F6)

这个按钮位在功能表列的上方，用来显示风扇现在的设置。使用这个按钮来手动调整风扇至您想要的设置值。

## EZ Tuning 向导 (F11)

这个按钮位在功能表列的上方，用来查看和调整系统的超频设置，也可以让您将主板的 SATA 模式从 AHCI 变更为 RAID 模式。

## 快速笔记 (F9)

按下此按钮，可让您针对已在 BIOS 中进行的设置输入笔记。



- 快速笔记不支持以下键盘功能：删除、剪下、复制与贴上。
- 您只能使用英文字母与数字来输入笔记。

## 快捷键

这个按钮位在功能表列的上方，包含有 BIOS 程序设置的导引方向键，使用箭头按键来选择菜单中的项目并变更设置。

## 滚动条

在菜单画面的右方若出现滚动条，即代表此页选项超过可显示的画面，您可利用上/下方向键或是 PageUp/PageDown 键来切换画面。

## 在线操作说明

在菜单画面的右上方为当前所选择的作用选项的功能说明，此说明会依选项的不同而自动变更。使用 <F12> 按键来抓取 BIOS 屏幕画面，并存储至携带式存储设备。

## 设置值

此区域显示菜单项目的设置值。这些项目中，有的功能选项只为告知用户当前运行状态，并无法更改，此类项目就会以淡灰色显示。而可更改的项目，当您使用方向键移动项目时，被选择的项目以反白显示。

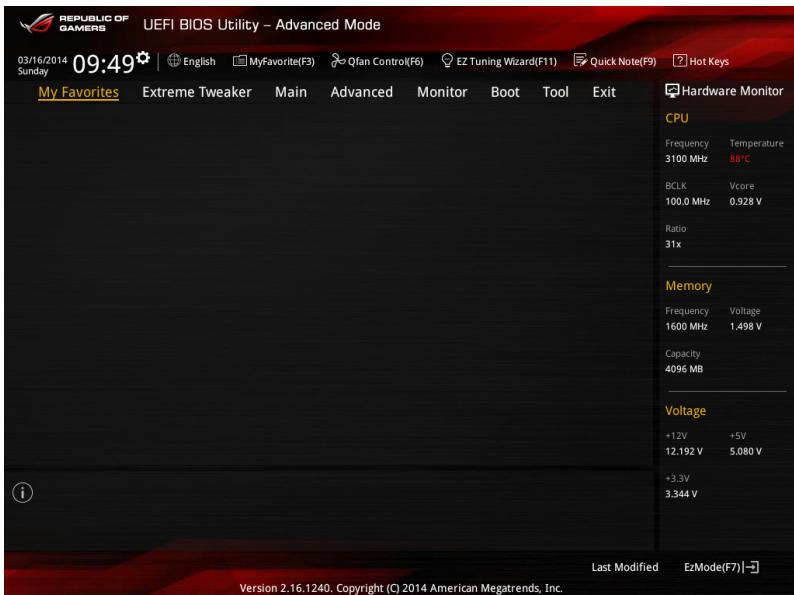
设置值被选择后以反白显示。要改变设置值请选择此项目，并按下 <Enter> 键以显示设置值列表。

## 上次修改的设置按钮

按下此按钮可查看您在 BIOS 设置中上一次所做的修改项目。

### 3.3 我的最爱 (My Favorites) 菜单

本菜单是专属您个人空间，让您在此轻易存入和读取您所喜爱的 BIOS 项目。



#### 增加项目至我的最爱

请依照以下步骤增加项目至我的最爱：

1. 按下 **<F3>** 键或是点击 **MyFavorite(F3)**，来启动设置树状图画面。
2. 在设置树状图画面中选择子菜单中想要存储至我的最爱的选项，再点击或轻触 "+" 以存储至我的最爱的 BIOS 项目。



以下项目无法加入至我的最爱：

- 有子菜单的项目。
- 用户自订项目，例如：语言、启动设备顺序。
- 设置项目，例如：内存 SPD 信息、系统时间与日期。

## 3.4 Extreme Tweaker 菜单

本菜单可让您设置超频功能的相关选项。



注意！在您设置本高级菜单的设置时，不正确的设置值将导致系统功能异常。



以下项目中所默认的数值，可能会随您所安装在主板上的 CPU 型式与内存条而有所不同。

将滚动条往下滚动来显示以下项目。



### Ai Overclock Tuner [Auto]

本项目可以让您设置 CPU 的超频选项来达到您所想要的 CPU 内频。请选择以下任一种默认的超频选项：

[Auto] 自动载入系统最佳化设置值。

[Manual] 可让您独立设置超频参数。

[X.M.P.] 若您安装的内存有支持 eXtreme Memory Profile (X.M.P.) 技术，请选择本项目来设置内存参数有效运作。



当您安装支持 eXtreme Memory Profile [X.M.P.] 技术的内存条时，才会显示 [X.M.P.] 设置选项。



以下的项目只当 Ai Overclocking Tuner 设为 [Manual] 或 [X.M.P.] 时才会显示。

#### Filter PLL [Auto]

在当运行高或低 BCLK 时，提供您选择 BCLK（基本时序）模式。设置值有：[Auto] [Low BCLK Mode] [High BCLK Mode]

#### BCLK Frequency [100]

提供您设置 BCLK 频率以增强系统性能。使用 <+> 或 <-> 键以调整数值。数值的范围为从 80.0MHz 至 300.0MHz。



当 Ai Overclocking Tuner 设为 [X.M.P.] 且安装支持 XMP 模式的内存条时才会显示。

#### ASUS MultiCore Enhancement [Enabled]

[Auto] 默认值为 [Auto] 时，在 XMP/Manual/User-defined 内存频率模式下可获得最佳化性能。

[Disabled] 本项目用来设置默认的核心比率。

#### CPU Core Ratio [Sync All Cores]

本项目用来设置 CPU 比值与自动同步、每个核心或所有核心。设置值有：[Auto] [Sync All Cores] [Per Core]



当 CPU Core Ratio 设置为 [Sync All Cores] 时会出现以下项目：

#### 1-Core Ratio Limit [Auto]

选择 [Auto] 以应用 CPU 默认的 Turbo 倍频设置，或是手动指定 1-Core Ratio Limit 数值高于或等于 2-Core Ratio Limit。



当 CPU Core Ratio 设置为 [Per Core] 时会出现以下项目：

#### 1-Core Ratio Limit [Auto]

选择 [Auto] 以应用 CPU 默认的 Turbo 倍频设置，或是手动指定 1-Core Ratio Limit 数值高于或等于 2-Core Ratio Limit。

#### 2-Core Ratio Limit [Auto]

选择 [Auto] 以应用 CPU 默认的 Turbo 倍频设置，或是手动指定 2-Core Ratio Limit 数值高于或等于 3-Core Ratio Limit。

#### 3-Core Ratio Limit [Auto]

选择 [Auto] 以应用 CPU 默认的 Turbo 倍频设置，或是手动指定 3-Core Ratio Limit 数值高于或等于 4-Core Ratio Limit。

#### 4-Core Ratio Limit [Auto]

选择 [Auto] 以应用 CPU 默认的 Turbo 倍频设置，或是手动指定 4-Core Ratio Limit 数值高于或等于 3-Core Ratio Limit。



若您要指派一个数值给更多的 Core Ratio Limit，请不要将其 Core Ratio Limit 设置为 [Auto]。

#### Min CPU Cache Ratio [Auto]

本项目用来设置处理器的 Uncore ratio 值至可能的最小值。使用 <+> 或 <-> 键调整数值，数值范围会依所安装的处理器为准。

#### Max CPU Cache Ratio [Auto]

本项目用来设置处理器的 Uncore ratio 值至可能的最大值。使用 <+> 或 <-> 键调整数值，数值范围会依所安装的处理器为准。

#### Internal PLL Overvoltage [Auto]

本项目用来设置 Internal PLL 电压，让 K 型号的处理器能获得最大的超频性能。  
设置值有：[Auto] [Enabled] [Disabled]

#### CPU Ratio Tuner [Auto]

启用本项目可以增强 non-K 系列处理器的性能。设置值有：[Auto] [Enabled] [Disabled]

#### BCLK Frequency : DRAM Frequency Ratio [Auto]

本项目用来设置 BCLK 频率至 DRAM 频率倍频。

[Auto] BCLK 频率至 DRAM 频率设为最佳化设置值。

[100 : 133] BCLK 频率至 DRAM 频率倍频设置为 100 : 133。

[100 : 100] BCLK 频率至 DRAM 频率倍频设置为 100 : 100。

#### DRAM Frequency [Auto]

本项目可以让您设置内存的运作频率。设置选项会随着 BCLK (基础时序) Frequency 设置值变动，选择 Auto 模式以应用最佳化设置。设置值有：[DDR3-800MHz] [DDR3-1066MHz] [DDR3-1333MHz] [DDR3-1400MHz] [DDR3-1600MHz] [DDR3-1800MHz] [DDR3-1866MHz] [DDR3-2000MHz] [DDR3-2133MHz] [DDR3-2200MHz] [DDR3-2400MHz] [DDR3-2600MHz] [DDR3-2666MHz] [DDR3-2800MHz] [DDR3-2933MHz] [DDR3-3000MHz] [DDR3-3200MHz] [DDR3-3400MHz]

#### Xtreme Tweaking [Disabled]

本项目会增强部分测试性能。设置值有：Enabled] [Disabled]

#### Max. CPU Graphics Ratio [Auto]

提供您自动最佳化 CPU Graphic Ratio 或以手动方式设置一个最佳的 CPU Graphic Ratio (倍频) 数值。使用 <-> 或 <+> 键调整数值。此最小数值会依照所安装的 CPU 而定。



此项倍频可能会因系统负载而有所不同。

## CPU Level Up [Auto]

提供您选择 CPU 层级，且这个可选择的参数会依照所选择的 CPU level 而有自动调整。



CPU Level 数值会因您实际安装的处理器而有所不同。

## EPU Power Saving Mode [Disabled]

启用或关闭 EPU 省电功能。设置值有：[Disabled] [Enabled]

## DRAM Timing Control

本菜单中的项目可让您设置 DRAM timing 控制功能，您可以使用 <+> 与 <-> 键调整数值。当您要恢复默认值时，请使用键盘输入 <auto> 并按下 <Enter> 键。

### Primary Timings

#### DRAM CAS# Latency [Auto]

设置值有：[Auto] [1] - [31]

#### DRAM RAS# to CAS# Delay [Auto]

设置值有：[Auto] [1] - [31]

#### DRAM RAS# PRE Time [Auto]

设置值有：[Auto] [1] - [31]

#### DRAM RAS# ACT Time [Auto]

设置值有：[Auto] [1] - [63]

#### DRAM COMMAND Rate [Auto]

设置值有：[Auto] [1] - [2]

### Secondary Timings

#### DRAM RAS# to RAS# Delay [Auto]

设置值有：[Auto] [1] - [15]

#### DRAM REF Cycle Time [Auto]

设置值有：[Auto] [1] - [511]

#### DRAM Refresh Interval [Auto]

设置值有：[Auto] [1] - [65535]

#### DRAM WRITE Recovery Time [Auto]

设置值有：[Auto] [1] - [16]

#### DRAM READ to PRE Time [Auto]

设置值有：[Auto] [1] - [15]

#### DRAM FOUR ACT WIN Time [Auto]

设置值有：[Auto] [1] - [255]

#### DRAM WRITE to READ Delay [Auto]

设置值有：[Auto] [1] - [15]

### DRAM CKE Minimum pulse Width [Auto]

设置值有 : [Auto] [1] - [15]

### DRAM CAS# Write Latency [Auto]

设置值有 : [Auto] [1] - [31]

### RTL IOL control

DRAM RTL Initial Value [Auto]

设置值有 : [Auto] [1] - [63]

DRAM RTL(CHA\_R0D0) [Auto]

设置值有 : [Auto] [1] - [63]

DRAM RTL(CHA\_R0D1) [Auto]

设置值有 : [Auto] [1] - [63]

DRAM RTL(CHA\_R1D0) [Auto]

设置值有 : [Auto] [1] - [63]

DRAM RTL(CHA\_R1D1) [Auto]

设置值有 : [Auto] [1] - [63]

DRAM RTL(CHB\_R0D0) [Auto]

设置值有 : [Auto] [1] - [63]

DRAM RTL(CHB\_R0D1) [Auto]

设置值有 : [Auto] [1] - [63]

DRAM RTL(CHB\_R1D0) [Auto]

设置值有 : [Auto] [1] - [63]

DRAM RTL(CHB\_R1D1) [Auto]

设置值有 : [Auto] [1] - [63]

DRAM IO-L(CHA\_R0D0) [Auto]

设置值有 : [Auto] [1] - [15]

DRAM IO-L(CHA\_R0D1) [Auto]

设置值有 : [Auto] [1] - [15]

DRAM IO-L(CHA\_R1D0) [Auto]

设置值有 : [Auto] [1] - [15]

DRAM IO-L(CHA\_R1D1) [Auto]

设置值有 : [Auto] [1] - [15]

DRAM IO-L(CHB\_R0D0) [Auto]

设置值有 : [Auto] [1] - [15]

DRAM IO-L(CHB\_R0D1) [Auto]

设置值有 : [Auto] [1] - [15]

DRAM IO-L(CHB\_R1D0) [Auto]

设置值有 : [Auto] [1] - [15]

DRAM IO-L(CHB\_R1D1) [Auto]

设置值有 : [Auto] [1] - [15]

### Third Timings

#### tRDRD [Auto]

设置值有 : [Auto] [1] - [7]

[tRDRD\\_dr \[Auto\]](#)

设置值有：[Auto] [1] - [15]

[tRDRD\\_dd \[Auto\]](#)

设置值有：[Auto] [1] - [15]

[tWRD \[Auto\]](#)

设置值有：[Auto] [1] - [63]

[tWRD\\_dr \[Auto\]](#)

设置值有：[Auto] [1] - [15]

[tWRD\\_dd \[Auto\]](#)

设置值有：[Auto] [1] - [15]

[tWRWR \[Auto\]](#)

设置值有：[Auto] [1] - [7]

[tWRWR\\_dr \[Auto\]](#)

设置值有：[Auto] [1] - [15]

[tWRWR\\_dd \[Auto\]](#)

设置值有：[Auto] [1] - [15]

[Dec\\_WRD \[Auto\]](#)

设置值有：[Auto] [0] [1]

[tRDWR \[Auto\]](#)

设置值有：[Auto] [1] - [31]

[tRDWR\\_dr \[Auto\]](#)

设置值有：[Auto] [1] - [31]

[tRDWR\\_dd \[Auto\]](#)

设置值有：[Auto] [1] - [31]

[Misc.](#)[MRC Fast Boot \[Auto\]](#)

本项目提供启用、关闭或自动设置 MRC 快速启动功能。设置值有：[Auto] [Enabled] [Disabled]

[DRAM CLK Period \[Auto\]](#)

设置值有：[Auto] [1] - [14]

[Channel A DIMM Control \[Enable Both DIMMS\]](#)

提供您启用或关闭 Channel A 内存插槽采用以下的设置值。设置值有：[Enable Both DIMMS] [Disable DIMM0] [Disable DIMM1] [Disable Both DIMMS]

[Channel B DIMM Control \[Enable Both DIMMS\]](#)

提供您启用或关闭 Channel B 内存插槽采用以下的设置值。设置值有：[Enable Both DIMMS] [Disable DIMM0] [Disable DIMM1] [Disable Both DIMMS]

[Scramble Setting \[Optimized \(ASUS\)\]](#)

将本项设置为 [Optimized (ASUS)] 以增强系统稳定性。设置值有：[Optimized (ASUS)] [Default (MRC)]

MCH Full Check [Auto]

设置本项为 [Enabled]，可以增强系统稳定性。设置为 [Disabled]，则可以增强 DRAM 超频的兼容性：[Auto] [Enabled] [Disabled]

DQ Sense Amplifier [Auto]

通常用在协助降低超频与过电压。设置值有：[Auto] [+16] - [-29]

DQS Sense Amplifier [Auto]

通常用在协助降低超频与过电压。设置值有：[Auto] [+16] - [-29]

CMD Sense Amplifier [Auto]

通常用在协助降低超频与过电压。设置值有：[Auto] [+16] - [-29]

DRAM Additional Training [Auto]

通常用在协助降低超频与过电压。设置值有：[Auto] [Enabled] [Disabled]

Skew ControlTransmitter Rising Slope [Auto]

设置值有：[Auto]

Transmitter Falling Slope [Auto]

设置值有：[Auto]

Transmitter Control Time [Auto]

设置值有：[Auto]

Receiver Rising Slope [Auto]

设置值有：[Auto]

Receiver Falling Slope [Auto]

设置值有：[Auto]

Receiver Control Time [Auto]

设置值有：[Auto]

GPU.DIMM Post

本项目自动检测和显示安装的 PCIe 设备与内存状态。若该字段显示为 N/A，则表示该插槽并未安装此设备。

## External DIGI+ Power Control

### CPU Load-Line Calibration [Auto]

Load-line 是根据 Intel® 所订立之 VRM 规格，其设置值将影响 CPU 电压。CPU 运作电压将依 CPU 的负载呈比例性递减，当您将此项目的设置值设置越高时，将可提高电压值与超频能力，但会增加 CPU 及 VRM 的温度。请从 Level 1 至 9 来调整处理器电源电压从 0% 至 100%。设置值有：[Auto] [Level 1] - [Level 9]



实际提升的性能将视 CPU 型号而异。



请勿将散热系统移除，散热环境需受到监控。

### CPU VRM Switching Frequency [Auto]

本项目会影响 VRM 暂态响应速度与元件温度的生成。选择 [Manual] 设置较高的频率可以获得较快的暂态响应速度。设置值有：[Auto] [Manual]



请勿将散热系统移除，散热环境需受到监控。



以下项目只有在 CPU VRM Switching Frequency 设置为 [Manual] 时才会出现。

### Fixed CPU VRM Frequency (KHz) [300]

本项目可让您设置固定的 VRM 频率。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值。数值以 50KHz 为间隔，变更的范围由 300KHz 至 500KHz。



当已选择手动模式时，请勿将散热系统移除，散热环境需受到监控。



以下项目只当 CPU VRM Switching Frequency 设为 [Auto] 时才会出现。

### VRM Spread Spectrum [Disabled]

本项目可让您增加系统稳定性。设置值有：[Disabled] [Enabled]

### CPU Power Phase Control [Auto]

本项目用来依照 CPU 的需求控制电源相数。设置值有：[Auto] [Standard] [Optimized] [Extreme] [Power Phase Response]



当已选择设置本项目为 [Power Phase Response] 时，请勿将散热系统移除，散热环境需受到监控。

### CPU Power Duty Control [T.Probe]

DIGI+ VRM Duty control 用来调整每个 VRM 相数的电流与散热环境。

[T.Probe] 维持各相散热平衡。

[Extreme] 维持各相电流平衡。



请勿将散热系统移除，散热环境需受到监控。

### CPU Current Capability [Auto]

本项目用来设置总电力范围，同时扩展超频频率的范围。当系统超频，或是 CPU 在较高负载需要获得额外的电力支持时，请选择较高的数值。设置值有：[Auto] [100%] [110%] [120%] [130%] [140%]

### CPU Input Boot Voltage [Auto]

VCCIN 为 CPU 启动权。设置值有：[Auto] [0.800] - [2.440V]

## Tweakers' Paradise

本子菜单里的项目为提供设置处理器的倍频与功能。

### BCLK Tuning

#### VCCIN Shadow Voltage [Auto]

提供您设置 VCCIN 虚拟电压。设置值有：[Auto] [0.800] - [2.440V]

#### Termination Anti-Aliasing [Auto]

本项目启用后，可以让 PLL Termination Voltage 的变化更为顺畅，以协助您生成一个较好的超频结果。设置值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]

#### Initial PLL Termination Voltage [Auto]

初始电压为 CPU BCLKs 终止。维持一个接近 CPU 输入电压等级将可以协助 BCLK 超频。设置值有：[Auto] [0.0000] - [3.0000]

#### PLL Termination Reset Voltage [Auto]

设置 PLL Termination Reset 电压。设置值有：[Auto] [0.0000] - [3.0000]

#### Eventual PLL Termination Voltage [Auto]

设置最终的 PLL 终端电压。设置值有：[Auto] [0.0000] - [3.0000]

#### PCH ICC Voltage [Auto]

集成式时序控制器的电源（PSU），较低的数值会比较好。

#### Clock Crossing VBoot [Auto]

这个瞬间电压值为当上升至 BCLK DN 边缘等同于下降至 BCLK DP 边缘。

#### Clock Crossing Reset Voltage [Auto]

这个瞬间电压值为当上升至 BCLK DN 边缘等同于下降至 BCLK DP 边缘。

#### Clock Crossing Voltage [Auto]

这个瞬间电压值为当上升至 BCLK DN 边缘等同于下降至 BCLK DP 边缘。

## Internal CPU Power Management

这个子菜单为您提供您设置处理器倍频与频率。

### Enhanced Intel SpeedStep Technology [Enabled]

提供操作系统动态调整处理器电压与核心频率以降低耗电量与帮助散热。设置值有：[Enabled] [Disabled]

### Turbo Mode [Enabled]

本项目提供让您处理器核心在特定情况下采用比标示频率更快的速度运作。设置值有：[Disabled] [Enabled]




---

以下的项目只当 Turbo Mode 设置为 [Enabled] 时才会显示。

---

### Turbo Mode Parameters

#### Long Duration Package Power Limit [Auto]

提供您限制 Turbo Ratio 的持续时间超过 TDP (Thermal Design Power) 以获得最大性能。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，数值的范围为从 1W 到 4096W。

#### Package Power Time Window [Auto]

亦称为 Power Limit 1，并且提供您维持在 Turbo Ratio 上的 TDP (Thermal Design Power) 时间窗口。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，数值的范围为从 1 秒至 127 秒。

#### Short Duration Package Power Limit [Auto]

亦称为 Power Limit 2，当封包电源超过 Power Limit 1 时，提供您快速的防护。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，数值的范围为从 1W 至 4096W。

#### CPU Integrated VR Current Limit [Auto]\*

提供您设置一个较高的电流限值，以防止在超频时的频率和功率的限制。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值为以 0.125 为间隔，变更的范围从 0.125 至 1023.875。

#### CPU Internal Power Switching Frequency

#### Frequency Tuning Mode [Auto]

提供您增加或降低内部稳压器的开关频率。降低的话有助于消耗较少的功率，或增加则会有助于电压稳定。当本项目设为 [+] 或 [-] 时，会显示 Frequency Tuning Offset 项目，且提供您可设置其数值范围从 0% 至 6%。

#### CPU Internal Power Fault Control

#### Thermal Feedback [Auto]

当外部稳压器的散热条件超出门槛值时，允许处理器采取预防措施。设置值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]

#### CPU Integrated VR Fault Management [Auto]

当发生过电压时，提供您预防 Fully Integrated Voltage Regulator 的跳脱。设置值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]




---

当进行超频时，推荐您将本项设置为 [Disable]。

---

## CPU Internal Power Configuration

### CPU Integrated VR Efficiency Management [Auto]

当处理器处于低功率状态时，允许您提高电源省电。在 Fully Integrated Voltage Regulator 所有高性能运作下则禁用此项目。设置值有：[Auto] [High Performance] [Balanced]

### Power Decay Mode [Auto]

提供您启用这个项目以改善 Fully Integrated Voltage Regulator 如处理器进入低电流状态。设置值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]

### Idle Power-in Response [Auto]

提供您设置 Fully Integrated Voltage Regulator 为较慢的速率，如同进入手动操作模式。设置值有：[Auto] [Regular] [Fast]

### Idle Power-out Response [Auto]

提供您设置 Fully Integrated Voltage Regulator 为较慢的速率，如同退出手动操作模式。设置值有：[Auto] [Regular] [Fast]

### Power Current Slope [Auto]

提供您调整高速启动相位电流平衡在负载瞬变期间时的渐变，以消除电流的不平衡。此会导致从靠近开关频率的负载电流震荡。设置值有：[Auto] [LEVEL -4] - [LEVEL 4]

### Power Current Offset [Auto]

提供您增加或降低由处理器所检测到的输出电流。找到之间的平衡点，同时从以下选择保持最佳调节的电流门槛。设置值有：[Auto] [100%] [87.5%] [75.0%] [62.5%] [50.0%] [37.5%] [25.0%] [12.5%] [0%] [-12.5%] [-25.0%] [-37.5%] [-50.0%] [-62.5%] [-75.0%] [-87.5%] [-100%]

### Power Fast Ramp Response [Auto]

提供您增加以加强在瞬间负载的电压调节器的响应。设置值有：[Auto] [0.00] - [1.50]

## CPU Internal Power Saving Control

### Power Saving Level 1 Threshold [Auto]

设置低数值以承受超频限度并扩大超频可能性、设置高数值以提供较佳的省电情形。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值以 1Amp 为间隔，变更的范围从 0A 至 80A。

### Power Saving Level 2 Threshold [Auto]

设置低数值以承受超频限度并扩大超频可能性、设置高数值以提供较佳的省电情形。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值以 1Amp 为间隔，变更的范围从 0A 至 50A。

### Power Saving Level 3 Threshold [Auto]

设置低数值以承受超频限度并扩大超频可能性、设置高数值以提供较佳的省电情形。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值以 1Amp 为间隔，变更的范围从 0A 至 30A。

### CPU Core Voltage [Auto]

本项目用来设置处理器核心的电压源总量。当核心频率增加时请增加电压总量。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值。设置值以 0.003125V 为间隔，变更的范围从 1.050000V 至 2.200000V。设置值有：[Auto] [Manual Mode] [Offset Mode]



以下项目只有在 CPU Core Voltage 设置为 [Manual Mode] 时才会出现。

### CPU Core Voltage Override [Auto]

本项目用来设置处理器核心电压复写。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值以 0.001V 为间隔，变更的范围从 0.001V 至 1.920V。



以下项目只有在 CPU Core Voltage 设置为 [Offset Mode] 时才会出现。

### Offset Mode Sign [+]

- |       |            |
|-------|------------|
| [+]   | 设置正数值偏移电压。 |
| [ - ] | 设置负数值偏移电压。 |

#### CPU Core Voltage Offset

本项目提供设置 CPU Core Voltage Offset 数值。

### CPU Cache Voltage [Auto]

本项目用来设置处理器非核心部份（包含缓存）的电压馈电数量。当环形控制器频率增加时请提高电压数量。设置值有：[Auto] [Manual Mode] [Offset Mode] [Adaptive Mode]



以下项目只有在 CPU Cache Voltage 设置为 [Manual Mode] 时才会出现。

### CPU Cache Voltage Override [Auto]

本项目用来设置处理器缓存电压复写。默认值为依照安装的处理器所得的标准数值。



以下项目只有在 CPU Cache Voltage 设置为 [Offset Mode] 时才会出现。

### Offset Mode Sign [+]

- |       |            |
|-------|------------|
| [+]   | 设置正数值偏移电压。 |
| [ - ] | 设置负数值偏移电压。 |

#### CPU Cache Voltage Offset

本项目用来设置 CPU Cache Voltage Offset。默认值为依照安装的处理器所得的标准数值。

### CPU Graphics Voltage [Auto]

本项目用来设置集成式绘图处理器（iGPU）的电压数量。当 iGPU 频率增加时请提高电压数量。设置值有：[Auto] [Manual Mode] [Offset Mode] [Adaptive Mode]



以下项目只有在 CPU Graphics Voltage 设置为 [Manual Mode] 时才会出现。

#### CPU Graphics Voltage Override [Auto]

本项目用来设置 CPU 显示电压复写。默认值为依照安装的处理器所得的标准数值。



以下项目只有在 CPU Graphics Voltage 设置为 [Offset Mode] 时才会出现。

#### Offset Mode Sign [+]

- [+] 设置正数值偏移电压。
- [ - ] 设置负数值偏移电压。

CPU Graphics Voltage Offset

本项目提供设置 CPU Graphics Voltage Offset 数值。



以下项目只有在 CPU Graphics Voltage 设置为 [Adaptive Mode] 时才会出现。

#### Offset Mode Sign [+]

- [+] 设置正数值偏移电压。
- [ - ] 设置负数值偏移电压。

CPU Graphics Voltage Offset

本项目提供设置 CPU Graphics Voltage Offset 数值。

#### Additional Turbo Mode CPU Graphics Voltage [Auto]

本项目用来为 Turbo 模式中的 CPU 显示增加电压。默认值为依照安装的处理器所得的标准数值。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值以 0.001V 为间隔，变更的范围从 0.001V 至 1.920V。

#### Total Adaptive Mode CPU Graphics Voltage [Auto]

本项目总和 CPU Graphics Voltage Offset 与 Additional Turbo Mode CPU Graphics Voltage 选项的电压。

#### CPU System Agent Voltage Offset Mode Sign [+]

- [+] 设置正数值偏移电压。
- [ - ] 设置负数值偏移电压。

#### CPU System Agent Voltage Offset [Auto]

本项目用来设置处理器系统代理的电压馈电数量，包括 PCIe 控制器和电源控制元件。提高电压来增强超频能力。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值以 0.001V 为间隔，变更的范围从 0.001V 至 0.999V。

### CPU Analog I/O Voltage Offset Mode Sign [+]

- [+] 设置正数值偏移电压。
- [ - ] 设置负数值偏移电压。

#### CPU Analog I/O Voltage Offset [Auto]

本项目用来设置处理器 I/O 接口类比部份的电压馈电数量。默认值为依照安装的处理器所得的标准数值。提高电压来增强超频能力。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值以 0.001V 为间隔，变更的范围从 0.001V 至 0.999V。

### CPU Digital I/O Voltage Offset Mode Sign [+]

- [+] 设置正数值偏移电压。
- [ - ] 设置负数值偏移电压。

#### CPU Digital I/O Voltage Offset [Auto]

本项目用来设置处理器 I/O 接口数码部分的电压馈电数量。设值为依照安装的处理器所得的标准数值。提高电压来增强超频能力。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值以 0.001V 为间隔，变更的范围从 0.001V 至 0.999V。

### SVID Support [Auto]

当系统超频时将本项目设置为 [Enabled]。关闭 SVID 支持以中断处理器与外接电压调节器的连接。设置值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]



以下项目只有在 SVID Support 设置为 [Auto] 或 [Disabled] 时才会出现。

#### Initial CPU Input Voltage [Auto]

此为提供在 POST (开机自检) 时的 CPU 初始 VCCIN。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值以 0.010V 为间隔，变更的范围从 0.800V 至 2.440V。

#### Eventual CPU Input Voltage [Auto]

此为提供刚载入 CPU 前 CPU 的 VCCIN。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值以 0.010V 为间隔，变更的范围从 0.800V 至 2.440V。

### DRAM Voltage [Auto]

本项目用来设置内存电压。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值以 0.005V 为间隔，变更的范围从 1.20V 至 1.92V。



根据 Intel 处理器规格，内存电压若是超过 1.65V 可能会对处理器造成永久损坏，推荐您安装电压低于 1.65V 的内存以保护处理器。

## PCH Voltage [Auto]

本项目用来设置 PCH (Platform Controller Hub) 电压。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值以 0.0125V 为间隔，变更的范围从 0.70V 至 1.50V。



- CPU PLL Voltage、CPU Manual Voltage、CPU Offset Voltage、iGPU Manual Voltage、iGPU Offset Voltage, DRAM Voltage、VCCSA Voltage、VCCIO Voltage 和 PCH Voltage 将以不同颜色标示，代表高电压设置下的危险程度。
- 系统可能需要一个更佳的冷却系统（如水冷式散热系统）以在高电压设置下维持运作的稳定。

## PCH VLX Voltage [Auto]

本项目用来设置 PCH 的 I/O 电压。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值以 0.0125V 为间隔，变更的范围从 1.2000V 至 2.0000V。

## VTTDDR Voltage [Auto]

本项目用来设置 VTTDDR 电压。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值以 0.0125V 为间隔，变更的范围从 0.6000V 至 1.0000V。

## DRAM CTRL REF Voltage [Auto]

本项目用来设置内存控制参考电压。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值以 0.00500x 为间隔，变更的范围从 0.39500x 至 0.63000x。



若要设置 DRAM 内存参考电压的数值，推荐您设置接近标准值 0.500000x 的数值。

## DRAM DATA REF Voltage on CHA/CHB [Auto]

本项目用来设置在通道 A 与 B 的内存控制参考电压。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值以 0.00500x 为间隔，变更的范围从 0.39500x 至 0.63000x。



若是要设置 DRAM 内存参考电压的数值，推荐您设置接近标准值 0.500000x 的数值。

## CPU Spread Spectrum [Auto]

本项目用来增强 BCLK 超频能力或降低由 BCLK 生成的 EMI 电磁波干扰。设置为 [Enabled] 可以降低 EMI 干扰，设置为 [Disabled] 则可以增强 BCLK 超频能力。设置值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]

## BCLK Recovery [Enabled]

本项目用来还原 BCLK (基本时序) 参数。设置值有：[Enabled] [Disabled] [Ignore]

## 3.5 主菜单 (Main Menu)

当您进入 BIOS 设置程序的高级模式 (Advanced Mode) 时，首先出现的第一个画面即为主菜单。主菜单显示系统信息概要，用来设置系统日期、时间、语言与安全设置。



## 安全性菜单 (Security)

本菜单可以让您改变系统安全设置。



- 若您忘记设置的 BIOS 密码，可以采用清除 CMOS 实时钟（RTC）内存。请参考 1.2.6 主板上的内置开关 一节的说明。
- Administrator 或 User Password 项目默认值为 Not Installed，当您设置密码之后将显示为 [Installed]。

## Administrator Password (设置系统管理员密码)

当您设置系统管理员密码后，推荐您先登入您的帐户，以免 BIOS 设置程序中的某些信息无法查看或变更设置。

请依照以下步骤设置系统管理员密码 (Administrator Password) :

1. 请选择 Administrator Password 项目并按下 <Enter>。
2. 由 Create New Password 窗口输入欲设置的密码，输入完成按下 <Enter>。
3. 请再一次输入密码以确认密码正确。

请依照以下步骤变更系统管理员密码 (Administrator Password) :

1. 请选择 Administrator Password 项目并按下 <Enter>。
2. 由 Enter Current Password 窗口输入密码并按下 <Enter>。
3. 由 Create New Password 窗口输入新密码，输入完成按下 <Enter>。
4. 请再一次输入密码以确认密码正确。

欲删除系统管理员密码时，请依照变更系统管理员密码之步骤，但请在输入/确认密码窗口出现时，按下 <Enter> 键。当您删除系统管理员密码后，Administrator Password 项目将显示为 Not Installed。

## User Password (设置用户密码)

当您设置用户密码后，你必需登入您的帐户才能使用 BIOS 设置程序。用户密码的默认值为 Not Installed，当您设置密码后将显示 Installed。

请依照以下步骤设置用户密码 (User Password) :

1. 请选择 User Password 项目并按下 <Enter>。
2. 由 Create New Password 窗口输入欲设置的密码，输入完成按下 <Enter>。
3. 请再一次输入密码以确认密码正确。

请依照以下步骤变更用户密码 (User Password) :

1. 请选择 User Password 项目并按下 <Enter>。
2. 由 Enter Current Password 窗口输入密码并按下 <Enter>。
3. 由 Create New Password 窗口输入新密码，输入完成按下 <Enter>。
4. 请再一次输入密码以确认密码正确。

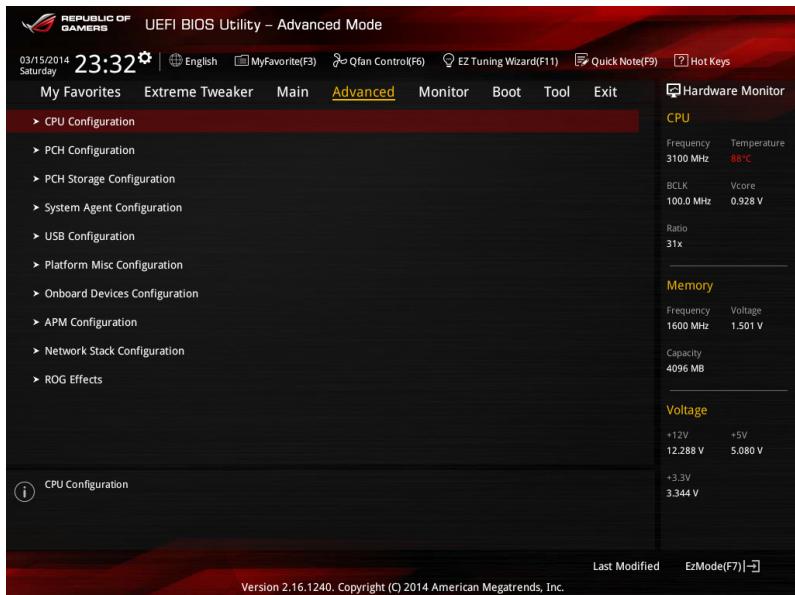
欲删除用户密码时，请依照变更用户密码之步骤，但请在输入/确认密码窗口出现时，按下 <Enter> 键。当您删除用户密码后，User Password 项目将显示为 Not Installed。

### 3.6 高级菜单 (Advanced menu)

高级菜单可让您改变中央处理器与其他系统设备的细部设置。



注意！在您设置本高级菜单的设置时，不正确的数值将导致系统损毁。

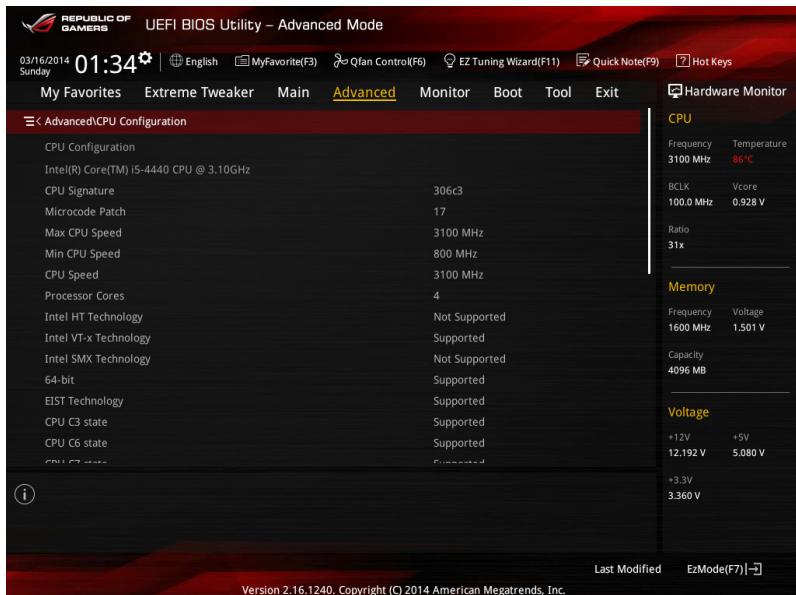


### 3.6.1 处理器设置 (CPU Configuration)

本项目可让您得知中央处理器的各项信息与变更中央处理器的相关设置。



以下画面所显示项目可能会因您所安装处理器不同而有所差异。



#### Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

[Enabled] 启动 CPU 散热监控功能帮助散热。

[Disabled] 关闭 CPU 散热监控功能。

#### Active Processor Cores [All]

本项可以让您设置在每个处理封包中启用的处理器核心数量。设置值有：[All] [1] [2] [3]

#### Limit CPUID Maximum [Disabled]

[Disabled] 关闭此功能。

[Enabled] 本项目可以让系统无处理器 CPUID 功能支持时亦可正常启动。

### **Execute Disable Bit [Enabled]**

[Enabled] 启动 No-Execution Page Protection 技术。

[Disabled] 强迫 XD 功能总是降低至 0。

### **Intel® Virtualization Technology [Disabled]**

[Enabled] 启动 Intel 虚拟技术 (Virtualization Technology) 让硬件平台可以同时运行多个操作系统，将一个系统平台虚拟为多个系统。

[Disabled] 关闭此功能。

### **Hardware Prefetcher(L2 Cache) [Enabled]**

[Enabled] 本项目可以让硬件平台独立和同步运作多重操作系统。

[Disabled] 关闭此功能。

### **Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]**

[Enabled] 本项目可以让硬件平台运行 Adjacent Cache Line Prefetch 功能。

[Disabled] 关闭此功能。

### **Boot Performance Mode [Max Non-Tu...]**

本项目用来让您在操作系统切换前选择 BIOS 设置的性能状态。设置值有：[Max Non-Turbo Performance] [Max Battery] [Turbo Performance]

### **Dynamic Storage Accelerator [Disabled]**

本项目提供通过加速固态硬盘 (SSD) 性能的多重动态存储电源调整功能。设置值有：[Enabled] [Disabled]

### **CPU Power Management Configuration**

本项目用来管理与设置 CPU 电力。

#### **Enhanced Intel SpeedStep Technology [Enabled]**

本项为启动或关闭 Intel EIST 技术 (Enhanced Intel® SpeedStep Technology)。

[Disabled] 处理器会以默认速度运作。

[Enabled] 处理器的速度则由操作系统控制。

#### **Turbo Mode [Enabled]**

本项目用来设置处理器在特定情况下以比标示频率更快的速度运作。设置值有：[Enabled] [Disabled]

#### **CPU C States [Auto]**

本项可让您启动或关闭 CPU C states。设置值有：[Auto] [Enabled] [Disabled]



以下项目只有在 CPU C States 设置为 [Enabled] 时才会出现。

**Enhanced C1 state [Enabled]**

本项目可以让处理器在闲置时降低电力消耗。

设置值有 : [Enabled] [Disabled]

**CPU C3 Report [Enabled]**

本项目可以让您启动或关闭 CPU C3 报告给操作系统。

设置值有 : [Enabled] [Disabled]

**CPU C6 Report [Enabled]**

本项目可以让您启动或关闭 CPU C6 报告给操作系统。

设置值有 : [Enabled] [Disabled]

**C6 Latency [Short]**

本项可以让您设置 C6 state 的 C6 延迟期间。设置值有 : [Short] [Long]

**CPU C7 Report [CPU C7s]**

本项目可以让您启动或关闭 CPU C7 报告给操作系统。

设置值有 : [Disabled] [CPU C7] [CPU C7s]

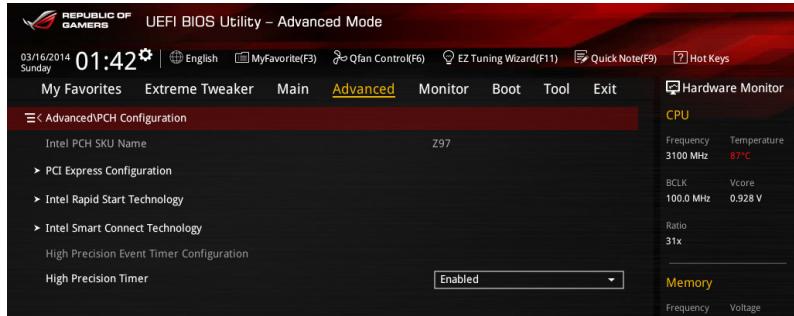
**C7 Latency [Long]**

本项可以让您设置 C7 state 的 C7 延迟期间。设置值有 : [Short] [Long]

**Package C State Support [Auto]**

本项目用来启动或关闭 CPU C State 支持功能。设置值有 : [Auto] [Enabled]  
[C0/C1] [C2] [C3] [C6] [CPU C7] [CPU C7s]

### 3.6.2 PCH 设置 (PCH Configuration)



#### PCI Express Configuration

本项目用来管理与设置 PCI Express 插槽。

##### PCIe Speed [Auto]

本项目用来让系统自动选择 PCI Express 接口速度。设置为 [Gen1] 时，PCI-E 接口会以 PCI-E 1.0 速度运作。设置为 [Gen2] 时，PCI-E 接口会以 PCI-E 2.0 速度运作。设置值有：[Auto] [Gen1] [Gen2]

##### Intel Rapid Start Technology [Disabled]

本项目用来启动或关闭 Intel® Rapid Start Technology 功能。设置值有：[Enabled] [Disabled]。



以下项目只有在 Intel Rapid Start Technology 设置为 [Enabled] 时才会出现。

##### Entry on S3 RTC Wake [Enabled]

系统自动唤醒并设置为 Rapid Start Technology S3 模式。设置值有：[Enabled] [Disable]

##### Entry After [0]

本项目用来设置系统的实时钟 (RTC) 唤醒功能为 S3 模式。设置值范围从 0 分钟 (立即) 至 120 分钟。

##### Active Page Threshold Support [Enabled]

当磁盘容量不敷 Intel® Rapid Start Technology 使用时，系统自动进入睡眠模式。设置值有：[Enabled] [Disabled]

##### Active Memory Threshold [0]

当磁盘容量超过 Active Page Threshold 容量时，本项目支持 Intel Rapid Storage Technology。若设置为 0，会进入 Auto 模式并检查磁盘容量是否足够 S3 模式使用。

Hybrid Hard Disk Support [Disabled]

本项目用来启动或关闭混合磁盘功能。设置值有：[Enabled] [Disabled]

## Intel Smart Connect Technology [Disabled]

本项目用来让系统支持 Intel Smart Connect Technology，当系统进入睡眠模式时会定期更新选定的应用程序。设置值有：[Enabled] [Disabled]

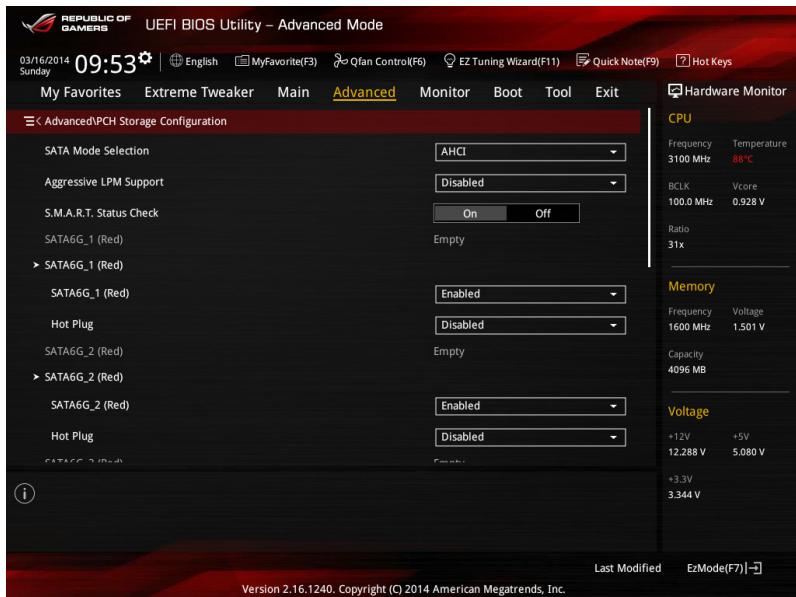
## High Precision Time [Enabled]

启用或关闭 High Precision Event Timer 功能。设置值有：[Enabled] [Disabled]

## 3.6.3 PCH 存储设备设置 (PCH Storage Configuration)

当您进入 BIOS 设置程序时，BIOS 设置程序将自动检测已安装的 SATA 设备。当未侦测到 SATA 设备时将显示 Not Present。

将滚动条往下滚动来显示以下项目。



## SATA Mode Selection [AHCI]

本项目可设置 Serial ATA 硬件设备的相关设置。

[Disabled] 关闭 SATA 功能。

[IDE] 若要将 Serial ATA 作为 Parallel ATA 实体存储接口，请将本项目设置为 [IDE]。

[AHCI] 若要 Serial ATA 硬件设备使用 Advanced Host Controller Interface (AHCI) 模式，请将本项目设置为 [AHCI]。AHCI 模式可让内置的存储设备启动高级的 Serial ATA 功能，通过原生命令排序技术来提升工作性能。

[RAID] 若要在 Serial ATA 硬盘设置 RAID 磁盘数组，请将本项目设置为 [RAID]。



---

以下的项目只当 SATA Mode Selection 设置为 [RAID] 时才会显示。

---

### Alternate ID [Disabled]

本项目为启用或关闭 alternate ID 回报功能。设置值有 : [Disabled] [Enabled]

## Aggressive LPM Support [Auto]

本项为启动 PCH 强制进入链接电源状态。设置值有 : [Auto] [Disabled] [Enabled]

## S.M.A.R.T. Status Check [On]

S.M.A.R.T. ( 自动检测、分析、报告技术 , Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology ) 是一个监控软件，可以监控您的硬盘，并在发生错误时于开机自检 ( POST ) 时显示错误信息。设置值有 : [On] [Off] 。

## SATA6G\_1(Red) - SATA6G\_6(Red)

按下 <Enter> 键可以将 SATA 接口更名。

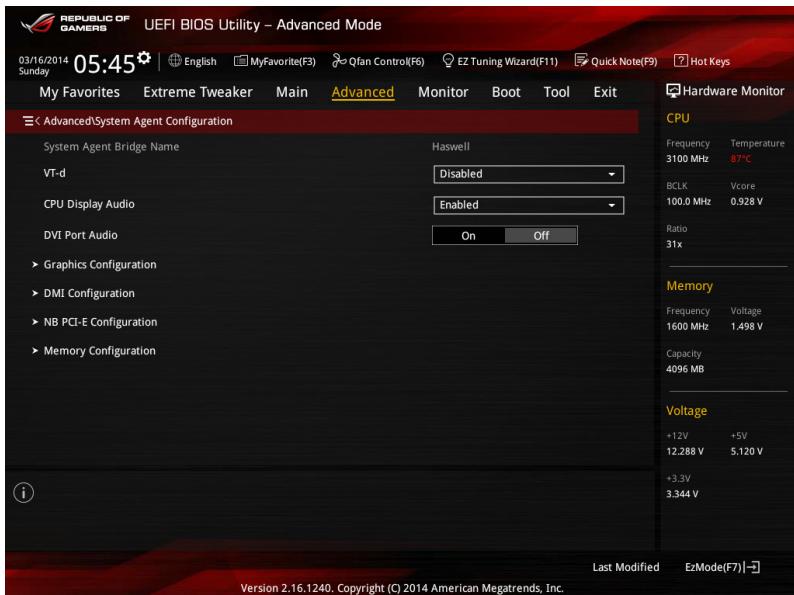
### SATA6G\_1(Red) - SATA6G\_6(Red) [Enabled]

本项目提供您启用或关闭被选择的 SATA 接口。设置值有 : [Disabled] [Enabled]

### Hot Plug [Disabled]

这些项目只当 SATA Mode Section 设置为 [AHCI] 时才会显示，并且提供您启用或关闭支持 SATA Hot Plug ( 热插拔 ) 功能。设置值有 : [Disabled] [Enabled]

### 3.6.4 系统代理设置 (System Agent Configuration)



#### VT-d [Disabled]

提供启用内存集线器虚拟化技术功能。

[Enabled] 启用本项功能。

[Disabled] 关闭本项功能。

#### CPU Display Audio [Enabled]

启用或关闭 CPU 显示音频支持功能。设置值有 : [Enabled] [Disabled]

#### DVI Port Audio [Enabled]

启用本项功能可以支持某些 DVI 显示器的音频输出。按下 <Enter> 键可以切换为打开 (On) 或关闭 (Off)。设置值有 : [On] [Off]

#### Graphics Configuration

本项目用来选择以 iGPU 或 PCIe 显示设备作为优先使用的显示设备。

##### Primary Display [Auto]

- |                |                        |
|----------------|------------------------|
| [Auto]         | 当检测到 PCI-E 显卡，则设为主要显示。 |
| [CPU Graphics] | 强制以 CPU 内置显示为主要显示。     |
| [PCIe]         | 强制以 PCI-E 显卡为主要显示。     |

#### CPU Graphics Memory [Auto]

允许您选择系统内存分配至 DVMT 5.0 的 CPU 图形显示使用量。设置值有：  
[Auto] [32M] [64M] [96M] [128M] [160M] [192M] [224M] [256M] [288M]  
[320M] [352M] [384M] [416M] [448M] [480M] [512M]

#### Render Standby [Auto]

本项目用来启动 Intel® Graphics Render Standby 功能来支持系统闲置时降低 iGPU 电力的消耗。设置值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]

#### CPU Graphics Multi-Monitor [Disabled]

本项目用来启动 iGPU 多重显示功能。iGPU 共享系统内存固定为 64MB。设置值有：[Disabled] [Enabled]

### DMI Configuration

本项目用来设置 DMI (Direct Media Interface) 以 PCI-E 2.0 速度运作。

#### DMI Gen 2 [Auto]

设置为 [Enabled] 时，DMI 会以 PCI-E 2.0 速度运作。设置值有：[Enabled]  
[Disabled]

### NB PCI-E Configuration

本项目用来设置 NB PCI Express 设置值。

#### PCIEx16\_1/2 Link Speed [Auto]

本项目用来设置插槽 1 和 2 以 PCIEx16 速度运作。

[Auto] 系统会自动选择 PCI-E ×16 接口的速度。

[Gen1] PCI-EX16 接口会以 PCI-E 1.0 速度运作。

[Gen2] PCI-EX16 接口会以 PCI-E 2.0 速度运作。

[Gen3] PCI-EX16 接口会以 PCI-E 3.0 速度运作。

### Memory Configuration

本项目用来设置内存设置参数。

#### Memory Scrambler [Enabled]

本项目用来启动或关闭 Memory Scrambler 支持。

设置值有：[Enabled] [Disabled]

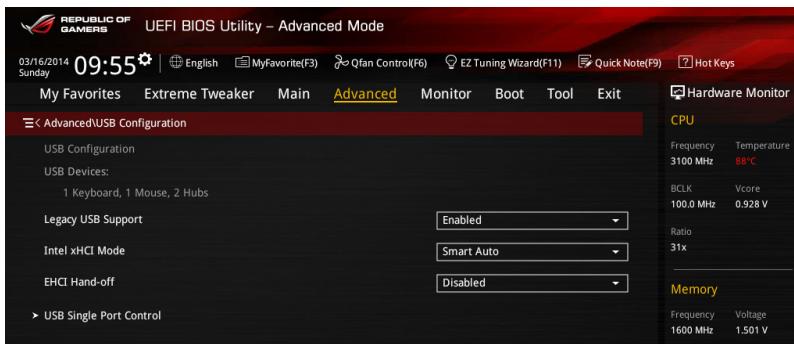
#### Memory Remap [Enabled]

本项目用来启动指派内存大于 4GB。

设置值有：[Enabled] [Disabled]

### 3.6.5 USB 设备设置 (USB Configuration)

本菜单可以让您变更 USB 设备的各项相关设置。



在 USB Devices 项目中会显示自动检测到的数值或设备。若无连接任何设备，则会显示 None。

#### Legacy USB Support [Enabled]

- [Enabled] 启动在常规操作系统中支持 USB 设备功能。
- [Disabled] USB 设备只能在 BIOS 程序设置中使用，无法在启动设备列表中被检测到。
- [Auto] 系统可以在启动时便自动检测是否有 USB 设备存在，若是，则启动 USB 控制器。

#### Intel xHCI Mode [Smart Auto]

- [Auto] 当操作系统安装有 xHCI 驱动程序，xHCI 会自动启动并以 USB 3.0 模式运作。
- [Smart Auto] xHCI 驱动程序在系统自我检测（POST）过程中与操作系统中都支持 USB 3.0 模式。
- [Enabled] 启动 xHCI 控制器。
- [Disabled] 关闭 xHCI 控制器。

#### EHCI Hand-off [Disabled]



本项目默认为 [Disabled] 以供 EHCI (Enhanced host controller interface) 在操作系统底下的 EHCI 设备支持。

- [Disabled] 支持在操作系统底下具备支持 EHCI 设备的 EHCI。
- [Enabled] 在 BIOS 中启用支持没有 EHCI 功能的操作系统。

#### USB Single Port Control

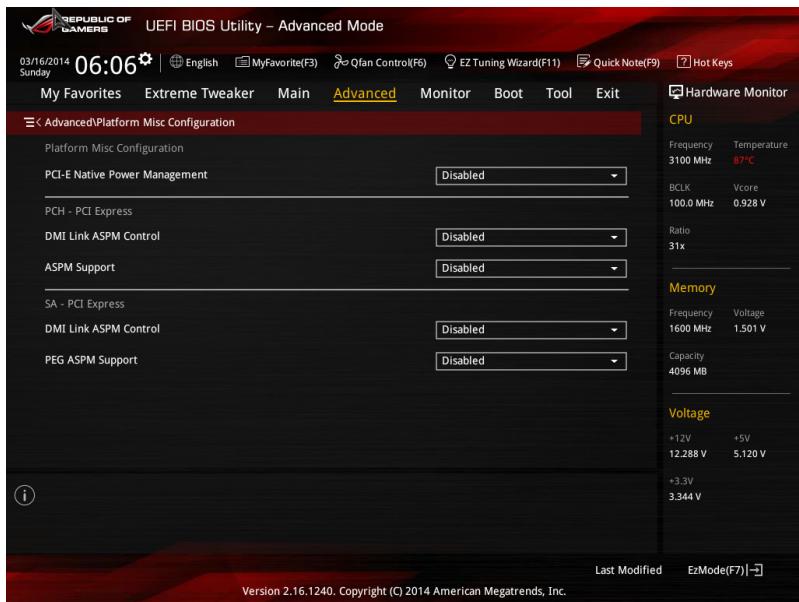
本项目用来启动或关闭个别 USB 接口。



USB 接口的位置请参考 主板结构图 的说明。

### 3.6.6 平台各项设置 (Platform Misc Configuration)

本菜单可让您变更平台相关的各项设置。



#### PCI-E Native Power Management [Disabled]

本项目用来设置 PCI-E 的省电功能。

设置值有 : [Disabled] [Enabled]



以下项目只有在 PCI Express Native Power Management 设置为 [Enabled] 时才会出现。

##### Native ASPM [Disabled]

启用本项目在 Windows Vista 操作系统环境，可以控制设备的 ASPM ( Active State Power Management ) 支持。

- [Enabled] 由 Vista 控制设备的 ASPM 支持。  
[Disabled] 由 BIOS 控制设备的 ASPM 支持。

#### PCH - PCI Express 选项

##### DMI Link ASPM Control [Disabled]

本项目为设置 DMI Link 上北桥与南桥的 ASPM ( Active State Power Management ) 功能。设置值有 : [Enabled] [Disabled]

##### ASPM Support [Disabled]

本项目用来选择 ASPM state 的节能状态。设置值有 : [Disabled] [L0s] [L1] [L0sL1] [Auto]

## SA - PCI Express 选项

### DMI Link ASPM Control [Disabled]

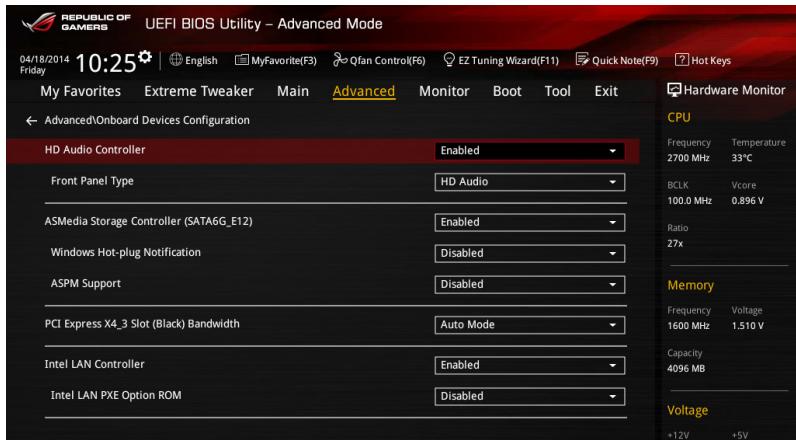
启用 PCH 端的 ASPM 以支持节能。设置值有：[Disabled] [L0s] [L1] [L0sL1]

### PEG ASPM Support [Disabled]

本项目用来选择 ASPM state 的节能状态。设置值有：[Disabled] [L0s] [L1] [L0sL1] [Auto]

## 3.6.7 内置设备设置 (OnBoard Devices Configuration)

往下滚动可以看到更多的 BIOS 项目。



### HD Audio Controller [Enabled]

[Enabled] 启动高保真音频控制器。

[Disabled] 关闭这个控制器。



以下选项只有在 HD Audio Controller 设置为 [Enabled] 时才会出现。

#### Front Panel Type [HD Audio]

[HD Audio] 将前面板音频接口 (AAFP) 模式设置为高保真音频。

[AC97] 将前面板音频接口 (AAFP) 模式设置为 legacy AC' 97。

#### SPDIF Out Type [SPDIF]

[SPDIF] 设置为 SPDIF 输出。

[HDMI] 设置为 HDMI 输出。

### ASMedia Storage Controller (SATA6G\_E12) [Enabled]

提供您选择 ASMedia 存储控制器的运作模式。

[Disabled] 关闭 ASMedia 存储控制器。

[Enabled] 启用 ASMedia 存储控制器。

### Windows Hot-plug Notification [Disabled]

在 Windows 操作系统下提供您设置热插拔通知。设置值有：[Disabled] [Enabled]

### PCI-EX4\_3 Slot (black) Bandwidth [Enabled]

[Auto Mode] 在自动模式下有两种情况：

1. 默认状态下，当所有插槽启用且 M.2 插槽关闭时，PCIeX4\_3 插槽采 X1 模式运作。此默认状况会发生在 PCIeX4\_3 插槽无安装任何扩展卡上。
2. 当于 PCIeX4\_3 插槽上安装扩展卡时，这个插槽会采 X4 模式以支持较高性能。PCIeX1\_1~3 与 M.2 (Socket 3) 插槽则会关闭。

[PCIe X1 Mode] 在 PCIe X1 模式，所有插槽启用，则 PCIeX4\_3 会采 X1 模式运作。M.2 插槽则关闭。

[M.2 Mode] 在 M.2 模式，PCIeX4\_3 插槽采 X2 模式，以及 M.2 插槽启用时，PCIeX1\_1~3 插槽则会关闭。

[PCIe X4 Mode] 在 PCIe X4 模式，PCIeX4\_3 插槽采 X4 模式以支持较高的性能。PCIeX1\_1~3 与 M.2 插槽则会关闭。

### Intel LAN Controller [Enabled]

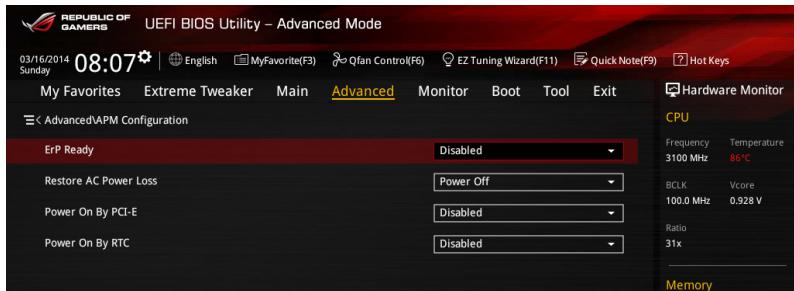
[Enabled] 启动 Intel LAN 网络控制器。

[Disabled] 关闭此控制器。

### Intel LAN PXE OPROM [Disabled]

本项目只当 Intel LAN Control 设置为 [Enabled] 时才会显示，可以让您开启或关闭 Intel 网络控制器的 PXE Option Rom (PXE 随选只读内存)。设置值有：  
[Enabled] [Disabled]

### 3.6.8 高级电源管理设置 (APM Configuration)



#### ErP Ready [Disabled]

在 S5 休眠模式下关闭某些电源，减少待机模式下电力的流失，以符合欧盟能源使用产品 (Energy Related Product) 的规范。网络唤醒功能 (WOL)、USB 唤醒功能、音频，及主板上 LED 指示灯的电源将会关闭，您可能无法使用网络功能、USB 唤醒功能及音频提醒等。设置值有：[Disabled] [Enabled (S4+S5)] [Enabled (S5)]

#### Restore AC Power Loss [Power Off]

- [Power On] 系统在电源中断之后重新开启。
- [Power Off] 系统在电源中断之后电源将维持关闭状态。
- [Last State] 将系统设置恢复到电源未中断之前的状态。

#### Power On By PS/2 Keyboard [Disabled]

- [Disabled] 关闭使用 PS/2 键盘启动功能。
- [Space Bar] 启动使用 PS/2 键盘上的空白键启动功能。
- [Ctrl-Esc] 启动使用 PS/2 键盘上的 Ctrl 及 Esc 键启动之功能。
- [Power Key] 启动使用 PS/2 键盘上的电源键启动之功能。要使用本功能，ATX 电源 (PSU) 必须可以提供至少 1 安培的电流及 +5VSB 的电压。

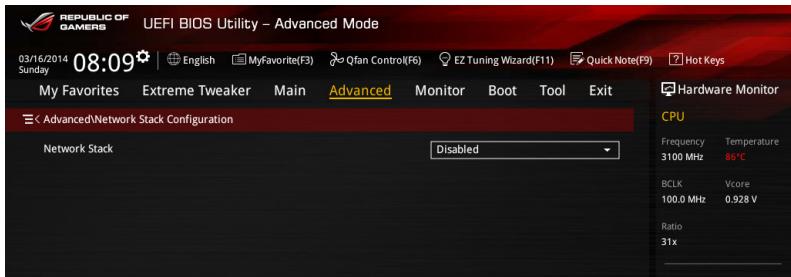
#### Power On By PCI-E [Disabled]

- [Disabled] 关闭通过 Intel/Realtek 网络设备或其他已安装的 PCIE 网卡进行 PCIE/PCI 设备的唤醒功能。
- [Enabled] 启动通过 Intel/Realtek 网络设备或其他已安装的 PCIE 网卡进行 PCIE/PCI 设备的唤醒功能。

#### Power On By RTC [Disabled]

- [Disabled] 关闭实时时钟 (RTC) 唤醒功能。
- [Enabled] 当您设为 [Enabled] 时，将出现 RTC Alarm Date、RTC Alarm Hour、RTC Alarm Minute 与 RTC Alarm Second 子项目，您可自行设置时间让系统自动启动。

### 3.6.9 网络协议堆栈 (Network Stack)



#### Network Stack [Disable Link]

本项目用来启动或关闭 UEFI 网络协议堆栈 (network stack) 功能。设置值有：  
[Disable Link] [Enable]



以下的项目只当您将 Network Stack 设置为 [Enabled] 时，才会显示。

##### Ipv4 PXE Support [Enable]

本项目为启用或关闭 Ipv4 PXE 支持功能。设置值有：[Disable Link] [Enabled]

##### Ipv6 PXE Support [Enable]

本项目为启用或关闭 Ipv6 PXE 支持功能。设置值有：[Disable Link] [Enabled]

### 3.6.10 ROG Effects



#### Onboard LED [Enabled]

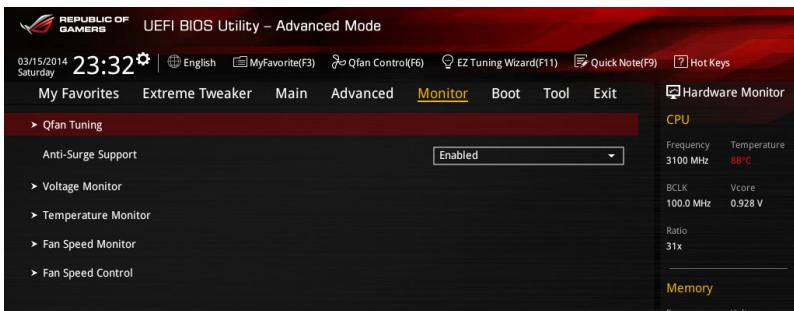
本项目提供您启用或关闭主板内置的指示灯。设置值有：[Disable Link] [Enable]

#### SupremeFX Lighting LED [Enabled]

本项目提供可以将红线 LED 灯与 SupremeFX 图标的 LED 灯开启或关闭。设置值有：[Enabled] [Disabled]

## 3.7 监控菜单 (Monitor menu)

监控菜单可让您查看系统温度/电力状况，并且对风扇做高级设置。



### Qfan Tuning

点击本项目会自动检测最低速度并设置每个风扇的最小工作周期。

#### Anti Surge Support [Enabled]

本项为启用过电压保护 (OVP) 与低电压保护 (UVP) 功能。设置值有：[Disabled] [Enabled]

### Voltage Monitor

CPU Core 0-3 Voltage; CPU Cache Voltage; CPU System Agent Voltage;  
CPU Analog I/O Voltage; CPU Digital I/O Voltage; CPU Input Voltage; DRAM  
Voltage; PCH Voltage; 3.3V Voltage; 5V Voltage; 12V Voltage

这些内置的硬件监控功能，会自动检测经由内置电压调节所输出的电压值。如果风扇并未连接至主板，本项目会显示 N/A。若是您不想显示检测这个项目，请按下 <Enter> 键并选择 [Ignore]。

### Temperature Monitor

CPU Temperature; MB Temperature; SENSOR1 Temperature [xxx°C/xxx°F]

本系列主板具备了中央处理器、主板的温度探测器，可自动检测并显示当前的温度。若您不想要显示检测的温度，请按下 <Enter> 键并选择 [Ignore]。

### Fan Speed Monitor

CPU FAN Speed; CPU Optional Fan Speed; Chassis FAN 1-4 Speed

为了避免系统因为过热而造成损坏，本系列主板备有中央处理器风扇的转速 RPM (Rotations Per Minute) 监控，所有的风扇都设置了转速安全范围，一旦风扇转速低于安全范围，华硕智能型主板就会发出警讯，通知用户注意。若没有安装至主板，则会显示 [N/A]。若您不想显示该项检测的温度值，请按下 <Enter> 键并选择 [Ignore]。

## Fan Speed Control

### CPU Q-Fan Control [Auto]

本项目用来设置 CPU Q-Fan 运作模式。

- [Auto] 检测安装的处理器风扇类型并自动切换控制模式。
- [PWM Mode] 在 PWM 模式启动 CPU Q-Fan 控制来使用 4-pin 处理器风扇。
- [DC Mode] 当安装 3-pin 的处理器风扇时，请选择本项目来使用 Q-Fan 控制的 DC 模式。
- [Disabled] 关闭 CPU Q-Fan 控制功能。



---

以下的项目只有在 CPU Q-Fan Control 设为 [Auto] 时才会出现。

---

### CPU Fan Speed Low Limit [300 RPM]

本项目可以让您设置当 CPU 风扇低于所选择的转速时，系统会发送警告信息通知。设置值有：[Ignore] [200 RPM] [300 RPM] [400 RPM] [500 RPM] [600 RPM]

### CPU Fan Profile [Standard]

本项目只有在 CPU Q-Fan Control 设置为 [Enabled] 时才会出现，用来设置处理器风扇适当的性能。

- [Standard] 设置为 [Standard] 让处理器风扇根据处理器的温度自动调整。
- [Silent] 设置为 [Silent] 将风扇速度调整到最低，并拥有最安静的运行环境。
- [Turbo] 设置为 [Turbo] 来获得处理器风扇的最大转速。
- [Manual] 设置为 [Manual] 来指派详细的风扇转速控制参数。



---

以下的项目只有当您将 CPU Fan Profile 设为 [Manual] 时才会出现。

---

### CPU Upper Temperature [70]

使用 <+> 与 <-> 键调整处理器温度的最大值。数值的变更范围由 20°C 至 75°C。

### CPU Fan Max. Duty Cycle(%) [100]

使用 <+> 与 <-> 键调整处理器风扇的最大工作周期。数值的变更范围由 20% 至 100%。当处理器温度超过预定的设置值时，CPU 风扇会以最大工作周期运转。

### CPU Middle Temperature [45]

使用 <+> 与 <-> 键设置处理器的中间温度，数值范围依安装的处理器而异。

### CPU Fan Middle Duty Cycle(%) [60]

使用 <+> 与 <-> 键调整处理器风扇的中间工作周期。数值的变更范围由 20% 至 100%。当处理器温度超大于检测的设置值时，CPU 风扇会以最大转速散热。

### CPU Lower Temperature [40]

显示处理器温度的最小值。

### CPU Fan Min. Duty Cycle(%) [20]

使用 <+> 与 <-> 键调整处理器风扇的最小工作周期。数值的变更范围由 0% 至 100%。当处理器温度低于 40°C 时，CPU 风扇会以最小工作周期运转。

### Chassis Fan 1/2/3/4 Q-Fan Control [DC Mode]

- [Disabled] 关闭 Chassis Q-Fan 控制功能。
- [DC mode] 启用 chassis Q-Fan 功能采 DC 模式以供 3-pin 机箱风扇使用。
- [PWM mode] 启用 chassis Q-Fan 功能采 PWM 模式以供 4-pin 机箱风扇使用。

### Chassis Fan 1/2/3/4 Q-Fan Source [CPU]

本项目用来根据选择的温度来源控制指派的风扇。设置值有：[CPU] [MB] [T\_SENSOR1]



若选择 T\_SENSOR1，请将热敏电阻排线插在 T\_SENSOR1 接口，并将热敏电阻排线接口贴在温度来源的元件上。

### Chassis Fan 1/2/3/4 Fan Speed Low Limit [300 RPM]

本项目只有在 Chassis Q-Fan Control 设置为 [Enabled] 时才会出现。本项目可以让您设置 CPU Q-Fan Control 的功能及机箱风扇速度。设置值有：[Ignore] [200 RPM] [300 RPM] [400 RPM] [500 RPM] [600 RPM]



以下项目只有当您将 Chassis Fan 1/2/3/4 Q-Fan Control 设为 [Enabled] 时才会出现。

### Chassis1/Chassis2/Chassis3/Chassis4 Fan Profile [Standard]

本项目只有在 Chassis Q-Fan Control 设置为 [Enabled] 时才会出现，用来设置机箱风扇适当的性能。

- [Standard] 设置为 [Standard] 让机箱风扇根据处理器的温度自动调整。
- [Silent] 设置为 [Silent] 将风扇速度调整到最低，并拥有最安静的运行环境。
- [Turbo] 设置为 [Turbo] 来获得机箱风扇的最大转速。
- [Manual] 设置为 [Manual] 来指派详细的风扇转速控制参数。



以下的项目只有当您将 Chassis1/Chassis2/Chassis3/Chassis4 Fan Profile 设为 [Manual] 时才会出现。

### Chassis Fan 1/2/3/4 Upper Temperature [70]

请使用 <+> 与 <-> 键调整机箱温度的数值。数值的变更范围由 20°C 至 75°C。

### Chassis Fan 1/2/3/4 Max. Duty Cycle(%) [100]

请使用 <+> 与 <-> 键调整机箱风扇的最大工作周期。数值的变更范围由 20% 至 100%。当机箱温度达最大值时，机箱风扇将以最大工作周期运作。

### Chassis Fan 1/2/3/4 Middle Temperature [45]

显示机箱温度的中间工作周期。

### Chassis Fan 1/2/3/4 Middle Duty Cycle(%) [60]

请使用 <+> 与 <-> 键调整机箱风扇的最小工作周期。数值的变更范围由 20% 至 100%。当机箱温度低于 40°C 时，机箱风扇将以最小工作周期运作。

Chassis Fan 1/2/3/4 Lower Temperature [40]

显示机箱风扇温度的最小值。

Chassis Fan 1/2/3/4 Min. Duty Cycle(%) [60]

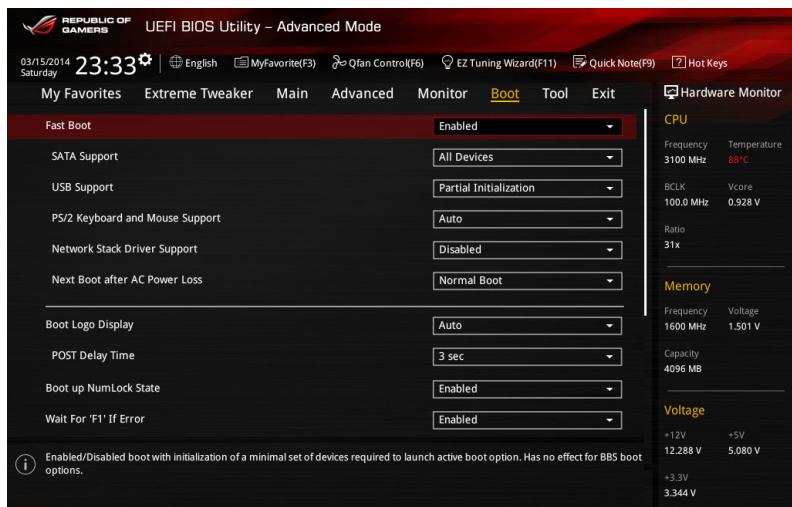
使用 <+> 与 <-> 键调整机箱风扇的最小工作周期。数值的变更范围由 60% 至 100%。当机箱温度低于 40°C 时，机箱风扇会以最小工作周期运转。

### Allow Fan Stop [Disabled]

本项目用来让您的风扇在来源温度掉到最低温以下时可以 0% 工作周期运作。设置值有：[Disabled] [Enabled]。

## 3.8 启动菜单 (Boot menu)

本菜单可让您改变系统启动设备与相关功能。



### Fast Boot [Enabled]

- [Disabled] 系统返回正常启动速度。  
[Enabled] 加速系统启动速度。



以下的项目只有在 Fast Boot 设置为 [Enabled] 时才会出现。

### SATA Support [All Devices]

- [All Device] 所有连接至 SATA 接口的设备在开机自检 (POST) 过程中可以使用。  
[Hard Drive Only] 只有连接至 SATA 接口的硬盘设备在开机自检 (POST) 过程中可以使用。  
[Boot Drive Only] 只有连接至 SATA 接口的启动设备在开机自检 (POST) 过程中可以使用。

### USB Support [Partial Initialization]

- [Disabled] 所有 USB 设备直到操作系统开启后才可使用。  
[Full Initialization] 所有 USB 设备在操作系统环境及 POST 时均可使用。  
[Partial Initialization] 在操作系统开启前只可使用 USB 键盘与鼠标。

### PS/2 Keyboard and Mouse Support [Auto]

提供您关闭或在 POST (开机自检) 过程中可以完整控制 PS/2 设备。

### Network Stack Driver Support [Disabled]

- [Disabled] 在 POST 时略过载入网络协议堆栈驱动器。  
[Enabled] 在 POST 时载入网络协议堆栈驱动器。

### Next Boot after AC Power Loss [Normal Boot]

- [Normal Boot] 在电源中断后恢复至正常启动速度。  
[Fast Boot] 在电源中断后加快启动速度。

## Boot Logo Display [Auto]

- [Disabled] 关闭全屏幕个人化启动画面功能。  
[Enabled] 启动全屏幕个人化启动画面功能。



以下的项目只当 Boot Logo Display 设置为 [Disabled] 时才会显示。

### Post Report [5 sec]

本项目可让您选择想要的 POST 回报等候时间，数值的范围为从 0 至 10 秒，或直到按下 <ESC> 键。



以下的项目只当 Boot Logo Display 设置为 [Auto] 或 [Full Screen] 时才会显示。

### Post Delay Time [3 sec]

本项目允许您选择所需的额外等候 POST 时间，让您轻松进入 BIOS 设置画面。在正常启动时，只能运行 POST 延迟时间。数值的变更范围为 0 至 10 秒。



本功能只支持正常启动时使用。

## Bootup NumLock State [Enabled]

- [Enabled] 设置启动时 NumLock 键自动开启 [On]。  
[Disabled] 设置启动时 NumLock 键自动关闭 [Off]。

## Wait For 'F1' If Error [Enabled]

- [Disabled] 关闭本功能。  
[Enabled] 系统在启动过程出现错误信息时，将会等待您按下 <F1> 键确认才会继续进行启动程序。

## Option ROM Messages [Force BIOS]

- [Force BIOS] 选购设备固件程序信息会强制在启动显示。  
[Keep Current] 选购设备固件程序信息只有在该程序供应商设置为显示时，才会在启动时显示。

## Interrupt 19 Capture [Disabled]

本项目用来使用随选内存（ROM）限制中断 19。设置值有：[Disabled] [Enabled]

## Above 4G Decoding [Disabled]

本项用来让您在 4G 地址空间上解码 64 位设备。设置值有：[Disabled] [Enabled]

## Setup Mode [Advanced Mode]

- [Advanced Mode] 将 Advanced Mode 设置为 BIOS 设置程序的默认值。  
[EZ Mode] 将 EZ Mode 设置为 BIOS 设置程序的默认值。

## CSM (Compatibility Support Module)

本项目用来设置 CSM 项目以增加对 VGA、启动设备和其他设备的兼容性。

### Launch CSM [Enabled]

- [Auto] 系统将自动检测启动设备和其他设备。
- [Enabled] 启动 CSM 以支持 non-UEFI 设备或 Windows® UEFI 模式。
- [Disabled] 关闭此功能。



以下的项目只有当您将 Launch CSM 设为 [Enabled] 时才会出现。

### Boot Devices Control [UEFI and Legacy OPROM]

本项目用来设置启动设备的类型。设置值有：[UEFI and Legacy OpROM] [Legacy OpROM only] [UEFI only]

### Boot from Network Devices [Legacy OPROM first]

本项目用来设置想要运行的网络设备。设置值有：[Legacy OpROM first] [UEFI driver first] [Ignore]

### Boot from Storage Devices [Legacy OPROM first]

本项目用来设置想要运行的存储设备。设置值有：[Both, Legacy OpROM first] [Both, UEFI first] [Legacy OpROM first] [UEFI driver first] [Ignore]

### Boot from PCI-E/PCI Expansion Devices [Legacy OPROM first]

本项目用来设置想要运行的 PCIe/PCI 扩展设备。设置值有：[Legacy OpROM first] [UEFI driver first]

## Secure Boot

本项目用来设置 Windows® 安全启动的相关参数以及管理系统金钥，以提升系统在开机自检（POST）时的安全性，避免受到未授权的用户与恶意软件的危害。

### OS Type [Windows UEFI mode]

- [Windows UEFI Mode] 本项目用来选择安装的操作系统。运行 Microsoft® 安全启动检查。只有在 Windows® UEFI 模式或其他 Microsoft® 安全启动兼容操作系统中启动时选择此项目。

- [Other OS] 在 Windows® 非 UEFI 模式中启动时获得最佳功能。Microsoft® 安全启动功能只可在 Windows® UEFI 模式下正确运行。

### Key Management

本项目可以让您管理安全启动的金钥。

#### Clear Secure Boot keys

本项目只有在载入默认的安全启动金钥时才会出现。用来让您清除所有默认的安全启动金钥。

## Save Secure Boot Keys

本项目用来将 PK (Platform Keys) 存储至 USB 存储设备。

### *PK Management*

Platform Key (PK) 锁定并保护固件遭到未授权的变更。在进入操作系统前将需先验证 PK。

#### Delete PK

本项用来删除系统中的 PK，当 PK 删除后即无法使用 Secure Boot 金钥。设置值有：[Yes] [No]。

#### Load PK from File

本项目用来设置由 USB 存储设备载入 PK。



PK 文件必须格式化为一个基于时间认证变量的 UEFI 变量结构。

### *KEK Management*

KEK (Key-exchange Key 或 Key Enrollment Key) 用来管理 db 和 dbx。



Key-exchange Key (KEK) 指的是 Microsoft® Secure Boot Key-Enrollment Key (KEK)。

#### Delete the KEK

本项目用来删除系统中的 KEK。

设置值有：[Yes] [No]。

#### Load KEK from File

本项目用来设置由 USB 存储设备下载 KEK。

#### Append KEK from File

本项目用来设置由存储设备下载其他 KEK 以管理 db 和 dbx。



KEK 文件必须格式化为一个基于时间认证变量的 UEFI 变量结构。

### *DB Management*

db (认证签名数据库) 列出可以在单一电脑载入之 UEFI 应用程序、操作系统载入器与 UEFI 驱动程序的签名者或图片图像。

#### Delete the db

本项目用来删除系统中的 db 文件。设置值有：[Yes] [No]

#### Load db from File

本项目用来由 USB 存储设备载入已下载的认证签名数据库 (db)。

#### Append db from file

本项目用来由存储设备载入附加的认证签名数据库 (db)，以安全的载入更多的图片图像。



db 文件必须格式化为一个基于时间认证变量的 UEFI 变量结构。

### DBX Management

dbx（撤销签名数据库）列出 db 项目中不再被信任且无法被载入之被禁止的图片图像。

#### Delete the dbx

本项目用来删除系统中的 dbx 文件。

#### Load dbx from File

本项目用来由 USB 存储设备载入已下载的撤销签名数据库（dbx）。设置值有：[Yes] [No]。

#### Append dbx from File

本项目用来由存储设备载入附加的撤销签名数据库（dbx），以使更多的 db 图片图像无法被载入。



---

dbx 文件必须格式化为一个基于时间认证变量的 UEFI 变量结构。

---

### Boot Option Priorities

本项目让您自行选择启动磁盘并排列启动设备顺序。依照 1st、2nd、3rd 顺序分别代表其启动设备顺序，而设备的名称将因使用的硬件设备不同而有所差异。



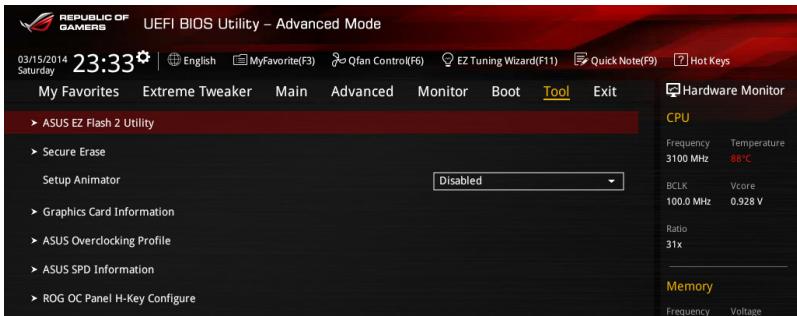
- 欲进入 Windows 安全模式时，请在开机自检（POST）时按下 <F8>（Windows 8 不支持这项功能）。
  - 启动时您可以在 ASUS Logo 出现时按下 <F8> 选择启动设备。
- 

### Boot Override

本项目将显示可使用的设备，设备的名称将因使用的硬件设备不同而有所差异。点击任一设备可将该设置为启动设备。

## 3.9 工具菜单 (Tool menu)

本工具菜单可以让您针对特别功能进行设置。请选择菜单中的选项并按下 <Enter> 键来显示子菜单。



### 3.9.1 ASUS EZ Flash 2

本项目可以让您启动华硕 EZ Flash 2 程序，按下 <Enter> 会出现再次确认的窗口，请使用左右键选择 [Yes] 或 [No]，接着按下 <Enter> 确认。



请参考 华硕 EZ Flash 2 的说明。

### 3.9.2 ROG Secure Erase

随着使用的时间，过多的文件数据可能会导致 SSD 速度变慢，Secure Erase 可完全并安全清除您的 SSD 以恢复到出厂时的性能水准。



Secure Erase 功能只在 AHCI 模式下使用，请先确认将 SATA 模式设置为 AHCI。点击 Advanced > SATA Configuration > AHCI 进行设置。

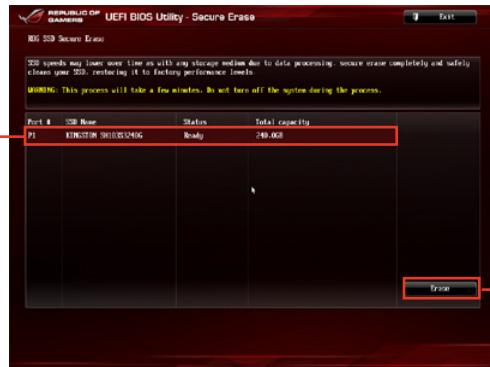
要启用 ROG SSD Secure Erase，请点击 Advanced 菜单下的 Tool > ROG SSD Secure Erase 以进行开启。



请上网至华硕支持网站以查看完整的 SSD 支持 Secure Erase 的测试列表。若您使用不兼容的 SSD 运行 Secure Erase 则可能会造成系统不稳定。



- 运行 Secure Erase 时视 SSD 的容量大小而需等候一段时间来进行清除，在进行的过程中请勿关闭系统。
- Secure Erase 功能只支持 Intel SATA 接口，如欲了解更多关于 Intel SATA 接口的信息，请参考本手册 1.2.2 一节的说明。



显示可使用的  
SSD

点击以开始  
SSD Secure  
Erase 操作



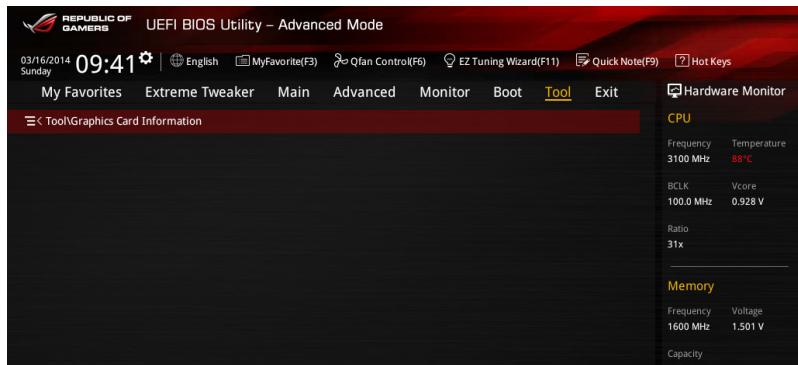
#### 状态定义：

**Frozen (冻结)**：这个状态为 BIOS 的保护措施，BIOS 守卫在启动前冻结没有密码保护的驱动程序。如果驱动程序被冻结，则必须关机或必须将电脑用 Secure Erase. 运行硬件重置。

**Locked (锁定)**：若 Secure Erase 运行不完整或已经停止，SSD 可能被锁住。这可能需要使用由华硕定义的第三方不同密码。您必须在使用 Secure Erase 前，先使用软件将 SSD 解锁。

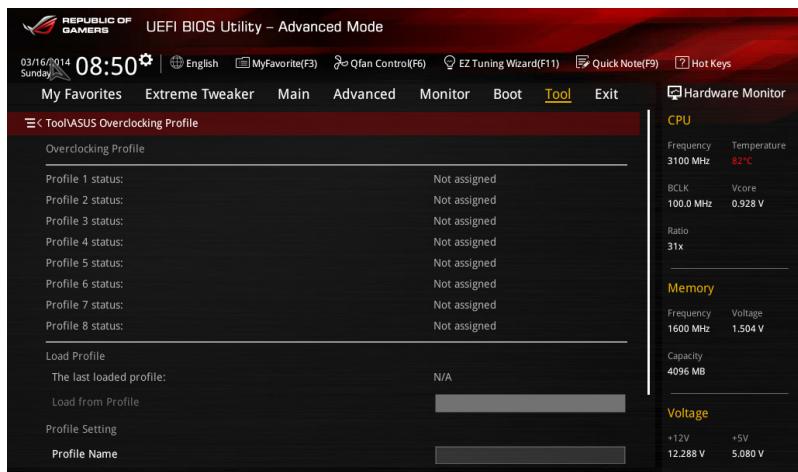
### 3.9.3 显卡信息 (Graphics Card Information)

本菜单会显示已安装在系统内的显卡信息。



### 3.9.4 ASUS Overclocking Profile

本菜单可以让您存储或载入 BIOS 设置。



#### Profile Name

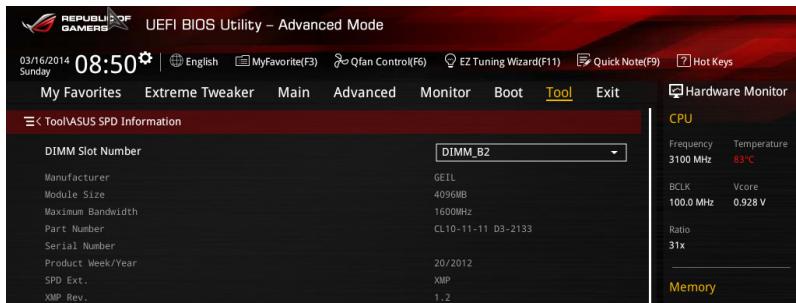
提供您在 Profile 1 至 8 中输入设置文件 (Profile name) 名称，以存储当前 BIOS 设置。

#### Save to Profile

本项目可以让您存储当前的 BIOS 设置文件，请选择 Profile 1 至 8 其中一个进行存储。

### 3.9.5 ASUS SPD Information

本菜单显示插槽的相关信息。



#### DIMM slot number [DIMM\_B2]

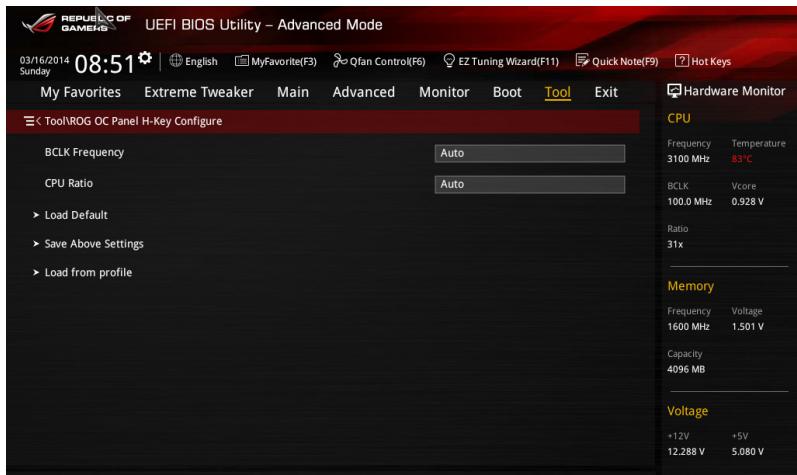
提供您选择内存条插槽以显示已安装的内存 SPD (Serial Presence Detect) 信息。  
设置值有 : [DIMM\_A1] [DIMM\_A2] [DIMM\_B1] [DIMM\_B2]



某些内存制造商可能无法被识别。

### 3.9.6 ROG OC Panel H-Key Configure

ROG OC Panel H-Key 提供您在 UEFI BIOS 之下输入并存储 CPU Core voltage、CPU input voltage、BCLK Frequency 与 CPU ratio 数值。这些已存储的数值可同步至 OC Panel 设备，提供用户在 OS 下进行调校，而无须进入 BIOS 菜单进行。另外，这些数值也可以通过 OC Panel 做更改！



#### BCLK Frequency [Auto]

本项目提供您调整 BCLK 频率。变更的数值范围从 60 MHz 至 300 MHz。

#### CPU Ratio [Auto]

本项目用来设置 CPU 核心时序与前端总线频率的比值。请使用 <+> 或 <-> 按键来调整。设置值会随着所安装的处理器而有不同。

#### Load Default

本项目用来载入 CPU Core Voltage、CPU Input Voltage、BCLK Frequency 与 CPU Ratio 默认值。重置 Load Default 所有数值请选 [Auto]。

#### Save Above Settings

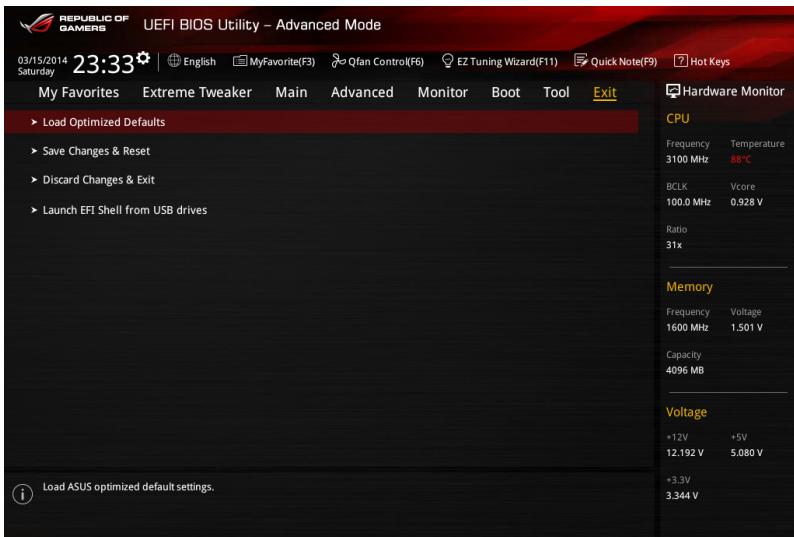
本项目提供您存储新设置好的 CPU Core Voltage、CPU Input Voltage、BCLK Frequency 与 CPU Ratio 设置值。

#### Load from profile

本项提供您载入前一次的 CPU Core Voltage、CPU Input Voltage、BCLK Frequency 与 CPU Ratio 设置值。

## 3.10 退出 BIOS 程序 (Exit menu)

本菜单可让您读取 BIOS 程序出厂默认值与退出 BIOS 程序。你也可以由 Exit 菜单进入 EZ Mode。



### Load Optimized Defaults

本项目可让您载入 BIOS 程序设置菜单中每个参数的默认值。当您选择本项目或按下 **<F5>**，便会出现一个确认对话窗口，选择 Yes 以载入默认值。

### Save Changes & Reset

当您完成对 BIOS 设置程序所做的变更后，请选择本项目或按下 **<F10>**，将会出现一个确认对话窗口，请选择 Yes 以存储设置并退出 BIOS 设置程序。

### Discard Changes & Exit

本项目可让您放弃所做的变更，并恢复原先存储的设置。在选择本项目或按下 **<Esc>** 键后，将会出现一个确认对话窗口，请选择 Yes 以放弃任何设置并载入原先存储的设置，同时退出 BIOS 设置程序。

### Launch EFI Shell from filesystem device

本项目可以让您由含有数据系统的设备中启动 EFI Shell (shellx64.efi)。

## 3.11 更新 BIOS 程序

华硕网站上提供有最新的 BIOS 程序，可以强化系统的稳定度、兼容性或运行性能，但是运行 BIOS 程序更新是具有潜在性风险的，若是使用现有版本的 BIOS 程序都没有发生问题时，请勿手动运行更新 BIOS 程序。不适当的 BIOS 程序更新可能会导致系统启动失败。若有需要，请使用以下各节的方法来更新您的 BIOS 程序。



请访问华硕网站 (<http://www.asus.com.cn>) 下载本主板最新的 BIOS 程序。

1. EZ Update：在 Windows 操作系统中更新 BIOS 程序。
2. ASUS EZ Flash 2：使用 U 盘来更新 BIOS。
3. ASUS CrashFree BIOS 3：当 BIOS 文件遗失或损毁时，可以使用 U 盘或主板的驱动程序与应用程序光盘来更新 BIOS。
4. ASUS BIOS Updater：在 DOS 环境下，使用主板驱动程序与应用程序光盘与 U 盘来更新并备份 BIOS。

上述软件请参考相关章节的详细使用说明。

### 3.11.1 EZ Update

EZ Update 是一套可以让您在 Windows 操作系统下，用来更新主板 BIOS 文件的应用程序。



- 在使用 EZ Update 之前，请先确认您已经经由内部网络对外连接，或者经由网络服务提供商 (ISP) 所提供的连接方式连接到互联网。
- 这个程序可以在主板附赠的驱动程序及应用程序光盘中找到。
- 请参考 EZ Update 一节的说明进行 BIOS 文件更新。

### 3.11.2 华硕 EZ Flash 2

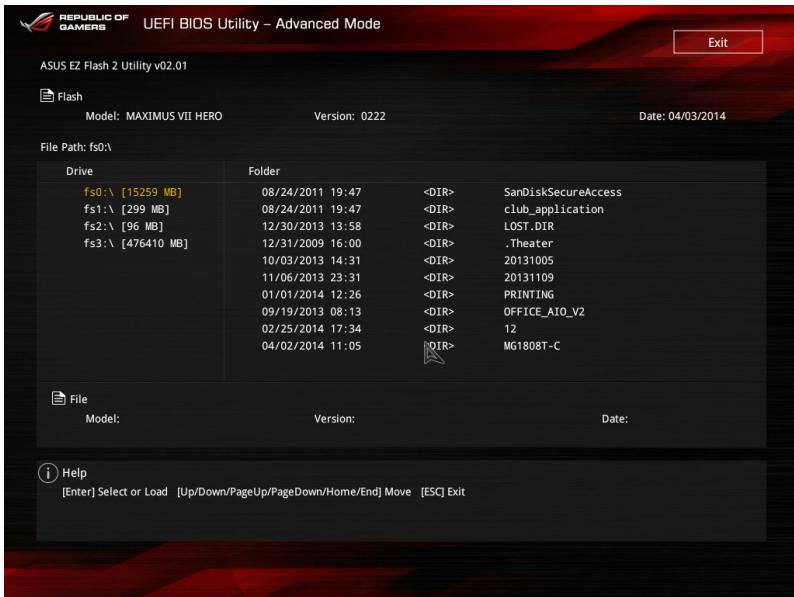
华硕 EZ Flash 2 程序让您能轻松的更新 BIOS 程序，可以不必再通过启动盘的冗长程序或是到 DOS 模式下运行。



请至华硕网站 <http://www.asus.com.cn> 下载最新的 BIOS 程序文件。

请依照以下步骤通过 EZ Flash 2 更新 BIOS 程序：

1. 将存储有最新的 BIOS 文件的 U 盘插入 USB 接口。
2. 进入 BIOS 设置程序的 Advanced Mode，选择 Tool > ASUS EZ Flash Utility，接着请按下 <Enter> 键。



3. 请使用 <Tab> 键操控至 Drive 字段。
4. 请利用上/下方向键找到存放有最新 BIOS 文件的 U 盘，接着请按下 <Enter> 键。
5. 请使用 <Tab> 键操控 Folder Info 区域。
6. 请利用上/下方向键找到 U 盘中最新的 BIOS 文件，接着请按下 <Enter> 键开始 BIOS 更新操作。当 BIOS 更新操作完成后请重新启动电脑。



- 本功能只支持采用 FAT 32/16 格式的单一磁区 U 盘。
- 当更新 BIOS 时，请勿关闭或重置系统以避免系统启动失败。



请读取出厂默认值来保持系统的稳定。请参阅 3.9 退出 BIOS 程序 一节中 Load Optimized Defaults 项目的详细说明。

### 3.11.3 华硕 CrashFree BIOS 3

华硕最新自行研发的 CrashFree BIOS 3 工具程序，让您在当 BIOS 程序和数据被病毒入侵或毁损时，可以轻松的从驱动程序及应用程序光盘，或是从含有最新或原始的 BIOS 文件的 U 盘中恢复 BIOS 程序的数据。



在驱动程序及应用程序光盘中的 BIOS 程序版本可能会比官方网站上的 BIOS 程序版本旧，若是想要使用更新的 BIOS 程序，请至 <http://www.asus.com.cn/support> 网站下载，并存储在便携存储设备中。

#### 恢复 BIOS 程序

请依照下列步骤使用应用程序光盘恢复 BIOS 程序：

1. 启动系统。
2. 将主板的应用程序光盘放入光驱，或是将含有最新或原始的 BIOS 文件的 U 盘插入 USB 接口。
3. 接着，工具程序便会自动检查光盘或存储设备中是否存有 BIOS 文件。当搜索到 BIOS 文件后，工具程序会开始读取 BIOS 文件并自动进入 ASUS EZ Flash 2 程序。
4. 系统需要您进入 BIOS 程序来恢复 BIOS 设置，为了确保系统的兼容性与稳定性，推荐您按下 <F5> 按键来载入 BIOS 程序的默认值。



当更新 BIOS 时，请勿关闭或重置系统以避免系统启动失败。

### 3.11.4 华硕 BIOS Updater

华硕 BIOS Updater 让您可以在 DOS 环境下更新 BIOS 程序，还可以用来复制现有的 BIOS 文件，当您的 BIOS 程序在更新过程中失败或中断时，可以作为备份使用。



以下的程序画面只能参考，您实际操作的画面可能会与手册所示的画面不尽相同。

#### 更新 BIOS 之前

1. 准备本主板的驱动程序与应用程序光盘，以及 FAT32/16 格式且单一磁区的 U 盘。
2. 访问华硕网站 <http://www.asus.com.cn/support> 下载最新的 BIOS 程序与 BIOS Updater，然后存储在 U 盘。

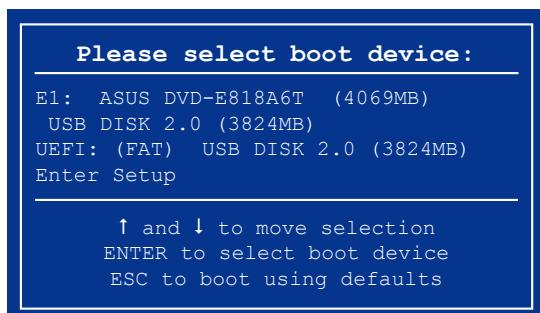


- DOS 环境下不支持 NTFS 格式，请勿将 BIOS 文件与 BIOS Updater 存储在 NTFS 格式的 U 盘。
- 请勿将 BIOS 程序存储在软盘，以免软盘的容量不够使用。

3. 将电脑关机。
4. 请确认电脑配备有光驱。

#### DOS 环境下启动系统

1. 将存有最新 BIOS 文件与 BIOS Updater 的 USB 存储设备插入 USB 接口。
2. 启动电脑，按下 <F8> 来显示 BIOS 启动设备选择菜单。
3. 当启动设备选择菜单出现时，将驱动程序与应用程序光盘放入光驱，然后选择光驱作为启动磁盘。



4. 当启动信息出现时，在五秒钟内按下 <Enter> 键来进入 FreeDOS 弹出窗口。

```
ISOLINUX 3.20 2006-08-26 Copyright (C) 1994-2005 H. Peter Anvin  
A Bootable DVD/CD is detected. Press ENTER to boot from the DVD/CD.  
If no key is pressed within 5 seconds, the system will boot next priority  
device automatically. boot:
```

5. 当 FreeDOS 出现时，输入命令 d:，然后按下 <Enter>，将磁盘 C (光驱) 改为磁盘 D (USB 存储设备)。

```
Welcome to FreeDOS (http://www.freedos.org)!  
C:/> d:  
D:/>
```

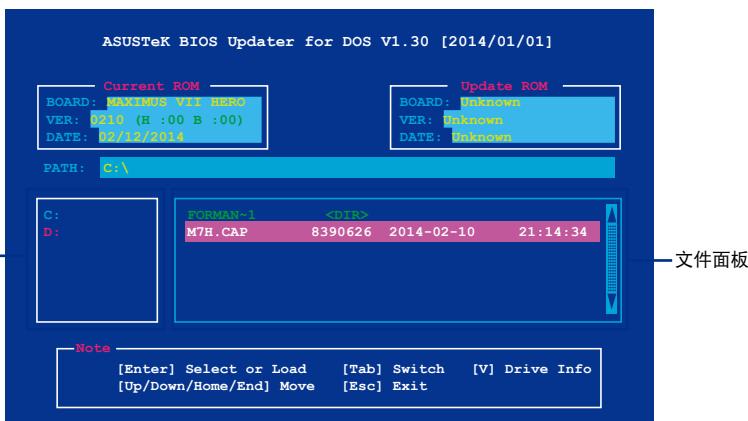
## 更新 BIOS 文件

请依照以下步骤更新 BIOS 文件：

1. 当 FreeDOS 出现时，输入命令 bupdate /pc /g，然后按下 <Enter>。

```
D:/> bupdate /pc /g
```

2. 在 BIOS Updater 画面按下 <Tab> 按键从文件面板切换至磁盘面板，然后选择 D:。



3. 按下 <Tab> 按键从磁盘面板切换至文件面板，使用 <Up/Down/Home/End> 按键选择 BIOS 文件然后按下 <Enter>。

4. BIOS Updater 检查所选的 BIOS 文件后，选择 Yes 来确认 BIOS 更新。



由于安全规则，不支持 BIOS 备份功能。

5. 选择 Yes 然后按下 <Enter>，当 BIOS 更新完成时，按下 <ESC> 退出 BIOS Updater。
6. 重新启动电脑。



请勿在 BIOS 进行更新时，运行关机或重新启动电脑，以防止 BIOS 更新失败。



请载入 BIOS 程序的默认值以确保系统的兼容性与稳定性。在 3.10 退出 BIOS 程序 (Exit menu) 菜单选择 Load Optimized Defaults。



# 第四章

## 4.1 安装操作系统



- 本主板支持 Microsoft® Windows® 7、Windows® 8、Windows® 8.1 32/64-bit 操作系统（OS，Operating System）。
- 由于主板和周边硬件设备的选项设置繁多，本章只就软件的安装程序供您参考。您也可以参阅您使用的操作系统说明文件以取得更详尽的信息。

## 4.2 驱动及应用程序 DVD 光盘信息

随货附赠的驱动及应用程序 DVD 光盘包括了数个有用的软件和应用程序，将它们安装到系统中可以强化主板的性能。



华硕驱动程序及应用程序 DVD 光盘的内容会不定时地更新，但不另行通知。如欲得知最新的信息，请访问华硕的网站 <http://www.asus.com.cn>。

### 4.2.1 运行驱动及应用程序 DVD 光盘



当在 Windows® 7、Windows® 8 或 Windows® 8.1 操作系统中运行驱动程序及应用程序 DVD 光盘之前，请先确认您拥有管理员帐号。

请依照以下步骤来运行驱动及应用程序 DVD 光盘：

1. 将驱动程序及应用程序 DVD 光盘放入光驱。
2. 在自动播放（AutoPlay）对话框中点击运行 ASSETUP.exe（Run ASSETUP.exe）。



如果自动播放（AutoPlay）窗口没有出现，那么您也可以到驱动程序及应用程序光盘中的 BIN 文件夹里直接点击 ASSETUP.EXE 主程序开启菜单窗口。

## 驱动及应用程序 DVD 光盘主菜单



### 4.2.2 取得软件用户手册

您可在驱动程序 DVD 光盘中找到软件用户手册，请依照以下步骤来取得您需要的软件用户手册。

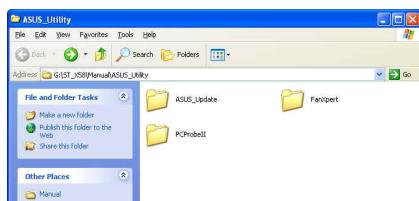


软件用户手册文件为 PDF 格式，在您开启用户手册文件前，请先安装 Adobe® Acrobat® Reader 浏览软件。

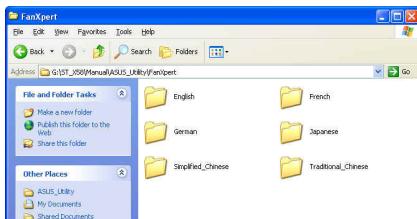
1. 点击 Manual (用户手册) 项目，由列表中选择 ASUS Motherboard Utility Guide。



2. 进入 Manual (用户手册) 文件夹后，在您需要的用户手册文件夹用鼠标左键点二下。



3. 请由数个语言的用户手册中选择您需要的用户手册。



本章节的图标只能参考，在驱动程序 DVD 光盘中所包含的软件用户手册，会依照您所购买的型号而有不同。

## 4.3 软件信息

驱动程序及应用程序光盘中大部分的应用程序都会有安装指导向导来协助您一步一步轻松地安装软件。您也可以由个别软件所提供的在线说明档或读我档取得安装方式及其他信息的说明。

## 4.4 华硕智能管家 3 代 (AI Suite 3) 程序

通过友善的用户界面，华硕智能管家 3 代程序将所有的华硕独家功能集成在一个软件套件中，可以同时操控并运行各项功能及应用程序。

### 安装华硕智能管家 3 代程序

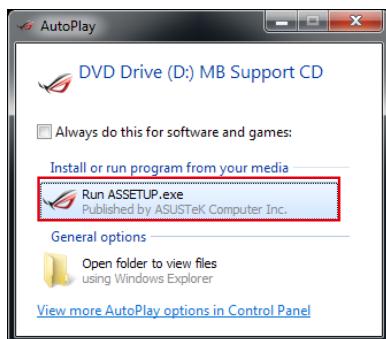


在您将智能管家 3 代程序安装至 Windows 7、Windows 8 或 Windows 8.1 操作系统之前，请先确认您拥有管理员帐号。

请依照下列步骤将华硕智能管家 3 代程序安装到您的电脑：

#### Windows® 7 操作系统

1. 将驱动程序及应用程序 DVD 光盘放入光驱。
2. 在自动播放 (AutoPlay) 对话框中点击运行 ASSETUP.exe。



3. 点击应用程序 (Utilites) 标签页，接着点击智能管家 3 代 (AI Suite 3)，然后请依照屏幕指示来完成安装步骤。

## Windows 8 与 Windows 8.1 操作系统

1. 将驱动程序及应用程序 DVD 光盘放入光驱，然后依照屏幕的指示来完成安装步骤。
2. 从驱动程序及应用程序 DVD 光盘主菜单中选择应用程序（Utilites）标签页，然后点击 AI Suite 3。
3. 请依照屏幕的指示运行。

若是驱动程序及应用程序 DVD 光盘主菜单没有出现，请参考以下步骤：

a. 到开始画面，然后点击或轻触桌面的应用程序。

b. 在桌面的左下角点击或轻触 File Explorer ，然后选择 DVD 磁盘并轻触或双击 设置。

## 运行华硕 AI Suite 3 程序

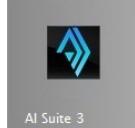
### Windows 7 操作系统

从桌面点击 开始 > 所有应用程序 > ASUS > AI Suite 3> AI Suite 3。

您也可以在 Windows 7 的通知任务栏中点击 。

### Windows 8 与 Windows 8.1 操作系统

在开始画面轻触智能管家 3 代 (AI Suite 3) 应用程序，若您使用鼠标，则请在开始画面点击智能管家 3 代 (AI Suite 3) 应用程序。



## 智能管家 3 代 (AI Suite 3) 主画面

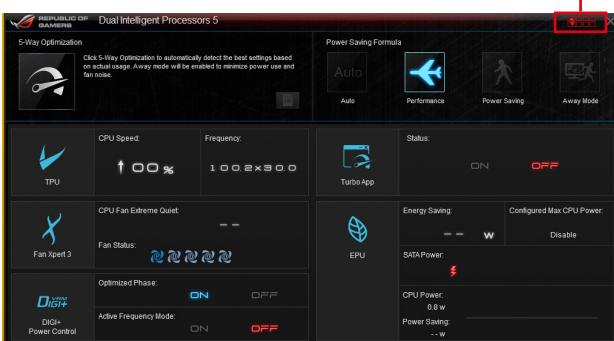
智能管家 3 代主画面提供您轻松进入控制和了解电脑发生了什么状况 - 能提供您将性能做最佳化设置，并同时确保系统的稳定性。

此主画面包含一个快速进入的主菜单任务栏，可以让您快速开启任何集中在这里的华硕应用程序。点击主画面右上方  图标便可以开启此主菜单任务栏。



AI Suite 3 主画面只能参考，请以您实际看到的画面为准。

点击以启动 智能管家 3 代 菜单任务栏



## 智能管家 3 代主菜单任务栏

双智能处理器 5 USB 3.0 Boost 系统信息 USB Charger+



- 本章节的画面只能参考，请以您实际看到的画面为准。
- 请参考驱动及应用程序 DVD 光盘中软件手册的说明，或访问华硕网站 <http://www.asus.com.cn> 获得软件设置的详细说明。

## 4.5 双智能处理器 5 ( Dual Intelligent Processors 5 )

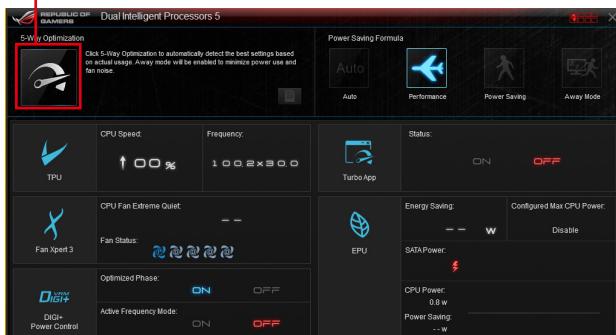
华硕双智能处理器 5 界面包含五个工具程序：TPU、EPU、DIGI+ Power Control、Fan Xpert 3 与 Turbo App 功能以促进系统性能推进至最佳潜力表现。通过 AI Suite 3 程序友善的操作界面，可以自动平衡系统的性能、省电、层级和风扇设置。

### 5-Way Optimization ( 5-Way 最佳化 )

5-Way 最佳化工具程序可以动态方式来最佳化电脑在实时状态下的实际使用情况，以提供最佳的系统状态。其包含了最关键的领域，如 CPU 的性能、节能、稳定的数码电源、良好的散热与静音的风扇控制。并提供您可量身自订的 APP 设置，以确保电脑在游戏、娱乐、办公或任何使用上都能做好充分准备。

点击以根据实际使用状况

自动检测最佳 5-Way 设置



在设置过程中请勿移除风扇。

## TPU (TurboV Processing Unit)

华硕 TPU 可让您手动调整 CPU 频率、CPU Cache 与 Core 频率、DRAM 频率以及相关电压值以增加系统稳定并提升性能表现。



在调整 CPU 电压前，请先参考 CPU 说明文件。设置过高电压可能会造成 CPU 永久损害；电压设置过低可能会导致系统不稳定。



为求系统稳定，TurboV 中做的所有变更都不会存储至 BIOS 程序中，同时也不会保留至下次启动。请使用 Save Profile 功能存储您自订的超频设置，并在启动后手动载入设置档。

### 使用 TPU

#### CPU Frequency

点击 ◀ 或 ▶ 以调整 Base Clock Frequency、CPU Ratio、与 CPU Cache Ratio

点击 ▶ 或 ▲ 以选择核心数进行调整

勾选以开启 Group Tuning

往下滚动可以调整其他项目



点击以载入已存储的设置档

处理器核心电压调整

点击以载入默认值

点击以应用变更

点击以将变更存储至设置档

点击以取消变更

## GPU Boost



## EPU (Energy Processing Unit)

EPU 是一个实时系统的省电芯片，可以自动检测当前的系统负载，并且智能地调节电量使用。此功能提供系统完整的最佳化省电、降低风扇噪音，并延长硬件元件的使用寿命。

### 使用 EPU



- 当您启动 Configured Max CPU Power 以求高级省电状态时，Windows® 操作系统信息中的 CPU 频率可能会显示为 800 MHz。然而 CPU 频率会根据您手动设置的功率数值而有所不同。您可以根据您偏好的默认值将 CPU 功率调至最低。
- 启动 Configured Max CPU Power 可能会降低在重系统负载情况下的 CPU 供电量并影响 CPU 性能。要将系统恢复至默认值，请重新启动。

## DIGI+ 程序

华硕 DIGI+ Power Control 程序让您可以轻松的调整处理器与内存电源设置，确保性能与稳定性，同时提供最佳电源使用性能。



以下面只能参考，请以您实际看到的画面为准。



### 1 CPU Power Phase Control

CPU Power Phase Control 通过在重系统负载情况下增加相式数以得到更快更佳的散热性能；在轻系统负载情况下减少相式数以增加 VRM 效率。

### 2 CPU VRM Switching Frequency

启用 spread spectrum 可以增强系统稳定性。

### 3 CPU Power Thermal Control

较高的温度提供更广的 CPU 电力散热范围，并扩展超频的容忍度来提升超频的潜力。

### 4 CPU Current Capability

CPU Current Capability 针对超频提供了较宽的总功率范围。数值越高，则带来更广的功率范围，同时也能扩大超频频率范围。

### 5 CPU Load-line Calibration

提供您调整电压范围来控制 CPU Load-line。可以针对系统性能来调整较高的数值，或可以针对功率效率来调整较低的数值

### 6 CPU Power Duty Control

CPU Power Duty Control 可调整 VRM 各相电流及元件温度。

## Fan Xpert 3

FAN Xpert 3 提供您自行做风扇设置来达到更佳冷却效果与更安静的电脑使用环境。通过风扇自动调节功能，华硕 Fan Xpert 3 会自动调整处理器与风扇的设置，以达到最好的散热性能。

华硕 Fan Xpert 3 亦支持处理器和风扇硬件层级的 PWM/PC 复合模式，您还可以在默认最小的状态下降低处理器风扇转速，以达到无声操作的处理器风扇运转速度。



## Turbo App ( Turbo 应用程序 )

本程序可以提供自订系统性能、网络优先顺序与应用程序的音频设置。

当 Turbo App 列表里有某个应用程序，您可以分配 CPU 频率、决定网络优先顺序与定义所选择的音频设置。



### ① Applications list pane

现在当前正在运作的应用程序。

### ② Turbo App List pane

显示加入 Turbo App List 字段中的应用程序。

\* 只有加入 Turbo App List 字段里的应用程序才能被设置。

### ③ Performance pane

提供您分配 CPU 性能给选定的应用程序。

### ④ Audio pane

提供您手动指派默认音频设置给选定的应用程序。

### ⑤ LAN pane

提供您分配应用程序使用的网络优先顺序。

## 华硕 USB 3.0 Boost 程序

华硕 USB 3.0 Boost 程序可提升 USB 3.0 设备的传输速度，并支持 USB 连接 SCSI 协议（UASP，USB Attached SCSI Protocol）。通过华硕 USB 3.0 Boost 程序，可轻松提升您的 USB 3.0 设备之传输速度。

### 运行华硕 USB 3.0 Boost 程序

若要运行 USB 3.0 Boost，请点击 AI Suite 3 主菜单右上方的  图标，然后选择 USB 3.0 Boost。

### 使用华硕 USB 3.0 Boost 程序



请确认连接在 USB 3.0 接口的 USB 3.0 设备有支持 USB 3.0 Boost，请参考 [後面板接口](#)以了解更多说明。



- 请参考驱动程序 DVD 光盘中软件手册的说明，或访问华硕网站 <http://www.asus.com.cn> 获得软件设置的详细说明。
- 使用 USB 3.0 设备来获得高性能表现，数据传输的速度会依照 USB 设备的不同而改变。

## EZ Update

EZ Update 应用程序让您轻松地自动更新主板的软件、驱动程序以及 BIOS 版本。

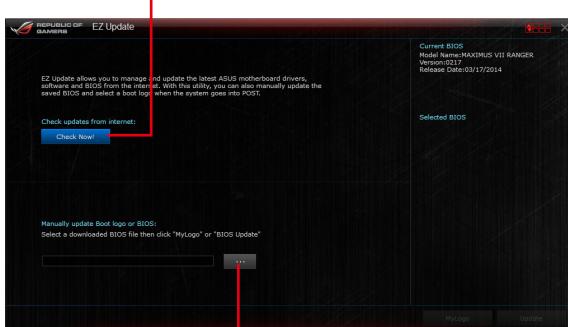
通过这个程序，您可以手动更新 BIOS，并选择开机自检（POST）时想要用来显示的启动图标。

### 运行 EZ Update

若要运行 EZ Update，请点击屏幕右上方  图标，然后点击 AI Suite 3 主菜单任务栏上的 EZ Update。

### EZ Update 主画面

点击以自动更新主板的驱动程序、软件与固件



点击以搜索并选择 BIOS 文件

点击以选择启动图标

点击以更新 BIOS

## 系统信息

这个程序可以让您获得本主板、处理器与内存设置的详细信息。

### 运行系统信息

若要运行系统信息，请点击屏幕右上方  图标，然后点击 AI Suite 3 主菜单任务栏上的 System Information (系统信息)。

### 查看主板信息

从系统信息主画面，点击 MB (主板) 标签页来查看主板的相关信息。



### 查看处理器信息

从系统信息主画面，点击 CPU (处理器) 标签页来查看处理器的相关信息。



## 查看 SPD 信息

从系统信息主画面，点击 SPD 标签页来查看内存的相关信息。



## USB BIOS Flashback 向导

USB BIOS Flashback 向导可以查看并将最新版 BIOS 程序存储至 USB 存储设备，配合 ASUS USB BIOS Flashback 的硬件特色，让您不需重新启动即可更新 BIOS 程序。

### 运行华硕 USB BIOS Flashback 程序

若要运行 USB BIOS Flashback，请点击 AI Suite 3 主菜单右上方的  图标，然后选择 USB BIOS Flashback。



USB BIOS Flashback 只适用于特定的主板型号。

### 使用 USB BIOS Flashback 程序



#### 设置下载 BIOS 更新的排程

1. 请于 Download Setting (下载设置) 中勾选 Schedule (days) (排程)，并选择下次进行下载更新的天数。
2. 请点击 Apply 应用变更，或是点击 Cancel 以取消变更。

## 华硕充电专家 (USB Charger+)

华硕充电专家用来快速充电您的便携 USB 设备，即使在电脑关机、睡眠状态或休眠状态仍可进行充电。



在使用 华硕充电专家 之前，请先确认关闭在 BIOS 设置中 Advanced 模式的 Advanced > APM > ErP Ready 的 ErP Ready 选项。

### 运行华硕充电专家

若要运行华硕充电专家，请点击 智能管家 3 代 主菜单上方的 图标，然后选择 华硕充电专家。

### 使用华硕充电专家程序



请确认将您的 USB 设备连接至支持本程序之 USB 接口。请参考 2.3.1 后面板接口 一节的详细说明。



- 华硕充电专家不支持 USB 集线器、USB 延长线及一般的 USB 排线。
- 由于特殊设计的因素，华硕充电专家可能无法辨识某些 ASUS 设备。

## 推播信息 (Push Notice)

这个应用程序让您可以将系统状态的详细信息传送至智能型设备，您也可以使用这个程序传送信息至智能型设备。



使用这个应用程序之前，请先确认您的电脑与智能型设备已经完成配对。  
。请参考 配对电脑与智能型设备 一节的详细信息。

### 启动电脑的推播信息 (Push Notice)

若要启动推播信息，请点击 AI Sutie 3 主菜单右上方的 图标，然后选择 Push Notice。

### 推播信息 (Push Notice) 主画面



您也可以通过屏幕右上角的 Push Notice 捷径来启动推播信息功能，请点击 << 然后点击 ，再选择 。

### 配对电脑与智能型设备

请依照以下步骤配对电脑与智能型设备：

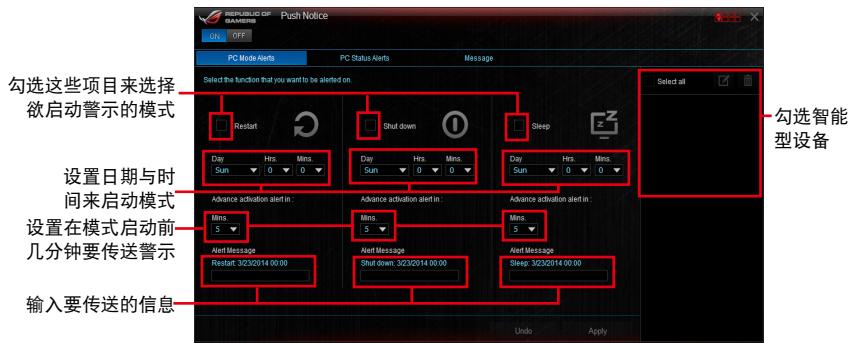
1. 在智能型设备点击 来启动推播信息 (Push Notice)。
2. 轻触 Push Scan 然后点击想要配对的电脑名称。



若要配对电脑与智能型设备，请先确认二个设备都已经连接至同一个无线网络。

## 设置要发出警报的模式

本功能用来设置当电脑重新启动、关机或进入睡眠模式时，传送警示信息至智能型设备。



## 设置电脑状态警示

本功能用来将电脑上不正常的状态，如：电压、温度和风扇设置等信息传送警示至智能型设备。

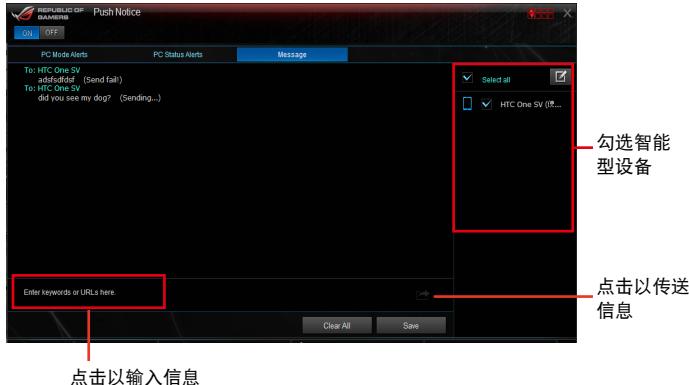


## 传送信息至智能型设备

本功能用来传送信息至智能型设备。

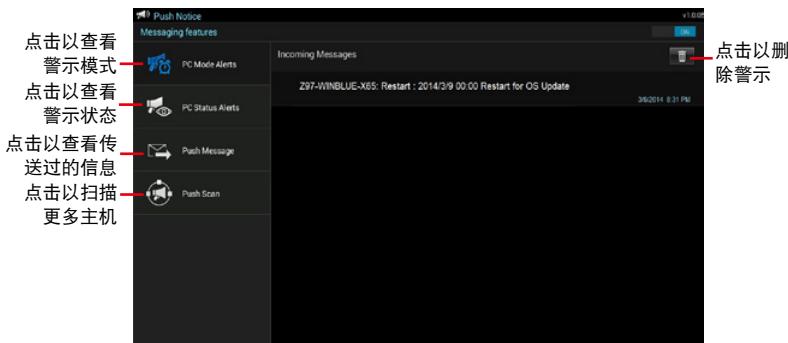


您也可以通过屏幕右上角的推播信息（Push Notice）信息捷径来传送信息，请点击 << 然后点击 ，再选择 。



## 在智能型设备查看电脑状态

在智能型设备点击 以启动推播信息（Push Notice）。



## 4.6 ROG 音频功能

### 安装软件

安装主板配件中的驱动及应用程序 DVD 光盘里的 Realtek® Audio Manager 音频程序。

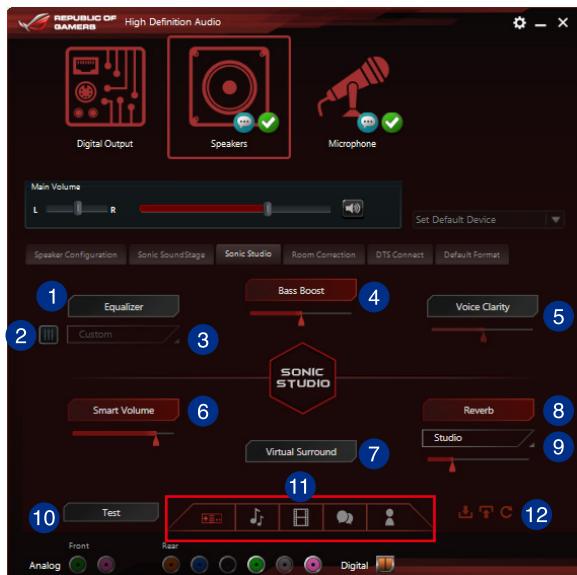
若 Realtek® 音频软件已经安装，您可以在桌面下方任务栏上找到 Realtek® HD Audio Manager 图标。请使用鼠标左键双按点击图标以显示 Realtek® HD Audio Manager 音频管理程序。



Realtek® HD Audio Manager 程序

### Sonic Studio

Sonic Studio 是一个音频调整软件，此软件提供了包含六项音频设置：Reverb（回音）、Bass Boost（重低音）、Equalizer（等化器）、Voice Clarity（语音清晰）、Smart EQ（Smart Volume）与 Virtual Surround（虚拟环绕）功能。虚拟音频通过 2 声道耳机可以做出模拟与提供游戏时的环绕音场效果。



- ① Equalizer switch (等化器开关)  
点击以启用这项功能，提供您根据自己的喜好调整等化器的参数值。
- ② Equalizer advanced settings (等化器高级设置)  
本项目只当 Equalizer switch 启用会才会显示，提供您设置等化器的设置值。您可以手动设置或自订偏好的设置或选择已存在的默认等化器设置值。
- ③ Equalizer presets (默认等化器)  
选择当前或选定的默认等化器。
- ④ Bass Boost switch (重低音开关)  
点击可以增强重低音频果，拖曳滑杆以调整音频的重低音频果。
- ⑤ Voice Clarity switch (语音清晰度开关)  
启用 Voice clarity 可以将人声读取更清晰，以获得更好的对话/音频通信质量，或聆听音乐时让人声表现更清晰。
- ⑥ Smart EQ (Smart Volume) switch (智能 EQ 音场开关)  
提供动态调整 EQ 可以让人听到更多的细节。
- ⑦ Virtual Surround switch (虚拟环绕音频开关)  
本项目提供您开启耳机的 7.1 声道环绕音频。
- ⑧ Reverb switch (回音开关)  
Reverb (回音) 效果为 Virtual Sound Stage 的一部分，可以让您选择其他回音频果。
- ⑨ Reverb presets (默认回音)  
点击以选择默认回音，然后设置不同环境空间的回音频果。  
当 Reverb switch 项目启用时，本项功能才能使用。
- ⑩ Test tone (测试音)  
点击后可以开始测试默认设置档。
- ⑪ Preset profiles (默认档)  
可以从游戏、音乐、电影或通信使用时点击任一默认档。
- ⑫ Profile import/export (设置档汇入/汇出)  
提供您汇入、汇出或还原设置档至默认状态。

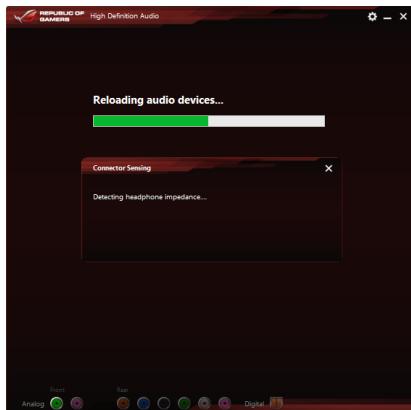
## Sonic SenseAmp

Sonic SenseAmp 是 ROG 独家研发的技术，提供主板内置音频的耳机扩大机（AMP），具备三个 AMP 等级的调整器。可以检测耳机的阻抗与调整对应至内置的扩大机（AMP）。

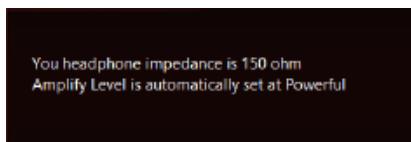


Sonic SenseAmp 只支持于前面板连接使用。

当您将耳机插入耳机孔后，Sonic SenseAmp 会立即弹出交谈窗口并显示“Detecting headphone impedance”（检测到耳机设备）。



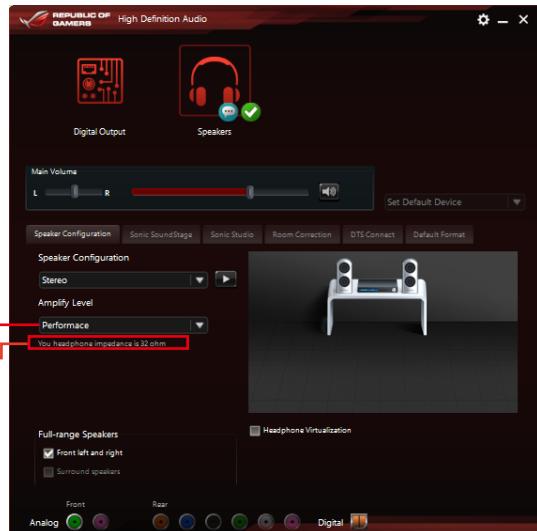
在检测好耳机的阻抗后，Sonic SenseAmp 会弹出类似如下的窗口。



当调整检测耳机的阻抗时，请参考下表有关 Sonic SenseAmp 的推荐：

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| 32 ohm     | Amplify Level 自动设置为 Performance |
| 150 ohms   | Amplify Level 自动设置为 Powerful    |
| > 150 ohms | Amplify Level 自动设置为 Extreme     |
| 其他设备       | 其他插入的设备则以其他插入设备为准               |

在您关闭弹出窗口后，Sonic SenseAmp 会进入音箱设置，并且显示调整耳机的阻抗。



点击以手动调整  
扩大机等级  
显示您耳机的阻抗

## Sonic SoundStage

Sonic SoundStage 为采用硬件基础的虚拟摄影棚完整解决方案，提供了四种游戏默认档：FPS（第一人称射击）、Racing（赛车）、Combat（格斗）与 Sport（运动）。



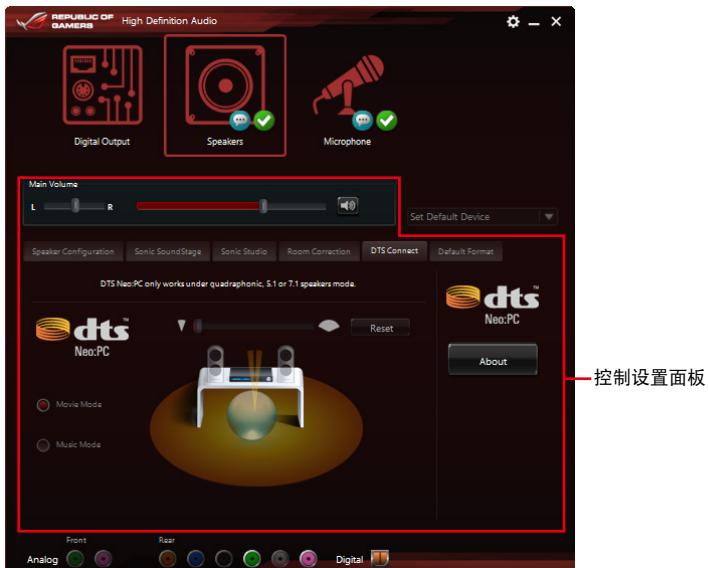
- 本项功能只适用于连接前面板连接耳机输出。
- 您可以通过主板上的 SoundStage 按钮来启用这项功能。请参考本手册关于 SoundStage 按钮的说明。



- ① Crossing  
移动滑杆来调整跨通道的混和量。
- ② Revert  
移动滑杆来还原至主音源。
- ③ Space  
移动滑杆来调整和虚拟空间声音。
- ④ Crossing gain  
当 Crossing and Revert 启用时，本项目才会显示。移动滑杆来调整墙壁的硬度。

## DTS Connect

DTS Connect 提供包含支持所有音频娱乐的格式，并采用 4、5.1 与 7.1 声道提供不可思议的环绕音频。这项功能并且能让您将电脑与家庭剧场系统连接。

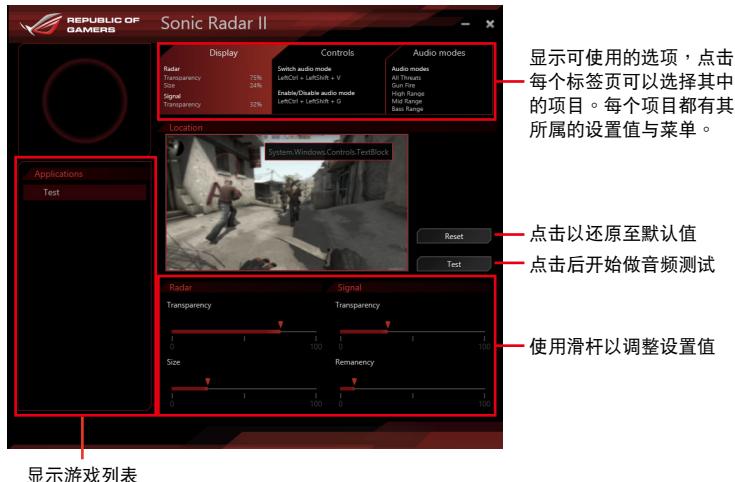


## 4.7 Sonic Radar II 软件

Sonic Radar II 是专为第一人称射击 (FPS) 游戏设计，可显示声音的精确方向，以及声音从哪边来的强度。具备友善的操作界面，并提供音响扩大器功能以放大所需的声音频果。

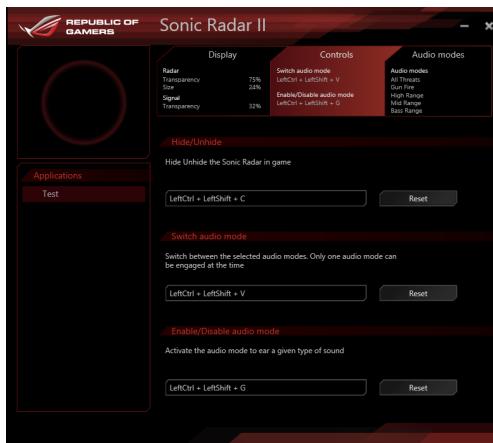
### Display Menu (显示菜单)

可提供您自订每个游戏的设置，包含 Transparency (透明度)、Signal (信号)、Size (大小) 与 Remanency (剩余磁感)。



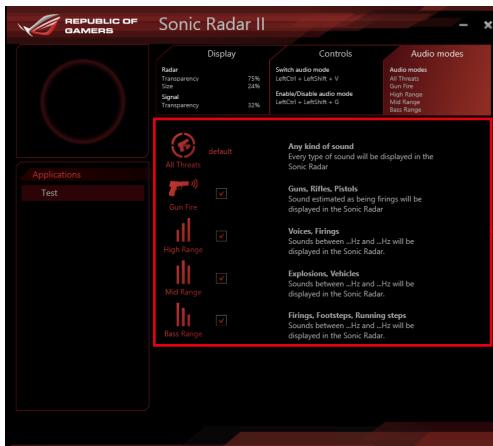
### Control Menu (控制菜单)

提供您设置快捷键。



## Audio Mode/Radar Selection menu (音频模式/雷达选项菜单)

提供您设置增强音频。



点击以选择  
想要增强的音频



Audio Mode/Radar Selection 可以在游戏进行中使用快捷键开启，请参考 Controls (控制) 标签页以了解更多有关快捷键设置的说明。

## 4.8 GameFirst III

GameFirst III 是一个网络管理软件，提供四种默认封包优先处理设置档（最佳化、游戏、串流介质与文件共享），以便于用户的需求。用户也可以手动分配带宽，并调整设置每个应用程序的优先顺序，让运行速度更快、更流畅。

如欲使用 GameFirst III，请使用鼠标左键双按点击桌面上的  图标。

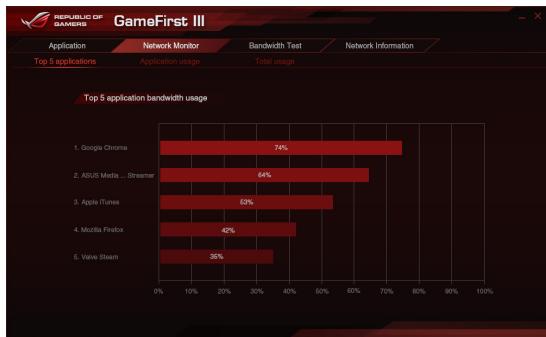


- 1 Optimization Mode (最佳化模式)  
游戏封包的优先顺序与其他封包也进行最佳化。
- 2 Game Mode (游戏模式)  
将游戏封包放在最优先顺序。
- 3 Media Streaming Mode (串流介质模式)  
将串流介质封包放在最优先顺序。
- 4 File Sharing Mode (文件分享模式)  
将文件分享封包放在最优先顺序。

## Network Monitor ( 网络监控 )

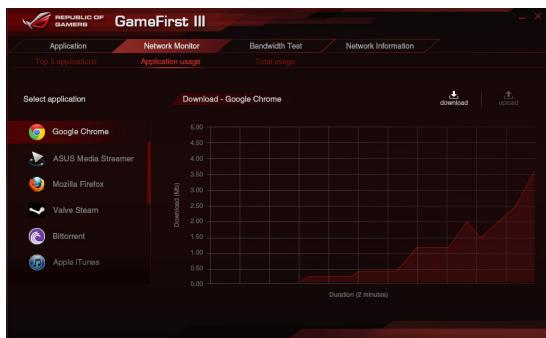
### Top 5 application ( 前 5 个应用程序 )

显示当前使用量排名前 5 名消耗带宽量的应用程序。



### Application usage ( 应用程序使用状况 )

显示当前使用的应用程序之个别的下载和上传带宽。



### Total usage ( 总使用量 )

显示当前使用的应用程序的总下载和上传带宽量。



## Bandwidth Test

你可以使用这项功能来测试网络服务提供商M (ISP) 速度或在需要时，以手动方式输入想要的上传/下载速度与应用其速度。



在手动输入想要的连接速度或在您运行速度测试后，点击应用

## Using the Network Information (使用网络信息)

显示有关实体网卡的相关信息，如 speed (速度)、physical address (物理地址)、IP address (IP 地址)、subnet mask (子网掩码) 与 default gateway (默认网关器)



## 4.9 KeyBot

KeyBot是一个内置的微型处理器，可以瞬间将键盘升级。这项功能可以提供您设置和指派巨集至键盘上指定的按键，便能同时运行特定或多项任务。并且还可以设置电脑在 CPU Level Up、XMP 的唤醒功能，或直接唤醒 BIOS 模式。

请依照以下方式使用 KeyBot：

1. 按下主板上的 KeyBot 按钮。




---

当 KEYBOT\_LED 灯号亮灯时，表示 KeyBot 功能已经开启。

---

2. 将 USB 接口键盘插入支持 KeyBot 功能的 USB 接口。



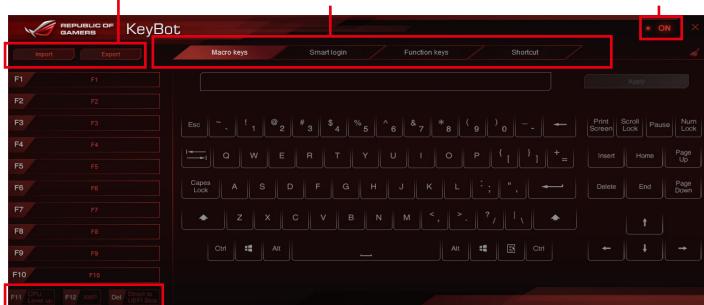

---

请参考 後面板接口 或 USB BIOS Flashback 一节的说明，以了解更多有关 KeyBot USB 接口的信息。

---

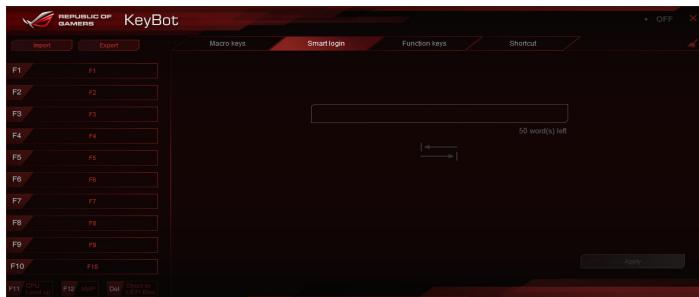
3. 使用鼠标左键双按点击桌面上的  图标，以开启 KeyBot 应用程序。

点击以汇入或汇出设置档



点击以运行特定的任务，  
或点击其对应的键盘按键

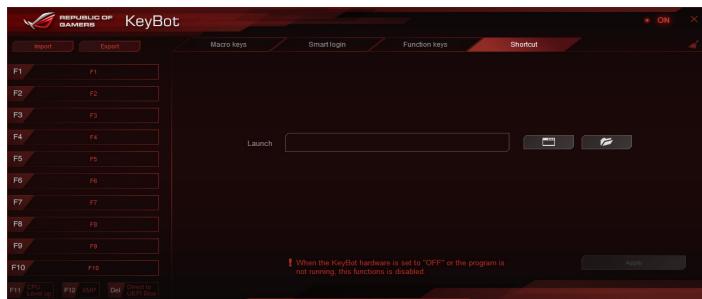
Smart login (智能登入)



## Function Keys (功能键)



## Shortcut (快捷键)



## 4.10 ASUS Media Streamer

ASUS Media Streamer 可以让您随时随地享受电脑上的多介质内容。 您可以通过电脑或智能型设备上的音乐或串流您喜好的电影至智能型电视。



- 请先在您的设备上进行 DLNA 设置。
- ASUS Media Streamer 支持 NFC 功能。



- 请确认在您的电脑上已安装 ASUS HomeCloud 。
- 需要连接至互联网才能充分使用此功能。

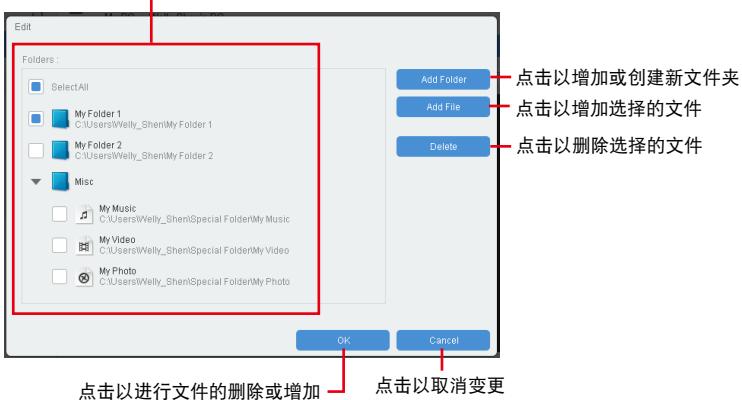
使用 ASUS Media Streamer (华硕串流介质) :

在电脑上面，点击 ASUS HomeCloud 后，选择 Media Streamer。在您的设备上，点击 Media Streamer。



## 增加与删除介质文件

勾选想要增加或删除的文件



此功能支持以下扩展名的文件格式：.3gp、.mp4、.m4a、.aac、.ts、.flac、.mp3、.mid、.xmf、.mxmf、.rtt、.rtx、.ota、.imy、.ogg、.mkv、.wav、.jpg、.gif、.png、.bmp、.webp、.webm。

## 4.11 ASUS Disk Unlocker

这个华硕独家的应用程序提供了一个容易使用的界面来辨别和运用所有硬盘里的存储空间。



### ASUS Disk Unlocker 说明档

## 4.12 RAMDisk

RAMDisk 是数据存储软件，使用部分系统内存将它变成一个高速的虚拟磁盘，提供您在此存储缓存文件与游戏程序，而能达到立即读取。RAMDisk 允许您自动备份、更新与恢复文件。



下列的文件夹并非为最适合的 RAMDisk 最佳化，移动它们至 RAMDisk 可能会对您的系统生成负面的影响。

- Swap file/Page file (分页文件)：Swap file 是一个永久的存储空间，由系统内存的虚拟内存所延伸。移动 Swap file 至 RAMDisk 容易发生全部占有的缺点，而可能会影响系统性能。
- Startup folders (启动文件夹)：当 RAMDisk 在启动时一起载入汇合的文件夹内容时，变更启动文件夹的区域可能会导致系统异常并且关闭载入您的 RAMDisk。



请点击 以开启 RAMDisk。

### 创建/删除 RAMDisk 磁盘

RAMDisk 磁盘提供放置您最爱的应用程序与文件至 RAM (内存) 里，这么一来便可以有效的运用内存速度，以获得最佳的读取/写入性能。当您的电脑每次关机时，存储在 RAMDisk 里的文件则会自动进行备份。

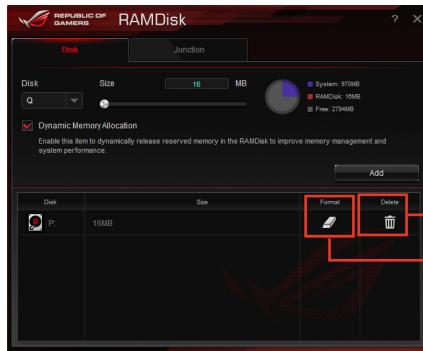


启动可能需要一段等待时间，视您的 RAMDisk 磁盘大小而定。

### 创建 RAMDisk 磁盘



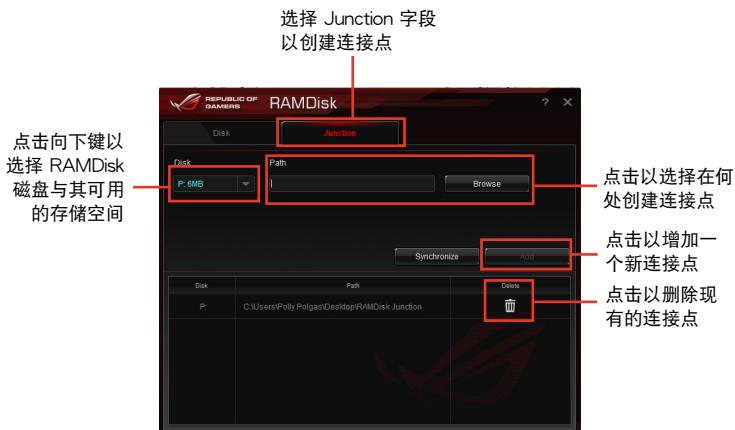
## 删除现有的 RAMDisk 磁盘



点击以删除现有的  
RAMDisk 磁盘.  
点击以格式化现有  
的 RAMDisk 磁盘.

## 创建/删除一个连接点

创建一个连接点，可以重新对应 RAMDisk 的原始内容，启用读取需要的应用程序或文件作为原始文件位置。



选择 Junction 字段  
以创建连接点

点击向下键以  
选择 RAMDisk  
磁盘与其可用  
的存储空间

点击以选择在何  
处创建连接点

点击以增加一  
个新连接点

点击以删除现  
有的连接点

## 同步备份文件

在完成创建连接点（junction point）后，RAMDisk 会自动创建一个文件夹在原始的位置。使用 RAMDisk 以手动方式同步更新这些备份文件。



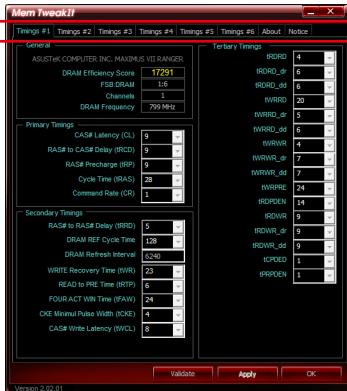
## 4.13 MemTweakIt

MemTweakIt 是一套软件提供您查看各等级的内存时序。您可通过 Mem TweakIt 验证您的内存性能分数，并在 ROG 官方网页上与其他用户比较分数排名。



MemTweakIt 功能为根据主板的类型而定，每个芯片具备不同的选项。

要开启此功能，请使用鼠标左键双按桌面上的  图标。



点击标签页以设置内存时序



点击 About 标签页然后点击 REPUBLIC OF GAMERS 可以进入 ROG 官方网页

点击以离开 MemTweakIt  
点击以应用设置  
点击以验证设置

## 验证和存储您的 MemTweakIt 设置

请依照以下方式验证与在线存储您的设置值：

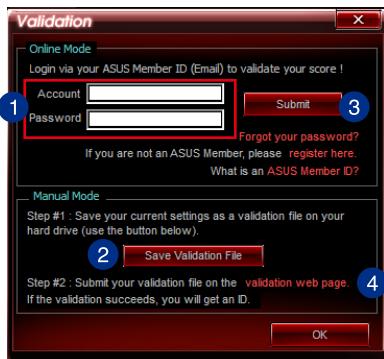
1. 开启 MemTweakIt 后点击 Validate（验证）。
2. 在 Online Mode（在线模式），输入您的华硕 Account（帐号）与 Password（密码）后，点击 Submit（提交）。



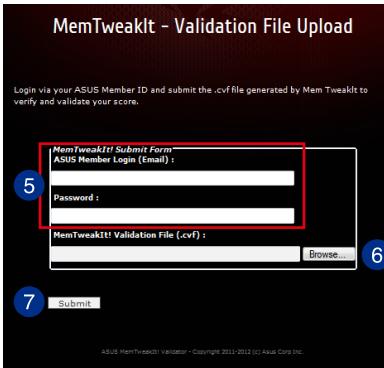
您的设置值将会显示在 MemTweakIt webpage（MemTweakIt 网页）上。

手动设置 validate（验证）与存储您的设置值：

1. 开启 MemTweakIt 后，点击 Validate（验证）。
2. 在 Manual Mode（菜单模式）中，点击 Save Configuration File（存储设置文件）。
3. 针对您的设置文件输入一个文件名，然后点击 Save Validation File。
4. 点击 validation webpage。



5. 在 MemTweakIt - Validation File Upload 窗口中，输入您的 account ID（帐号）与 password（密码）。
6. 点击 Browse（浏览），找到存储 .cvf 文件的位置后，点击 Open（开启）。
7. 点击 Submit（提交）。

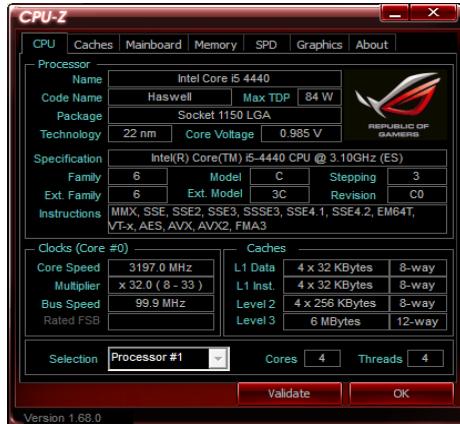


您的设置值将会显示在 MemTweakIt webpage（MemTweakIt 网页）上。

## 4.14 ROG CPU-Z

ROG CPU-Z 为 CPUID 针对 ROG 所量身订做的版本。具备与原来版本相同的功能与可信度，并拥有独特的设计。使用全新外观的 ROG CPU-Z 来确实地回报 CPU 相关信息与展现您的独特性。

如欲开启 ROG CPU-Z，请用鼠标左键双按点击桌面上的  图标。



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# 第五章

## 5.1 RAID 功能设置

本主板内置 Intel® 芯片组，可以让您通过 Intel® Rapid Storage 技术来设置 RAID 0、1、5 与 RAID 10 磁盘数组。



若您想要使用设置有 RAID 磁盘数组的硬盘来启动系统，请在安装操作系统到选定的硬盘之前，先将应用程序 DVD 光盘内的 RAID 驱动程序文件复制至软盘中。请参考 5.2 创建一张搭载有 RAID 驱动程序的软盘一节的说明。

### 5.1.1 RAID 定义

RAID 0 的主要功能为「Data striping」，即区块延展。其运行模式是将磁盘数组系统下所有硬盘组成一个虚拟的大硬盘，而数据存取方式是平均分散至多颗硬盘，是以并行的方式读取/写入数据至多颗硬盘，如此可增加存取的速度，若以二颗硬盘所建构的 RAID 0 磁盘数组为例，传输速度约为数组中转速最慢的硬盘的二倍速度。整体而言，RAID 0 模式的磁盘数组可增加数据传输的性能与速率。

RAID 1 的主要功能为「Data Mirroring」，即数据映射。其运行模式是将磁盘数组系统所使用的硬盘，创建为一组映射对应（Mirrored Pair），并以平行的方式读取/写入数据至多颗硬盘。而写入至各个硬盘的数据是完全一样的，在读取数据时，则可由本组内所有硬盘同时读出。而 RAID 1 模式的磁盘数组最主要就是其容错功能（fault tolerance），它能在磁盘数组中任何一颗硬盘发生故障的情况下，其它硬盘仍可以继续动作，保持系统不中断运行。即使数组中某一硬盘损毁时，所有的数据仍会完整地保留在磁盘数组的其它硬盘中。

RAID 5 的主要功能为将数据与验证信息加以延展，分别记录到三部或以上的硬盘中。而 RAID 5 数组设置的优点，包括有取得更理想的硬盘性能、具备容错能力，与更大的存储容量。RAID 5 数组模式最适合的使用范畴，可用于交叉处理操作、数据库应用、企业资源的规划，与商业系统的应用。这类型的数组模式，最少需要三部硬盘方可进行设置。

RAID 10 的主要功能为「Data striping」+「Data Mirroring」，也就是集 RAID 0 与 RAID 1 之所长，不但可运用到 RAID 0 模式所提供的高速传输速率，也保有了 RAID 1 模式的数据容错功能，让您不但享有高速的数据传输功能，对于数据的保存也无后顾之忧。

## 5.1.2 安装 Serial ATA (SATA) 硬盘

本主板支持 Serial ATA 硬盘。为了最佳的性能表现，当您要创建数组模式设置时，请尽可能采用具备相同型号与容量的硬盘。

请依照以下安装方式来建构 SATA RAID 磁盘数组。

1. 将硬盘安装至硬盘槽中。
2. 安装硬盘连接排线，将欲建构磁盘数组的硬盘连接至主板。
3. 将 SATA 电源线连接到每一部硬盘。

## 5.1.3 在 BIOS 程序中设置 RAID

在您开始创建数组之前，您必须先在 BIOS 程序设置中设置对应的 RAID 选项。请依照下列步骤进行操作：

1. 在启动之后系统仍在内存的开机自检 (Power-On Self Test, POST) 时，按下 <Delete> 按键进入 BIOS 设置程序。
2. 进入主菜单 (Main) 后，选择 Advanced > SATA Configuration 选项，然后按 <Enter> 键。
3. 将 SATA Mode 选项设置为 [RAID Mode]。
4. 存储您的设置值并退出 BIOS 程序。



关于如何在 BIOS 中针对菜单进行浏览与输入，请参考第三章的相关说明。

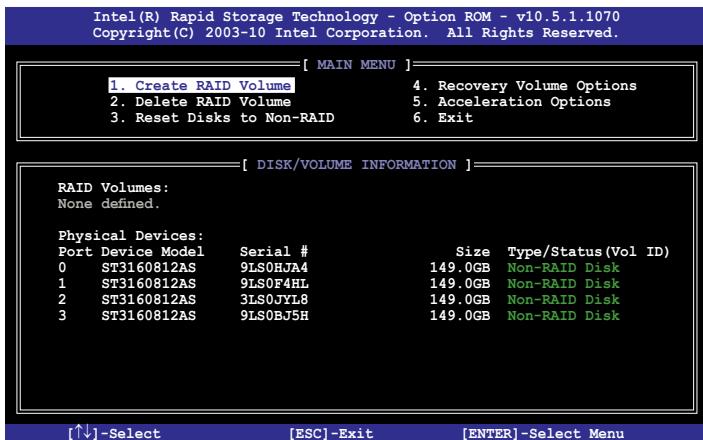


由于芯片的限制，当您设置 SATA 接口为 RAID 时，所有的 SATA 接口均会以 RAID 模式运行。

## 5.1.4 进入 Intel® Rapid Storage Technology Option ROM 应用程序

请依照下列步骤来进入 Intel® Rapid Storage Technology Option ROM 应用程序：

1. 启动您的电脑。
2. 当系统运行开机自检 (POST) 时，按下 <Ctrl> + <I> 键来进入应用程序主菜单。



在屏幕下方的导览键可让您移动光棒到不同的选项并选择菜单中的选项。



本节中的 RAID BIOS 设置画面只能参考，所显示的画面与实际设置画面可能稍有不同。



本应用程序可以支持四个硬盘进行 RAID 设置。

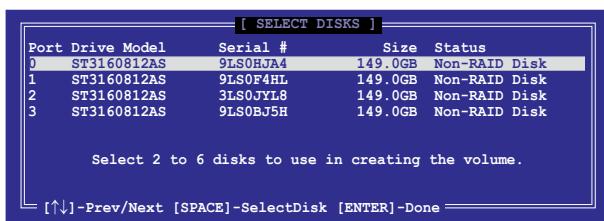
## 创建 RAID 设置

请依照下列步骤创建 RAID 设置：

- 选择 1. Create RAID Volume 然后按下 <Enter> 按键，会出现如下图所示的画面。



- 为您的 RAID 磁区键入一个名称，然后按下 <Enter> 按键。
- 使用向上、向下方向键来选择您想要的 RAID 层级，然后按下 <Enter> 按键。
- 当 Disk 选项出现，请按下 <Enter> 按键以便选择要进行数组设置的硬盘设备。接着显示如下图所示的画面。



5. 请使用向上、向下方向键来选择硬盘设备，确认后请按下〈Space〉按键来进行选择。接着被选定的硬盘设备旁便会出现一个小三角形图标。当要进行数组设置的硬盘设备选择完毕后，请按下〈Enter〉按键。
6. 使用向上、向下方向键来选择 RAID 磁盘数组（RAID 0、RAID 10、RAID 5）要分区的容量，然后按下〈Enter〉按键。分区的数值可由 4KB 递增至 128KB，数据分区的数值应该以硬盘使用的目的来决定。下列为推荐：

RAID 0: 128KB

RAID 10: 64KB

RAID 5: 64KB



若此系统欲作为服务器使用，推荐您选择较低的磁区大小；若此系统欲作为多介质电脑用来运行影音的编辑制作，推荐您选择较高的磁区大小来获得最佳的性能。

7. 输入您所要的数组容量，接着按下〈Enter〉按键。本项目默认值是采用最高可容许的磁盘容量。
8. 在 Create Volume 的提示对话框中再按下〈Enter〉按键来创建磁盘数组，接着便会出现如下图的提示信息画面。



9. 按下〈Y〉键创建数组并回到主菜单，或是按下〈N〉键回到 CREATE VOLUME MENU（创建数组标签）菜单。

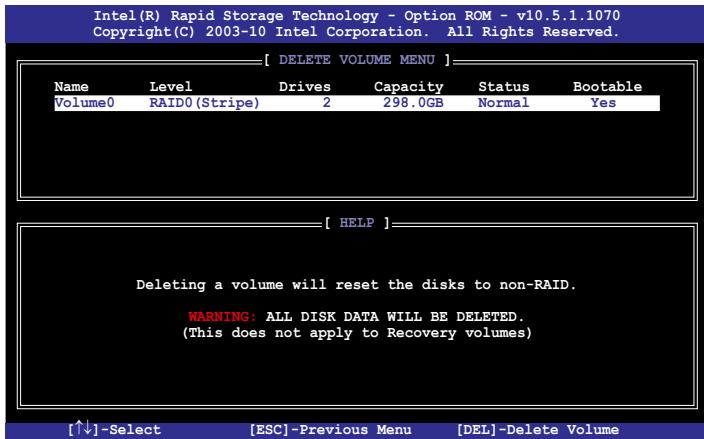
## 删除 RAID 数组



当您要删除 RAID 设置时请小心，存储在硬盘中的数据会被全部删除。

请依照以下步骤删除 RAID 数组：

- 选择 2. Delete RAID Volume 然后按下 <Enter> 按键，会出现如下图所示的窗口画面。



- 使用向上、向下方向键来选择您想要删除的 RAID 设置，然后按下 <Del> 按键。接着显示如下图所示的画面。



- 按下 <Y> 键删除 RAID 并回到主菜单，或是按 <N> 键回到 DELETE VOLUME MENU (创建数组标签) 菜单。

## 离开 Intel® Rapid Storage Technology Option ROM 应用程序

请依照以下步骤离开应用程序：

1. 选择 5. Exit 然后按下 <Enter> 按键，显示如下图所示的画面。



2. 按下 <Y> 按键来离开应用程序，或是按下 <N> 回到主菜单。

## 5.2 创建一张搭载有 RAID 驱动程序的软盘

当您欲在拥有 RAID 设置的硬盘中安装 Windows® 操作系统时，您需要准备一张搭载有 RAID 驱动程序的软盘。



本主板没有软驱插槽，请使用 USB 软驱来创建 SATA RAID 驱动程序的软盘。

### 5.2.1 在不进入操作系统状态下创建 RAID 驱动程序软盘

请依照下列步骤在不进入操作系统状态下创建 RAID/SATA 驱动程序软盘：

1. 开启您电脑的电源。
2. 当进行 POST 开机自检时按下 <Del> 键进入 BIOS 程序设置。
3. 将光驱设置为主要启动设备。
4. 将驱动程序与应用程序光盘放入光驱中。
5. 存储更改并退出 BIOS 程序设置。
6. 当菜单出现时，点击 制作驱动程序软盘 标签页，按下 <1> 来创建一张 RAID 驱动程序软盘。
7. 将已格式化的软盘放入 USB 软驱中，并按下 <Enter> 键。
8. 依照屏幕的指示完成驱动程序软盘的创建。

## 5.2.2 在 Windows<sup>®</sup> 操作系统中创建 RAID 驱动程序软盘

请依照下列步骤在 Windows<sup>®</sup> 操作系统中创建 RAID 驱动程序软盘：

1. 启动 Windows 操作系统。
2. 连接 USB 软驱并将软盘放入软驱中。
3. 将驱动程序与应用程序光盘放入光驱中。
4. 点击 制作驱动程序软盘 标签页，接着点击 Intel AHCI/RAID Driver Disk 选项来创建一张 RAID 驱动程序软盘。
5. 选择 USB 软驱。
6. 依照屏幕指示完成驱动程序软盘的创建。



请将驱动程序软盘切换为防止写入以避免遭受电脑病毒的感染。

## 5.2.3 在安装 Windows<sup>®</sup> 操作系统时安装 RAID 驱动程序

请依照下列步骤在 Windows<sup>®</sup> 7 或更新的操作系统中安装 RAID 驱动程序：

1. 当安装操作系统时，选择 Load Driver。
2. 将搭载有 RAID 驱动程序的软盘/U 盘安装软驱/USB 接口，并点击 Browse。
3. 请选择您的设备后，选择 Drivers > RAID，并选择 RAID 驱动程序文件再按 OK。
4. 请依照屏幕指示来完成驱动程序的安装。



在从 U 盘载入 RAID 驱动程序之前，您必须使用另一台电脑来将应用程序光盘中的 RAID 驱动程序复制到 U 盘。

# 附录

## 华硕的联络信息

华硕电脑（上海）有限公司 ASUSTEK COMPUTER (SHANGHAI)  
CO., LTD

### 市场信息

地址：上海市闵行莘庄工业区春东路508号  
电话：+86-21-54421616  
传真：+86-21-54420088  
互联网：<http://www.asus.com.cn/>

### 技术支持

电话：+86-20-28047506  
(400-620-6655)  
电子邮件：<http://vip.asus.com/VIP2/Services/TechQuery?lang=zh-cn>  
在线支持：<http://www.asus.com.cn/support>

## 华硕电脑公司 ASUSTeK COMPUTER INC. (亚太地区)

### 市场信息

地址：台湾台北市北投区立德路15号  
电话：+886-2-2894-3447  
传真：+886-2-2890-7798  
电子邮件：[info@asus.com.tw](mailto:info@asus.com.tw)  
互联网：<http://www.asus.com>

### 技术支持

电话：+86-21-38429911  
传真：+86-21-58668722, ext. 9101#  
在线支持：<http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx>

## ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (美国)

### 市场信息

地址：800 Corporate Way, Fremont, CA  
94539, USA  
传真：+1-510-608-4555  
互联网：<http://usa.asus.com>

### 技术支持

电话：+1-812-282-2787  
传真：+1-812-284-0883  
在线支持：<http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx>

## ASUS COMPUTER GmbH (德国/奥地利)

### 市场信息

地址：Harkort Str. 21-23, D-40880  
Ratingen, Germany  
传真：+49-2102-959931  
互联网：<http://asus.com/de>  
在线联络：<http://eu-rma.asus.com/sales> (仅  
回答市场相关事务的问题)

### 技术支持

电话：+49-2102-5789555  
传真：+49-2102-959911  
在线支持：<http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx>

附件二

符合性聲明書  
Declaration of Conformity

| 報驗義務人代碼<br>Code of the applicant | 編號<br>Number |
|----------------------------------|--------------|
| D33005                           |              |

本符合性聲明書應依商品檢驗法規定備齊相關技術文件後始得簽具  
Please check all the related technical documents in accordance with the Commodity Inspection Act before  
signing the form.

報驗義務人：華碩電腦股份有限公司

Obligatory Applicant

地址：台北市北投區立德路 150 號 4 樓

Address

電話：02-2894-3447

Telephone

商品中（英）文名稱：主機板 (Motherboard)

Commodity Name

商品型式（或型號）：MAXIMUS VII HERO

Commodity Type (Model)

符合之檢驗標準及版次：CNS 13438 : 95 年完整版 (乙類) (Class B)

Standard(s) and version

試驗報告編號：1420223R-ITTWP01V00

Test Report Number

試驗室名稱及代號：快特電波股份有限公司 (SL2-IN-E-0043)

Testing laboratory name and designation number

符合性聲明檢驗標識及識別號碼：

The form of the DoC marking appears like this

或  
or



D33005

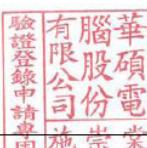


D33005

茲聲明上述商品符合商品檢驗法符合性聲明之規定，若因違反本聲明書所  
聲明之內容，願意擔負相關法律責任。

I hereby declare that the listed commodity conforms to Declaration of Conformity requirements stipulated in the Commodity  
Inspection Act. I agree to take any legal obligations should violations against the Declaration of Conformity occur.

報驗義務人：華碩崇業 (簽章)  
Obligatory Applicant



(Signature)

中華民國 一百零三年三月五日  
DATE (year) (month) (day)

## DECLARATION OF CONFORMITY



Per FCC Part 2 Section 2, 1077(a)



Responsible Party Name : Asus Computer International

Address: 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539.

Phone/Fax No: (510)730-3777/(510)608-4555

hereby declares that the product

**Product Name : Motherboard**

**Model Number : MAXIMUS VII HERO**

Conforms to the following specifications:

- FCC Part 15, Subpart B, Unintentional Radiators

### Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Representative Person's Name : Steve Chang / President

*Steve Chang*

Signature :

Date : Apr. 11, 2014

Ver. 10/31

## EC Declaration of Conformity



IN SEARCH OF INCREDIBLE

We, the undersigned,

Manufacturer : ASUSTeK COMPUTER INC.

Address: 4F, NO. 150, LINTAI RD., TAIPEI 112, TAIWAN

Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH

Address, City: HARKIRK STR. 21-23, 40200 RATINGEN

Country: GERMANY

declare the following apparatus:

Product name : Motherboard

Model name : MAXIMUS VII HERO

conforms with the essential requirements of the following directive(s):

2004/108/EC Directive

2011/65/EU Directive

EN 55022: 2011+A2:2011

EN 61000-3-2:2006+A2:2009

EN 55020: 2006+A1:2007+A2:2006

EN 55035: CE Marking

EN 60068-2-2:2008

EN 60068-2-6:2008

EN 60068-2-10:2008

EN 300 328 V1.7 (1006-10)

EN 300 440-1 V1.4 (2010-09)

EN 300 440-2 V1.4 (2009-09)

EN 300 440-3 V1.4 (2009-05)

EN 300 440-4 V1.2 (2011-05)

EN 300 440-5 V1.2 (2011-05)

EN 300 440-6 V1.2 (2011-05)

EN 300 440-7 V1.2 (2011-05)

EN 300 440-8 V1.2 (2011-05)

EN 300 440-9 V1.2 (2011-05)

EN 300 440-10 V1.2 (2011-05)

EN 300 440-11 V1.2 (2011-05)

EN 300 440-12 V1.2 (2011-05)

EN 300 440-13 V1.2 (2011-05)

EN 300 440-14 V1.2 (2011-05)

EN 300 440-15 V1.2 (2011-05)

EN 300 440-16 V1.2 (2011-05)

EN 300 440-17 V1.2 (2011-05)

EN 300 440-18 V1.2 (2011-05)

EN 300 440-19 V1.2 (2011-05)

EN 300 440-20 V1.2 (2011-05)

EN 300 440-21 V1.2 (2011-05)

EN 300 440-22 V1.2 (2011-05)

EN 300 440-23 V1.2 (2011-05)

EN 300 440-24 V1.2 (2011-05)

EN 300 440-25 V1.2 (2011-05)

EN 300 440-26 V1.2 (2011-05)

EN 300 440-27 V1.2 (2011-05)

EN 300 440-28 V1.2 (2011-05)

EN 300 440-29 V1.2 (2011-05)

EN 300 440-30 V1.2 (2011-05)

EN 300 440-31 V1.2 (2011-05)

EN 300 440-32 V1.2 (2011-05)

EN 300 440-33 V1.2 (2011-05)

EN 300 440-34 V1.2 (2011-05)

EN 300 440-35 V1.2 (2011-05)

EN 300 440-36 V1.2 (2011-05)

EN 300 440-37 V1.2 (2011-05)

EN 300 440-38 V1.2 (2011-05)

EN 300 440-39 V1.2 (2011-05)

EN 300 440-40 V1.2 (2011-05)

EN 300 440-41 V1.2 (2011-05)

EN 300 440-42 V1.2 (2011-05)

2009/126/EC Directive

EN 60950-1: A1/2011

Regulation (EC) No. 1275/2008

Regulation (EC) No. 642/2009

Regulation (EC) No. 617/2013

CE marking

Ver. 10/31



(EC conformity marking)

Position : CEO  
Name : Jerry Shen

Declaration Date : 11/04/2014  
Year to begin affixing CE marking: 2014

Signature :

